

股票代號：3455



一一三年度 年報

本年報查詢網址：(1)公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw/>
(2)本公司網址 <http://www.utechzone.com.tw/>

中 華 民 國 1 1 4 年 4 月 3 0 日 刊 印

■ 發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

<u>發言人</u>	<u>代理發言人</u>
姓名：張文杰	姓名：林慧盆
職稱：總經理暨業務市場部副總經理	職稱：行政財務部財會處經理
電話：(02)8226-2088	電話：(02)8226-2088
電子郵件信箱：jack@utechzone.com.tw	電子郵件信箱：ally-lin@utechzone.com.tw

■ 總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總公司地址	： 新北市中和區連城路 268 號 10 樓之 1	電話：(02)8226-2088
南科分公司	： 台南市新市區創業路 16 號 1 樓及 12 號 1 樓	電話：(06)505-8989
工廠地址	： 新北市樹林區味王街 28-1 號	電話：(02)2680-6006
	台南市新市區創業路 16 號 1 樓及 12 號 1 樓	電話：(06)505-8989
	新北市鶯歌區八德路 3 之 8~11 號	電話：(02)2670-9568
	新北市鶯歌區八德路 3 之 12 號	電話：(02)2670-9568
	桃園市平鎮區東勢里東龍街 609 號	電話：(03)450-7799

■ 股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：	元富證券股份有限公司	地址：	台北市松山區光復北路 11 巷 35 號地下一樓
網址：	http://www.masterlink.com.tw/ 電話：(02)2768-6668		

■ 最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：	林恒昇會計師、洪士剛會計師		
事務所名稱：	安侯建業聯合會計師事務所		
地址：	台北市信義路五段 7 號 68 樓	電話：	(02) 8101-6666
網址：	http://www.kpmg.com.tw/		

■ 海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及其資訊查詢方式：不適用。

■ 公司網址：<http://www.utechzone.com.tw/>

由田新技股份有限公司

一一三年度年報

目錄

壹、致股東報告書-----	1
貳、公司治理報告	
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料-----	5
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金-----	10
三、公司治理運作情形-----	13
四、簽證會計師公費資訊-----	37
五、更換會計師資訊-----	37
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於 簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會 計師所屬事務所或其關係企業之期間-----	38
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東 股權移轉及股權質押變動情形-----	38
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關 係之資訊-----	39
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之 持股數，並合併計算綜合持股比例-----	40
參、募資情形	
一、資本及股份-----	41
二、公司債辦理情形-----	45
三、特別股辦理情形-----	45
四、海外存託憑證辦理情形-----	45
五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形-----	45
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形-----	45
七、資金運用計劃執行情形-----	45
肆、營運概況	
一、業務內容-----	46
二、市場及產銷概況-----	78
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均 年齡及學歷分布比率-----	85
四、環保支出資訊-----	85
五、勞資關係-----	85
六、資通安全管理-----	87
七、重要契約-----	88

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	
一、財務狀況-----	89
二、財務績效-----	89
三、現金流量-----	90
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響-----	90
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫-----	90
六、風險事項分析評估-----	91
七、其他重要事項-----	93
陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料-----	93
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形-----	93
三、其他必要補充說明事項-----	93
柒、最近年度及截至年報刊印日止，依證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項-----	93

壹、致股東報告書

一、113 年度營業結果

(一)營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

項目	113年度		112年度		增減情形	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	1,851,973	100	2,009,810	100.00	(157,837)	(8)
營業毛利	1,001,330	54	1,170,764	58.25	(169,434)	(14)
營業淨利	190,418	10	375,790	18.70	(185,372)	(49)
稅前淨利	321,891	17	378,327	18.82	(56,436)	(15)
稅後淨利	316,558	17	314,229	15.63	2,329	1
每股盈餘(元)	5.29		5.25			

(二)預算執行情形：本公司因未對外公開財務預測，故不適用。

(三)財務收支及獲利能力分析

1.財務收支

本公司113年度流動比率為253.55%，速動比率為182.72%，顯見償債能力尚屬允當。

2.獲利能力分析

項目		%
獲利能力	資產報酬率	7.41
	權益報酬率	11.90
	稅前純益佔實收資本比率	53.78
	純益率	17.09
	每股盈餘(元)	5.29

(四)研究發展狀況

本公司 113 年主要研發成果如下：

研發成果	
半導體黃光製程檢測設備	半導體二極體晶圓級檢測設備
半導體 IR 內層缺陷檢測設備	化合物半導體晶圓級檢測設備
半導體自動巨觀+微觀檢測設備	IC 載板 AI 拍照複檢機
半導體面板級封裝檢測設備	PCB 全版蝕刻量測設備
半導體高速 Review 拍照設備	PCB 全版阻抗監控設備
先進封裝多面檢測設備	

二、114 年度營運計劃概要

(一)經營方針

本公司秉持「We serve with vision.」之經營理念，朝向多元領域之機器視覺先進技術的方向研發，以速度、精準及服務為新世代產品持續努力的目標，研製各式符合客戶需求之產品，為股東創造更大利益而努力。

(二)重要之產銷政策

- 1.貫徹中長期之經營策略理念，聚焦於高附加價值之產品，並同時針對現有產品持續優化與精進，以維持公司產品之高競爭力。
- 2.在市場行銷策略面上，採取靈活、多面向的創新思維，隨時掌握外部環境變化並調整適應，透過不同溝通管道及媒介方式強化產品在市場的曝光度及口碑，以深化本公司在自動光學檢測產業的優勢印象。
- 3.致力與各地經銷及代理商發展長遠關係與互惠互榮的合作模式，有效建立大中華地區與東亞地區之地緣關係，強化公司產品銷售與能見度。
- 4.持續強化成本改善力道以創造產品利潤，有效進行供應鏈管理，緊密維繫與合作夥伴、供應商、外包商及相關團體之關係，以達公司、客戶及下游廠商之三贏局面。
- 5.提升客戶服務之廣度與精度，建立暨維持與客戶之間長期合作關係，爭取並深耕客戶群以提高客戶對本公司的依存度，亦藉由擴大市場佔有率與市場滲透率，維持公司每年設定之成長目標。
- 6.有效利用現有研發資源，以自動化光學檢測之核心技術為基礎，提高產品藍圖之拓展性，持續針對 IC substrate、HDI、FPC、Wafer、COF、LCD...等多產業產品進行優化研究與開發，同時延伸觸角推出檢孔、自動量測設備...等多元應用，完整多角化市場佈局。
- 7.有效培養有關視覺、光學、軟體、機械與產品應用之人才，加強產官學研之技術交流合作，提昇創新能量及研發水平。

(三)未來公司發展策略

本公司基於過去所建立的市場、技術與品牌基礎，未來將持續堅守公司的經營理念與方針，專注並致力於自動光學檢測設備的研發精進，以先進高品質的優良產品，輔以完善即時的支援與服務，提供客戶低成本、高效益的全方位專業解決方案，並以不斷創新的精神，開發領先業界、滿足客戶需求的各項產品。

- 1.以利基型產品導入市場，獲取較高利潤。
- 2.現有產品優化升級與新產品開發雙頭並進，穩定利潤並開發營收。
- 3.持續拓展合作夥伴，積極與國內外廠商建立友好合作關係。
- 4.於各地區建立專有服務據點，延伸服務涵蓋範圍，提供即時在地服務。
- 5.建立與執行高標準作業模式，提高各段流程效能，以達產品如期開發、如質生產之綜效。
- 6.培養管理人才與高專業人員，並維持高員工滿意度，以提高工作品質及生產力。
- 7.以客戶滿意為導向，提升服務品質與效率，並成為公司成長的重要利基。
- 8.加強專利與智慧財產權的申請及保護，並提高公司技術屏障。
- 9.善盡企業社會責任，關心弱勢族群，回饋社會公益。

(四)受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

1.外部競爭環境

人工智慧(AI)浪潮席捲全球，製造業正經歷著前所未有的轉型。隨近年AI帶旺先進封裝需求，更高效率、更高品質、更低成本為各廠商共同追求的目標。而由於2.5D/3D先進封裝製程高精密度及細線路特色，帶旺AOI自動光學檢測成為不可或缺的關鍵技術。另外隨著產品複雜性以及消費者對完美產品的期望增加，製造商面

臨確保一致品質的壓力。AOI 系統提供快速、準確、穩定和可靠的檢查。採用AOI 技術可以幫助製造商提高產品質量，減少返工和報廢，並提高客戶滿意度，從而推動AOI市場的成長。根據Statistics MRC預測，2023年全球自動光學檢測（AOI）市場規模將達到8.833億美元，2030年將達到31.103億美元，預測期內複合年成長率為19.7%，顯見整體產業持續活絡。

作為全球製造業重鎮，中國大陸對AOI 檢測的需求斜率最為強勁，特別是中國大陸政府持續推動「中國製造 2025」等政策，鼓勵製造業轉型升級，給予了智慧 AOI 檢測市場發展的長期利多。預計未來幾年，中國大陸智慧 AOI 檢測市場將保持高速成長。近年來中國大陸本土競爭者林立，帶動產業活化動能，此外，世界級設備廠於技術及資金方面亦為重要的外部競爭因素。隨近年產業併購重組風潮興起，預計AOI領域將呈大者恆大之激烈競爭場面。

本公司將持續鞏固在產業界的優勢地位，不斷增進本身之業務與研發能力、廣化產品涵蓋、開發銷售渠道，以深植於公司文化的服務技術、速度及品質，積極爭取客戶的支持與肯定，開發高利基、高技術含量的差異性商品，於高度競爭的同業中脫穎而出。

2.法規環境

主導性新產品計畫、業界科專計劃及研發投資抵減等獎勵措施，可激勵以創新為主要的公司開拓新產品。

3.整體經營環境

2024年全球製造業表現呈二極化，半導體高階製程與伺服器需求強勁，而傳產需求回升有限。從產業來看，AI相關供應鏈表現卓越，AI技術驅動的產業持續成為全球經濟成長的重要引擎。據 Precedence Research統計，2024年全球人工智慧市場規模達6,382億美元，較2023年成長18.6%，在技術快速進步、數據可用性不斷增加以及各行業對自動化需求不斷增長的推動下，AI市場正在經歷前所未有的成長。隨著企業意識到AI在提高效率、降低營運成本和改善客戶體驗方面的變革潛力，對AI技術的投資激增，驅動上游晶片製造和下游應用軟體市場的擴張。另一方面傳統製造業與汽車業則表現相對低迷，傳產面臨來自於需求減弱和中國大陸生產過剩的雙重壓力。據DIGITIMES的分析，全球汽車市場的成長預計將放緩，2024年全年銷量預估僅成長2%，達到9,090萬輛，主要因為後疫情時期需求高峰已過，加上高利率環境抑制消費者購車意願。電動車市場則將持續成長，預計銷量達1,719萬輛，年增23.8%，2025年全球GDP成長的整體展望預計將與2024年相近。在產業展望方面，科技產業將受益於AI與自動化的進步，推動半導體方案需求；在傳統產業方面，隨著歐美市場啟動降息、中國大陸加大刺激政策力道，預期政策效果將在2025年陸續發酵，應可間接為傳產帶來復甦契機。

2025由於人工智慧、雲端資料處理、電動車、無線通訊及終端產品等應用需求提升，以及新興技術的演進對高功能半導體元件需求攀升，各個主要應用市場均面臨規格升級趨勢，半導體產業可望將再度迎來嶄新榮景，國際預測機構IDC預計2025年整體半導體市場將成長超過15%，整體市場成長可期，其中生成式AI、高效能運算HPC、ADAS等新應用爆發將加速先進封裝布局，2.5/3D封裝市場可望呈爆發式成長，CoWoS供應鏈產能倍增，更形帶動半導體相關檢測需求。

由田公司近年大力布局半導體檢測，產品研發有成，以多元光學優勢推出各式產品，包含以專利螢光對應黃光製程精密線路及殘留檢出、以IR光檢測切割後之內部隱崩等缺陷、結合巨觀/微觀與多元分析工具提供獨創OM檢測，同時不侷限於晶圓型式，同步延伸技術提供面板級封裝、玻璃TGV、單顆先進封裝多面檢測…等系列設備，多元對應Fan out/RDL、CoWoS、Bumping、Glass、CIS、Bare Wafer、Micro LED…等各式製程產品。長期來看，隨著各應用領域半導體含量的提升，將有利於

相關設備持續放量。公司整體在先進封裝領域的耕耘已收成效，多樣設備完成完整客戶認證，並為台系檢測設備首位完成百萬片晶圓檢測里程碑，預期技術及業務優勢將持續發酵擴展，目前公司不僅已斬獲兩岸一線封測大廠訂單，於東南亞亦佈局有成，2025年半導體營收占比相對可有顯著成長，帶領公司正式轉型為半導體檢測設備商。

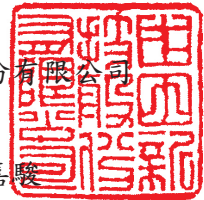
除半導體產業外，由田另一重要基石為載板相關檢測設備。ABF載板產業雖因終端需求疲軟，自2023年左右起開始陷入產能及供給過剩的困境，2024年有緩步回溫的趨勢，但目前仍處於庫存調節階段。展望2025年，各大板廠預估隨著AI應用在市場上的能見度逐漸提升，載板市場有望在2025年上半出現好轉跡象。由田公司以長期積累的專業精密檢測know how穩站載板檢測領頭，除原本長期服務之台系主要客戶外，亦持續收穫中國新投入高階製程之客戶訂單，新舊客戶加持下，將穩步推升公司技術量能，公司樂觀看待載板市場復甦燈號。

另一部分，公司原已於面板檢測具領先優勢，為業界惟一完成完整布局、可避免單一產業波動造成偏廢之設備商。近年顯示器檢測設備雖因整體產業景氣循環而調降營收占比，但受惠於削價競爭態勢減弱，相關顯示器設備毛利率可望顯著拉抬。公司掌握中國少數LCD前段擴廠需求，同時積極掌握改造升級商機、另以點燈設備成功打入高階車載面板檢測，並可搭配Demura等功能，大幅提升產品良率，公司持續觀望面板產業景氣，把持技術優勢並隨時勢進行調整布局，目標以高利基設備避免過往削價競爭態勢，穩步提升公司毛利率。

由田自1992年成立以來，三十餘年專精於自動光學檢測設備之研發與推動，提供高效高速的精準檢測以提升產品品質，致力於協助客戶導入智慧化生產解決方案。並推出AI深度學習系統，可有效降低人力成本、減少人工複判、成功縮短檢測時間，並以多元化產品線平衡各產業波動。公司近年在產品組合優化調整下，高階載板、PCB、半導體、顯示器各領域設備營收占比持續動態調整，2025年除持續廣化產業涵蓋及深化產業植基外，另因應東南亞產業聚落逐漸形成，公司穩步布局大中華區域外之銷售能量，中長期成長值得期待。

由田新技股份有限公司

董事長：鄒嘉駿



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料

1.董事之姓名、性別、年齡、國籍或註冊地、主要經(學)歷、持有股份及性質

114年4月27日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
							股數	持 股 比 率 %	股數	持 股 比 率 %	股數	持 股 比 率 %	股數	持 股 比 率 %			職稱	姓名	關係
董事長	中華民國	鄒嘉駿	男 51~60歲	112/6/16	3年	81/5/23	2,112,881	3.53	1,112,881	1.85	417,009	0.69	1,004,000	1.67	交通大學 計算機工程系	本公司執行長 UTECHZONE GLOBAL CORP.董事 EVERVISION GLOBAL(SAMOA)CO.,LTD.董事 科吉凱亞(股)公司董事長 宙福投資(股)公司董事長 宙福投資(股)公司董事長 由田信息技術(上海)有限公司執行董事 Utechzone 株式會社代表取締役 瑞興文嘉股份有限公司董事長	無	無	無
董事	中華民國	張文杰	男 51~60歲	112/6/16	3年	84/10/26	1,324,616	2.21	724,616	1.21	—	—	600,000	1.00	實踐大學 企業創新與創業管理研究所 肄業	本公司總經理 科吉凱亞(股)公司董事 宙福投資(股)公司董事 Utechzone 株式會社取締役 晶彩科技(股)公司法人董事代表人	無	無	無
董事	中華民國	林芳隆	男 61~70歲	112/6/16	3年	89/4/19	1,245,207	2.08	834,207	1.39	23,821	0.03	700,000	1.16	中山大學 企研所	宙福投資(股)公司監察人 晶彩科技(股)公司法人董事代表人 佳測新技(股)公司監察人	無	無	無
董事	中華民國	葉惠德	男 71~80歲	112/6/16	3年	100/6/21	616,151	1.03	1,016,151	1.69	—	—	—	—	逢甲大學 電子計算機科學系	國福欣欣(上海)實業有限公司董事長 龍德投資有限公司董事長 惠晶生物科技(股)公司董事 列特博生技(股)公司董事	無	無	無
獨立董事	中華民國	丘邦翰	男 61~70歲	112/6/16	3年	94/5/12	—	—	—	—	—	—	—	—	中山大學 企管碩士	元智大學副教授兼元智大學智慧生產與管理創新研究中心主任	無	無	無
獨立董事	中華民國	呂英誠	男 61~70歲	112/6/16	3年	94/5/12	—	—	—	—	—	—	—	—	美國德州大學 達拉斯分校 電機博士	明揚國際科技(股)公司法人董事代表人 明安國際企業(股)公司副總經理	無	無	無
獨立董事	中華民國	蔡熊光	男 61~70歲	112/6/16	3年	109/6/17	—	—	—	—	—	—	—	—	臺灣大學 電機工程學研究所 博士	祥閣科技(股)公司董事長	無	無	無

註：本公司董事長兼任執行長，係為提升經營效率及決策執行力；此外，董事長平時亦密切與各董事充分溝通公司營運近況及計畫方針落實公司治理，本公司114年股東會預計增加一席獨立董事提升董事會職能及強化監督功能。目前本公司已有下列具體措施：

1.現任三席獨立董事分別在財務會計與產業業務研發專業領域學有專精，能有效發揮其監督職能。

2.本公司依證券交易法第14條之4規定設置審計委員會，強化董事會監督功能，且本公司之半數董事未兼任經理人。

3.每年度安排各董事參加證基會等外部機構專業董事課程，以增進董事會之運作效能。

2.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

114 年 4 月 27 日

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
鄒嘉駿	鄒嘉駿董事長具有五年以上公司業務所需之工作經驗，現任本公司董事長兼執行長及研發部副總，致力於檢測設備領域逾30年經歷，擁有營運管理、策略規劃、研發能力，且兼具專業市場競爭判斷力及創新領導力。 未有公司法第30條各款情事。	不適用	無
張文杰	張文杰董事具有五年以上公司業務所需之工作經驗，現任本公司總經理兼業務部副總，致力於檢測設備領域逾30年經歷，擁有豐富之市場策略及業務推廣之產業經驗。 未有公司法第30條各款情事。		無
林芳隆	林芳隆董事具有五年以上公司業務所需之工作經驗，曾擔任本公司行政財務部副總，具有超過30年產業經歷，熟悉本公司組織運作，具備行政管理、財務規劃等經驗。 未有公司法第30條各款情事。		無
葉惠德	葉惠德董事具有五年以上公司業務所需之工作經驗，具有超過40年產業經歷，深具國際觀且熟悉兩岸區域經濟與市場，適時提供公司建言，推動企業永續經營。 未有公司法第30條各款情事。		無
丘邦翰	丘邦翰獨立董事具有五年以上公司業務所需之工作經驗，擁有中山大學企管博士學位，現任元智大學管理學院副教授兼任智慧生產與管理創新研究中心主任，專精於財務管理、區塊鏈金融、機械學習及金融風險管理等領域。 未有公司法第30條各款情事。	本公司獨立董事均符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第三條第一項之規定。	無
呂英誠	呂英誠獨立董事具有五年以上公司業務所需之工作經驗，為本公司審計委員會及薪資報酬委員會召集人，現任明揚國際科技(股)公司董事及明安國際企業(股)公司副總經理，擁有美國德州大學達拉斯分校電機博士學位，具有電機工程專業知識，並擅長企業領導、營運判斷與管理。 未有公司法第30條各款情事。		無
蔡熊光	蔡熊光獨立董事具有五年以上公司業務所需之工作經驗，具有超過30年產業經歷，擁有臺灣大學電機工程學研究所博士學位，現任祥閎科技(股)公司董事長具備電機工程專業知識、產業發展與營運管理經驗。 未有公司法第30條各款情事。		無

3.董事會多元化及獨立性

(1)董事會多元化：

本公司訂有「公司治理實務守則」及「董事選任程序」，要求董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，除基本條件與價值：性別、年齡、國籍以外，亦包含專業背景，如行銷、財務會計、科技專長及產業經驗。另要求董事會整體應具備之能力如下：營業判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。

目前本公司個別董事落實董事會成員多元化政策情形如下：

多元化 核心 董事 姓名	基本組成								專業背景				專業知識與技能								
	國籍	性別	具 員 工 身 分	年齡			獨立董事任期年資			行銷	財務 會計	科技 專長	產業 經驗	營業 判斷	會計 財務	經營 管理	危機 處理	產業 知識	國際 市場 觀	領導 能力	決策 能力
				51 至 60	61 至 70	71 至 80	3年 以下	3年 至 9年	9年 以上												
鄒嘉駿	中 華 民 國	男	✓	✓								✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
張文杰		男	✓	✓							✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
林芳隆		男				✓						✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
葉惠德		男						✓						✓	✓		✓	✓		✓	✓
丘邦翰		男					✓				✓				✓			✓			✓
呂英誠		男					✓				✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓
蔡熊光		男					✓				✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓

目前本公司董事會因分別於各自領域之專業知識與技能皆具豐富經驗，且對本公司各項營運適時提供重要建言，故任一性別董事席次未達三分之一，待本屆董事屆期改選時，將至少委任1名不同性別之董事，以提升董事性別多元化之目標，未來本公司亦擬規畫增加不同性別之董事達董事席次三分之一，以落實董事會成員多元化政策。

(2)董事會獨立性：

本公司設有獨立董事三席，占董事成員比重約43%，三位獨立董事中呂英誠董事及丘邦翰董事已擔任本公司獨立董事連續達三屆，惟兩位獨立董事分別於產業業務研發專業領域及財務會計專業領域皆具豐富經驗，皆能為本公司各項營運或財務面向提供重要建言。雖已連任本公司三屆以上之獨立董事，然對公司歷年董事會議程之各項討論內容相當熟捻，本公司仍需持續借重其專業之處，給予董事會監督並提供各式專業意見。本公司獨立董事皆符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事皆無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

114 年 4 月 27 日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股份比率%	股數	持股份比率%	股數	持股份比率%			職稱	姓名	關係	
執行長	中華民國	鄒嘉駿	男	102/04/16	1,112,881	1.85	417,009	0.69	1,004,000	1.67	交通大學計算機工程系	(註 1)	—	—	—	(註 3)
總經理	中華民國	張文杰	男	94/05/12	724,616	1.21	—	—	600,000	1.00	實踐大學企業創新與創業管理研究所肄業	(註 2)	—	—	—	
業務部副總	中華民國	邱彥博	男	114/03/11	—	—	—	—	—	—	澳洲昆士蘭科技大學資訊工程系 艾慕思生物科技國外業務	無	—	—	—	
檢量技術部副總	中華民國	林伯聰	男	114/03/11	21,801	0.03	—	—	—	—	元智大學工業工程所	無	—	—	—	
自控技術部副總	中華民國	王人傑	男	114/03/11	—	—	—	—	—	—	臺灣科技大學工業管理科學及技術系 晉遠科技工程師	無	—	—	—	
檢量技術部副理	中華民國	徐敏堂	男	109/01/01	—	—	—	—	—	—	中央大學數學所 元錕科技工程師	無	—	—	—	
檢量技術部副理	中華民國	廖佐華	男	114/03/11	—	—	—	—	—	—	義守大學資訊管理所 欣技科技軟體工程師	無	—	—	—	
業務部副理	中華民國	葉丁源	男	114/03/11	50,640	0.08	100	0.00	890,000	1.48	交通大學資訊工程所 中華電信研究所副研究員	無	—	—	—	

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
業務本分	中華民國	陳健銘	男	114/03/11	673	0.00	—	—	—	—	華夏工商專科學校 電機工程科 志聖工業經理	上海朋信 信息技術有限公司董事	—	—	—	
運本分	中華民國	蔡茂岳	男	109/01/01	36,946	0.06	50	0.00	—	—	元智大學工業工程所 集星達數位科技副理	科吉凱亞(股)有限公司董事 宙福投資(股)公司董事 Utechzone株式會社取締役 學文科技(股)公司監察人	—	—	—	
財務會計主管	中華民國	林慧盆	女	110/04/01	1,000	0.00	—	—	—	—	東吳大學會計系 安侯建業聯合會計師事務所副理	無				
稽核主管	中華民國	許玉潔	女	107/06/28	—	—	—	—	—	—	淡江大學會計系 彥臣生技(股)公司稽核主管	無	—	—	—	

註 1：UTECHZONE GLOBAL CORP.董事、EVERVISION GLOBAL(SAMOA) CO.,LTD.董事、科吉凱亞(股)公司董事長、宙福投資(股)公司董事長、由田信息技術(上海)有限公司執行董事、Utechzone 株式會社代表取締役、瑞泉文嘉股份有限公司董事長

註 2：科吉凱亞(股)公司董事、宙福投資(股)公司董事、Utechzone 株式會社取締役、晶彩科技(股)公司法人董事代表人

註 3：本公司董事長兼任執行長，係為提升經營效率及決策執行力；此外，董事長平時亦密切與各董事充分溝通公司營運近況及計畫方針落實公司治理，本年度股東會本公司擬規劃增加一席獨立董事席次之方式提升董事會職能及強化監督功能。目前本公司已有下列具體措施：

- 1.現任三席獨立董事分別在財務會計與產業業務研發專業領域學有專精，能有效發揮其監督職能。
- 2.本公司依證券交易法第14條之4規定設置審計委員會，強化董事會監督功能，且本公司之半數董事未兼任經理人。
- 3.每年度安排各董事參加證基會等外部機構專業董事課程，以增進董事會之運作效能。

二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金

(一)一般董事及獨立董事之酬金

113 年度 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(%)				有無來自子公司以外資酬金
		報酬 (A)	退職退 (B)	董事酬勞 (C)		業務執行 費用(D)		薪資、獎金及 特支費等(E)	退職退 (F)	員工酬勞 (G)(註1)			本公司	財務報 告內所 有公司
		本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	現金 金額	股票 金額	股票 金額	本公司	財務報 告內所 有公司
董事長	鄒嘉駿	—	—	2,387	2,387	30	30	10,734	—	—	—	—	13,151 4.15%	13,151 4.15%
董事	張文杰	—	—	2,387	2,387	30	30	9,941	—	—	—	—	12,358 3.90%	12,358 3.90%
董事	林芳隆	—	—	1,301	1,301	30	30	—	—	—	—	—	1,331 0.42%	1,331 0.42%
董事	葉惠德	—	—	1,256	1,256	30	30	—	—	—	—	—	1,286 0.41%	1,286 0.41%
獨立 董事	呂英誠	—	—	1,256	1,256	66	66	—	—	—	—	—	1,322 0.42%	1,322 0.42%
獨立 董事	丘邦翰	—	—	1,256	1,256	66	66	—	—	—	—	—	1,322 0.42%	1,322 0.42%
獨立 董事	蔡熊光	—	—	1,256	1,256	66	66	—	—	—	—	—	1,322 0.42%	1,322 0.42%

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：
本公司給付獨立董事酬金包含董事酬勞及車馬費。董事酬勞依本公司章程所訂，如有獲利提撥不高於百分之三為董事酬勞，其訂定之程序請參考註2說明，經董事會決議通過後提報股東會；車馬費係參考同業水準，依董事會出席董事會及隸屬董事會下之功能性委員會情況支付。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無此情形。

註1：依112年度實際取得員工酬勞比例原則計算113年度擬議分派金額。
註2：本公司給付董事酬金包含董事酬勞及車馬費。董事酬勞依本公司章程所訂，如有獲利提撥不高於百分之三為董事酬勞，其訂定之程序，除參考整體營運績效，並參酌各董事對本公司績效貢獻度，含對營運參與之程度及個別績效表現(包含公司核心價值之實現、董事職責之實踐、決策品質之提升及董事之專業與進修等)，經董事會決議通過後提報股東會；車馬費係參考同業水準，依董事會出席董事會及隸屬董事會下之功能性委員會情況支付。董事兼任員工之酬金包含薪資、獎金及員工酬勞，係依所擔任之職位、所承擔之責任及公司獲利狀況等因素，並考量對公司績效貢獻度及個別績效表現(包含公司目標及任務之掌握及內部關係經營與溝通等)，經薪資報酬委員會審核，董事會通過後執行。

(二)總經理及副總經理之酬金

113 年度 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資 (A)		退職退休金 (B)(註 1)		獎金及 特支費等(C)		員工酬勞金額(D)(註 2)			A、B、C 及 D 等 四項總額及占稅後 純益之比例(%)		有無領取 來自公 司以外轉 投資事業 酬金
		本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司 現金 金額	本公司 股票 金額	財務報告內 所有公司 現金 金額	本公司	財務報 告內所 有公司	
執行長	鄒嘉駿	11,981	11,981	—	—	8,694	8,694	—	—	—	20,675 6.53%	20,675 6.53%	
總經理	張文杰												

註 1：依 112 年度實際取得員工酬勞比例原則計算 113 年度擬議分派金額。

註 2：本公司業務部本部分管副總經理邱彥博、檢量技術部本部分管副總經理王人傑，係於 114 年 03 月 11 日就任，故未揭露 113 年度酬金資訊。

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元	—	—
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	—	—
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	—	—
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	—	—
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	張文杰	
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	鄒嘉駿	
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	—	—
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	—	—
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	—	—
100,000,000元以上	—	—
總計	2	2

(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113 年度 單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額(註)	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經 理 人	執行長兼任技術研發部副總經理	鄒嘉駿	—	—	—	—
	總經理兼任業務市場部副總經理	張文杰				
	技術研發部研發一處協理	徐敏堂				
	技術研發部研發二處協理	林伯聰				
	自動控制部協理	王人傑				
	業務市場部業務一處協理	邱彥博				
	行政財務部企劃處協理	蔡茂岳				
	行政財務部財會處經理	林慧盆				

註 1：依 112 年度實際取得員工酬勞比例原則計算 113 年度擬議分派金額。

(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

職稱	酬金總額占稅後純益比例(%)			
	113 年度		112 年度	
	本公司	合併報表 所有公司	本公司	合併報表 所有公司
董事	10.14	10.14	11.56	11.56
總經理及副總經理	6.53	6.53	7.31	7.31

依本公司公司章程第 29 條規定，依當年度獲利狀況扣除累積虧損後，如尚有盈餘應提撥員工酬勞百分之五~十五及董事酬勞不高於百分之三。本公司給付董事酬金，係授權董事會按同業通常水準議定之，並考量公司營運成果，參酌其對公司貢獻度，給予合理報酬；而個別董事酬勞及經理人之酬金給付程序，除參考整體營運績效，並參酌個別董事酬勞對本公司績效貢獻度，含對營運參與之程度及個別績效表現(包含公司核心價值之實現、董事職責之實踐、決策品質之提升及董事之專業與進修等)，經董事會決議通過後提報股東會；個別經理人之酬金包含薪資、獎金及員工酬勞，係依所擔任之職位、所承擔之責任及公司獲利狀況等因素，並考量對公司績效貢獻度及個別績效表現(包含公司目標及任務之掌握及內部關係經營與溝通等)，相關績效考核及年度薪資調整皆經薪酬委員會討論決議再送交董事會同意通過。本公司亦將視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度。

本公司 113 年度酬金總額占稅後純益比例較上年度下降，主係行政財務部副總林芳隆於 112 年 6 月 30 日退休，故 113 年度無相關薪資獎金所致，另因本公司 113 年度稅前淨利較 112 年度減少，本公司已考量當年度之績效及營運成果，故 113 年度之董事酬勞提列總金額較 112 年度減少，綜上所述本公司 113 年度董事、總經理及副總經理之酬金與其所負責公司營業責任與整體績效呈正相關。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

最近年度董事會開會 5 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 (列)席次數	委託出席 席次數	實際出席 (列)席率(%)	備註
董事長	鄒嘉駿	5	0	100%	
董事	張文杰	5	0	100%	
董事	林芳隆	5	0	100%	
董事	葉惠德	5	0	100%	
獨立董事	丘邦翰	5	0	100%	
獨立董事	呂英誠	5	0	100%	
獨立董事	蔡熊光	5	0	100%	

◎：親自出席；★：委託出席；*：未出席

113 年度	3 月 7 日	5 月 8 日	6 月 12 日	8 月 12 日	11 月 12 日
丘邦翰	◎	◎	◎	◎	◎
呂英誠	◎	◎	◎	◎	◎
蔡熊光	◎	◎	◎	◎	◎

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第14條之3所列事項：本公司設置審計委員會，故不適用。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形	備註
鄒嘉駿 張文杰	案由： 112 年度董事酬勞分配案。	與董事自身有利害關係	不參與表決	113 年第 1 次
鄒嘉駿 張文杰	案由： 本公司薪資報酬委員會 審議經理人 113 年度年終 獎金核發案。	與董事自身有利害關係	不參與表決	113 年第 5 次
鄒嘉駿 張文杰	案由： 本公司薪資報酬委員會 審議經理人 114 年度薪資 調整案。	與董事自身有利害關係	不參與表決	113 年第 5 次

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

(一)本公司於108年10月17日董事會通過「董事會績效評估辦法」，明訂每年應執行內部董事會績效評估，並應於次一年度第一季結束前完成，另董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

(二)本年度執行情形請詳下表，評估結果已於114年3月11日提報本公司董事會：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行一次	113年1月1日至113年12月31日	整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估(包含審計委員會、薪資報酬委員會)。	董事會內部自評、董事成員自評	1.董事會績效評估之衡量項目，包括下列五大面向： (1)對公司營運之參與程度。 (2)提升董事會決策品質。 (3)董事會組成與結構。 (4)董事的選任及持續進修。 (5)內部控制。 2.董事成員自我績效評估之衡量項目包括下列六大面向： (1)公司目標與任務之掌握。 (2)董事職責認知。 (3)對公司營運之參與程度。 (4)內部關係經營與溝通。 (5)董事之專業及持續進修。 (6)內部控制。 3.功能性委員會績效評估之衡量項目包括下列五大面向： (1)對公司營運之參與程度。 (2)功能性委員會職責認知。 (3)提升功能性委員會決策品質。 (4)功能性委員會組成及成員選任。 (5)內部控制。	1.整體董事會：評估結果為符合標準，顯示董事會有善盡管理及監督公司各項經營策略、重大業務及風險評估之責任，並能建立及監督內部控制制度之有效性，整體運作情形完善，尚符合公司治理之要求。 2.個別董事成員：評估結果為超越標準，顯示本公司董事對於各項指標之效率及效果皆為正向評價。 3.審計委員會：評估結果為超越標準，顯示審計委員會整體運作情形完善，尚符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。 4.薪資報酬委員會：評估結果為超越標準，顯示薪資報酬委員會整體運作情形完善，尚符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估

(一)加強董事會職能

- 1.本公司董事會之運作皆依董事會議事規範辦理。
- 2.本公司本屆董事係於112年6月16日選任，公司董事間均未具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- 3.本公司董事會成員於任期中參加上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點所指定機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之進修課程。
- 4.本公司由全體獨立董事組成審計委員會及薪資報酬委員會，藉以發揮監督職責，達到加強董事會職能之目標，各委員會主席並定期向董事會報告運作情形。
- 5.本公司113年度向國泰世紀產物保險股份有限公司投保美金8,000仟元之董事及經理人責任險。

(二)提昇資訊透明度等

- 1.本公司及子公司之財務報表，均委託安侯建業聯合會計師事務所定期查核簽證，對於法令所要求之各項資訊公開，均能正確及時完成，並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，建立發言人制度，以確保各項重大資訊能及時允當揭露
- 2.本公司所架設網站可連結至公開資訊觀測站，供股東及利害關係人參考公司財務業務相關資訊。

(二)審計委員會運作情形

本屆審計委員會委員任期為 112 年 6 月 16 日至 115 年 6 月 15 日，最近年度審計委員會開會 4 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 (列)席次數	委託出席 席次數	實際出席 (列)席率(%)	備註
獨立董事	丘邦翰	4	0	100%	
獨立董事	呂英誠	4	0	100%	
獨立董事	蔡熊光	4	0	100%	

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理：

(一)證券交易法第14條之5所列事項。

開會日期	議案內容	審計委員會 決議結果	公司對審計委員 會意見之處理
113/03/07	本公司112年度內部控制制度聲明書	委員會全體 成員照案通過	提請董事會決議
	本公司112年度財務報表案		
	本公司112年度營業報告書案		
	本公司112年度盈餘分派表案		
	資本公積發放現金案		
	辦理現金增資私募普通股票案		
	現金增資私募普通股票終止案		
	本公司預先核准簽證會計師事務所非確信服務政策之一般性原則案		
113/05/08	民國113年度第1季合併財務報告案		
113/08/12	民國113年度第2季合併財務報告案		
	本公司113年度會計師獨立性及適任性評估暨委任報酬案		
	取得使用權資產案		
	新增本公司永續報告書編制及確信作業程序案		
113/11/12	民國113年度第3季合併財務報告案		
	訂定民國114年度稽核計畫		
	本公司風險管理運作情形		

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等）：

本公司內部稽核主管定期向獨立董事呈報稽核報告；會計師不定期參與審計委員會就會計師查核事項、本公司財務狀況及近期重要法令之更新進行溝通，必要時獨立董事亦得隨時與會計師召集會議。除上所述，平時稽核主管及會計師亦得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已訂定「公司治理實務守則」，並揭露於公司網站。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		為確保股東權益，本公司設有專責人員妥善處理股東建議、疑義及糾紛事項，且建立發言人及代理發言人制度與投資關係，並設有投資人電子郵件信箱處理股東建議或意見等問題。	無重大差異
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		本公司設有股務專責人員，管理相關資訊並委任股務代理機構協助辦理股務相關事宜，以掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之變動情形。	無重大差異
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		本公司與關係企業間有財務、業務往來時，皆依「關係人相互間財務業務相關作業規範」及「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」規定辦理。	無重大差異
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	無重大差異
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		1.本公司訂有「公司治理實務守則」及「董事選任程序」，要求董事會成員組成應考量多元化，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於性別、年齡、國籍、文化、專業背景、技能及產業經歷。 2.本公司注重董事會成員多元化，現任7席董事中，學歷包含電機領域、企業管理領域及企業創新與創業管理領域等，	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務 守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
			其中每位董事的專業背景亦有不同。公司之多元化目標為：領域多元化，要求董事於專業知識與技能上應涵蓋四項以上，且至少一席董事具備財務會計能力，目前達成情形如下：於營運判斷、領導決策、經營管理且具產業知識者，有鄒嘉駿、張文杰、林芳隆、葉惠德、呂英誠及蔡熊光董事；張文杰董事亦具行銷經驗；邱邦翰及林芳隆董事則長於財務領域，據此，足表示目前董事於學歷與專長多元化及互補。 3.個別董事落實董事會成員多元化政策情形請參閱第6頁董事會多元化及獨立性說明。	
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？		✓	本公司目前僅依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，相關組織規程均經董事會決議通過，惟並未設置其他各類功能性委員會。	尚於評估設置其他功能性委員會之階段
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓		1.本公司於108年10月17日董事會通過「董事會績效評估辦法」，明訂每年應執行內部董事會績效評估，並應於次一年度第一季結束前完成，另董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。 2.本年度執行情形請參閱第13~14頁董事會運作情形，評估結果已於114年03月11日提報本公司董事會。	無重大差異
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		本公司每年定時檢視會計師之獨立性，並將結果提報113年8月12日審計委員會及113年8月12日董事會審議並通過。經本公司評估安侯建業聯合事務所林恒昇會計師及洪士剛會計師，皆符合本公司獨立性評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師，會計師並出具聲明函，詳細評估報告請參閱第36~37頁。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?	✓		本公司已於112年5月11日設置公司治理主管，提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等，及負責統籌公司治理相關事務推動與執行。	無重大差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	✓		本公司設有中、英文網站，建置相關公司治理、財務業務及股東專區等資訊並隨時更新揭露，提供利害關係人參考；並設置專責人員妥適回應利害關係人所關切之相關議題。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	✓		本公司委任元富證券(股)公司之股務代理機構協助辦理股東會事務。	無重大差異
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊?	✓		本公司已於公司網站之投資人服務專區揭露財務業務及公司治理相關資訊。	無重大差異
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?	✓		本公司設有中、英文網站，且設置發言人及代理發言人各一名，並由專人負責公司各類資訊之蒐集及揭露，並適時更新於公司網站。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？		✓	本公司於法定限期內公告並申報年度財務報告，並於規定限期前公告申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。	無重大差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?	✓		(一)員工權益與僱員關懷： 本公司向來秉持穩健、永續之經營理念，對員工福利極其重視，每月依法提撥福利金，安排各項促進員工身心健康之活動，如員工聚餐、年度健康檢查、旅遊經費補助、提供婚喪喜慶慰助金、團體壽險及意外險等福利事項。另本公司依據勞動基準法之規定訂定員工退休辦法，組成勞工退休準備金監督委員會，依每月薪資總額一定比率提撥勞工退休準備金儲存於台灣銀行專戶中，以充作未來支付職工退休準備金之用。依勞工退休金條例，自94年7月1日起，每月按不低於薪資之6%提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶，員工退休金之支付依員工個人之退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。本公司有關勞資關係之一切規定措施，均依相關法令，實施情形良好。 (二)投資者關係： 本公司秉持公平公開原則對待所有股東，在股東會方面，每年依公司法及相關法令之規定召集股東會，鼓勵股東積極參與股東會之董事選舉或修改公司章程等議案，並將取得處分資產、背書保證等重大財務業務行為提報股東會，本公司亦給予股東充分發問或提案之機會，俾達制衡之效並依法訂定股東會議事規則，妥善保存股東會議事錄及於公開資訊觀測站上充分揭露相關資料。另本公司為確保股東對公司重大事項享有充分知悉、參	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
			與及決定等權利，設有發言人及代理發言人職務，妥善處理股東建議、疑義及糾紛事項。 本公司自93年度公開發行及96年股票上櫃以來，本著資訊公開原則，依公開發行公司應公告或申報事項一覽表及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序有關資訊揭露之規定辦理資訊公開事宜，並建立公開資訊之網路申報作業，指定財會處專門人員負責公司資訊之蒐集及揭露工作，經相關權責主管審核確認後，辦理相關資訊公告申報事宜，及時提供各項可能影響投資人決策之資訊。 (三)供應商關係： 本公司與供應商之關係良好，亦不定期對供應商進行評鑑，以確保其品質。 (四)利害關係人之權利： 本公司對於往來銀行定期提供財務資訊，以利往來銀行對本公司之融資作出判斷及進行決策。本公司與關係企業間並無共同使用貸款額度，且已訂定「關係人、特定公司及集團企業交易作業辦法」，並經董事會通過。 (五)董事進修之情形： 本公司董事均依規定進修與公司治理主題相關課程。113年度董事進修情形請參閱第36頁董事進修之情形。 (六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司內部控制制度及必要之管理規章皆經董事會或股東會決議。 (七)客戶政策之執行情形： 與客戶溝通之情形良好，且本公司有專業客服人員可適時機動性將客戶提出之需求予以滿足，故產品已有良好迅速之售後維護服務，且內控中設有完善之客訴處理作業。 (八)公司為董事購買責任保險之情形： 本公司於94年5月12日經股東常會決	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			議通過將購買董監責任險納入公司章程，113年度係向國泰世紀產物保險股份有限公司投保美金8,000仟元之董事及經理人責任險。 (九)資訊安全風險管理： 為提升公司資訊安全管理，已於資管處下設置資安課，負責制定資安治理政策，監督資安管理運作情形，並定期向管理階層報告資安治理情況。 於資安風險控管上，本公司已建立並落實資訊安全管理系統，訂定資訊安全政策規範公司資訊安全相關作業，同時每年定期進行資訊安全風險評估及資訊安全稽核作業，以確保管理有效性並符合法令規範，故資安風險非屬本公司重大營運風險，暫無投保資安險之需求。	
九、請就台灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 本公司於民國113年第十一屆公司治理評鑑中，排名列在36%至50%內，顯示本公司對於各項公司治理機制之重視。針對本公司部分尚未得分項目，將於114年度陸續執行，以期符合公司治理精神。				

(四)薪資報酬委員會組成及運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料

條件 身分別 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司薪資報酬委員 會成員家數
召集人 獨立董事 呂英誠	請參閱第6頁附表一董事資料「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」表格		無
獨立董事 丘邦翰			無
獨立董事 蔡熊光			無

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

- (1)組成：本公司於100年12月26日由董事會通過設置薪酬委員會，其成員由董事會決議委任之，委員計三人，均為本公司獨立董事，相關人選資格皆符合法令規定之規範。
- (2)職責：主要職責如下，並將所提建議提交董事會討論。

A.訂定並定期檢討董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

B.定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

(3)運作情形

本屆薪酬委員會委員任期為 112 年 6 月 16 日至 115 年 6 月 15 日，最近年度已開會 2 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	呂英誠	2	0	100%	
委員	丘邦翰	2	0	100%	
委員	蔡熊光	2	0	100%	

其他應記載事項：

一、最近年度薪資報酬委員會討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理

薪資報酬委員會日期	薪資報酬委員會期別	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員意見之處理
113/03/07	113年第1次	112年度員工及董事酬勞案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
		112年度董事酬勞分配案		
113/11/12	113年第2次	本公司經理人113年度年終獎金核發案		
		本公司經理人114年度薪資調整案		

二、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情事。

三、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情事。

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		本公司為有效推動企業永續發展，由行政財務部兼職統籌本公司推動永續發展作業，就企業永續發展重大性原則，進行重要議題之相關評估，依據評估後之結果，訂定策略及目標，並每年定期向董事會報告推動成果，由董事會評估政策及執行情形是否符合目標，並至少一年一次向董事會報告執行成果(於113年11月12日向董事會報告)，由董事會監督及審視公司執行情形是否符合目標。	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因													
	是	否	摘要說明														
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		本公司風險評估邊界包含本公司、由田信息技術(上海)有限公司及其他子公司。本公司秉持在追求企業永續發展與獲利的同時，持續推動企業永續發展，重視利害關係人之權益，注重環境、社會與公司治理之議題，並依照重大性原則，進行重要議題之相關風險評估，訂定相關風險管理政策或策略如下： <table><thead><tr><th>重大議題</th><th>風險評估項目</th><th>風險管理政策或策略</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">治理面向</td><td>資訊安全</td><td>已於 2022 年11 月取得資訊安全管理系統國際標準 ISO/IEC 27001：2013 驗證，每三年會執行證書重新驗證的程序，目前證書有效期到 2025 年 10 月 31 日。</td></tr><tr><td>創新管理</td><td>為保護公司營運自由、強化產業領導地位，並維護先進技術成果，截至2024年底，本公司全球專利申請總數已累計975件，全球專利核准數已累計536件，加強保護智慧財產權。</td></tr><tr><td>法規遵循</td><td>2023年3月新增「法規鑑別管理程序」辦法，開始定期評估公司制度規章的適法性，已於2024年6月及12月完成法規鑑別程序。</td></tr><tr><td>環境面向</td><td>永續供應鏈管理</td><td>制定「供應商企業社會責任承諾書」，由供應商夥伴閱讀、瞭解並簽署確認，回收率已達91%。承諾書內容包括誠信經營、勞工權益與人權、健康安全、環境保護等四個面向，期與供應鏈合作夥伴共同</td></tr></tbody></table>	重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略	治理面向	資訊安全	已於 2022 年11 月取得資訊安全管理系統國際標準 ISO/IEC 27001：2013 驗證，每三年會執行證書重新驗證的程序，目前證書有效期到 2025 年 10 月 31 日。	創新管理	為保護公司營運自由、強化產業領導地位，並維護先進技術成果，截至2024年底，本公司全球專利申請總數已累計975件，全球專利核准數已累計536件，加強保護智慧財產權。	法規遵循	2023年3月新增「法規鑑別管理程序」辦法，開始定期評估公司制度規章的適法性，已於2024年6月及12月完成法規鑑別程序。	環境面向	永續供應鏈管理	制定「供應商企業社會責任承諾書」，由供應商夥伴閱讀、瞭解並簽署確認，回收率已達91%。承諾書內容包括誠信經營、勞工權益與人權、健康安全、環境保護等四個面向，期與供應鏈合作夥伴共同	無重大差異
重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略															
治理面向	資訊安全	已於 2022 年11 月取得資訊安全管理系統國際標準 ISO/IEC 27001：2013 驗證，每三年會執行證書重新驗證的程序，目前證書有效期到 2025 年 10 月 31 日。															
	創新管理	為保護公司營運自由、強化產業領導地位，並維護先進技術成果，截至2024年底，本公司全球專利申請總數已累計975件，全球專利核准數已累計536件，加強保護智慧財產權。															
	法規遵循	2023年3月新增「法規鑑別管理程序」辦法，開始定期評估公司制度規章的適法性，已於2024年6月及12月完成法規鑑別程序。															
環境面向	永續供應鏈管理	制定「供應商企業社會責任承諾書」，由供應商夥伴閱讀、瞭解並簽署確認，回收率已達91%。承諾書內容包括誠信經營、勞工權益與人權、健康安全、環境保護等四個面向，期與供應鏈合作夥伴共同															

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
				成長，建立永續夥伴關係，一同致力於企業社會責任之落實。
			氣候與能源	1.依據本公司盤查及查證時程規劃，本公司預計於2024年12月底前完成溫室氣體盤查專(兼)職單位人員之設置，本年度已有派遣同仁前往第三輔導機構參與課程，預先儲備人員能力，此舉除了能讓自行盤查的數據更加準確外，也預對未來的第三方輔導盤查、查證進行接軌。 2.本公司中和9及10樓辦公空間如全面更換LED燈具設備，將可降低34.4%之用電度數，已取得廠商報價，後續評估是否更換燈具。
			社會面向	1.提供社團費用補助，鼓勵同仁參與社團活動，透過正當休閒活動來促進同仁身心健康及彼此情誼，本年新增露營社，與原有社團親山社、羽球社、高爾夫球社皆在持續運作中。 2.設立健身房以及每週2堂有氧課程，除可增進員工身心健立，亦可改善工作壓力、聯絡員工感情，經常運動有助於提高專注力和工作效率
			人才發展	本年度訓練課程反應評估實體課程及線上課程得分均為4.6(滿分5.0)。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			人權 優於法令的友善制度：平日工時為七小時；工作滿一年，每年給予七日公司假；媽媽彈性工時。	
			職業安全與衛生 1.依勞工健康保護規則，雇主對在職勞工，應依規定期限，定期實施一般健康檢查；目前公司更優於勞工健康保護規則，於每年對在職員工進行健康檢查管理。 2.依消防法及其施行細則，對所屬辦公處所依期限每年進行辦公處所環境之消防檢查並向消防隊進行申報；滅火器數量雙倍優於法規，每半年之自衛消防編組演練提升為每季演練。 3.為確保同仁作業環境品質，委託合格作業環境測定廠商，定期進行環境照度、空氣品質檢測。	
			社會參與 1.贊助樹林區體育會主辦之「2024兒童樂活一夏」活動，推廣兒童體育夏令營，將專業技能薪火相傳，延續體育人才培育計畫，推展健康的運動休閒，加強年輕學子體能、專業與團結力。 2.贊助由中部八所大學院校聯合舉辦的「2024永續智慧創新黑客松」競賽由學生提出創意方案，期待能優化產業的經營管理與服務創新，並攜	

推動項目	執行情形					與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明			
					手打造友善共好的社會。 3.捐款予「財團法人台北市整合心臟醫學基金會」，該基金會主要協助心臟醫學研究、專案獎助心臟內外科醫療人員出國進修與國際交流，使台灣在心臟外科學術與技術更為精進，以期未來能嘉惠更多病患	
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		本公司現各廠處所已全面進行一般事業廢棄物委由專業環保公司回收與處理及持續推行資源類垃圾分類、回收再利用政策，推廣辦公室二次利用廢紙影印，並向員工宣導節約用水用電之生活習慣，以期資源再利用與垃圾不造成二次汙染與資源浪費措施。			本公司主要為機械設備組裝及測試，未產生有害物質及廢水，故僅推動左列事項，並無通過國際相關驗證標準，應與永續發展實務守則無重大差異。
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		本公司採取多項措施降低對環境之衝擊，例如：照明設備改用節能燈管、減少燈管數量、隨手關閉未使用電源、控制空調溫度、廢紙回收、垃圾分類、降低廢棄物量，針對生產過程中產生之餘料或存貨中之呆滯料件，皆會不定期評估並進行活化提升利用率，以線上文件取代紙質，以達成提升能源使用效率的目標及降低對環境負荷。			無重大差異
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	✓		潛在風險及結果	機會	因應措施	無重大差異
			碳排總量與碳交易、碳費及碳稅制度將增加公司營運成本。	參與碳/再生能源交易	1.密切注意相關法令。	
			1.衝擊生產作業，影響交貨。 2.廠房及設備損壞致營運成本增加。	提升天災防禦能力	1.啟動天災預應機制。 2.廠區已設有抽水機及防洪池，可降低廠區淹水	

推動項目	執行情形				與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																									
	是	否	摘要說明																											
			用電量上升致營運成本及碳排放量增加。	推動使用節能產品	廠區增設風扇，加強循環及降溫效率，減少能源使用及碳排放量。																									
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		(1)最近2年度溫室氣體排放量(範疇二)： <table><tr><td></td><td>112年</td><td>113年</td><td>變動%</td></tr><tr><td>二氧化碳排放量(噸)</td><td>768</td><td>678</td><td>-12%</td></tr></table> (2)最近2年度用水量： <table><tr><td></td><td>112年</td><td>113年</td><td>變動%</td></tr><tr><td>用水量(度)</td><td>9,961</td><td>9,360</td><td>-6%</td></tr></table> (3)最近2年度廢棄物總重量： <table><tr><td></td><td>112年</td><td>113年</td><td>變動%</td></tr><tr><td>一般事業廢棄物(公斤)</td><td>15,500</td><td>11,500</td><td>-26%</td></tr></table> 本公司主要為機械設備組裝及測試，僅產生一般廢棄物，公司統計範疇二溫室氣體排放量及用水量進行統計，面對氣候變遷本公司在環保及節能上已建立具體政策、目標、措施及成效，本公司以109年為碳排放量為基準年，目標119年碳排放量較109年降低10%，措施主係空調及照明節能的管理及優化，並推動無紙化。				112年	113年	變動%	二氧化碳排放量(噸)	768	678	-12%		112年	113年	變動%	用水量(度)	9,961	9,360	-6%		112年	113年	變動%	一般事業廢棄物(公斤)	15,500	11,500	-26%	本公司依上市櫃公司永續發展路徑圖之規劃，屬第三階段(115年度)適用對象，故雖尚未完成左列各項資訊之驗證情形，應與永續發展實務守則無重大差異。
	112年	113年	變動%																											
二氧化碳排放量(噸)	768	678	-12%																											
	112年	113年	變動%																											
用水量(度)	9,961	9,360	-6%																											
	112年	113年	變動%																											
一般事業廢棄物(公斤)	15,500	11,500	-26%																											
四、社會議題 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		本公司秉持著尊重人權的精神，遵守國際人權公約相關規範，致力於創造員工福祉： 1.公平晉用：確保員工在招募、任用及晉升等僱用過程不受歧視對待。 2.禁用童工：公司遵守勞動基準法規定，不僱用15歲以下之勞動者。 3.性騷擾防治：公開揭示設有性騷擾防治措施、申訴及懲戒準則，並設置申訴專線及專用電子郵箱。 4.縮短工時：本公司平日工時為七小時，優於勞動基準法的八小時。 5.退休制度：依勞動法規規定保障員工之合法權益，並提例退休金。			無重大差異																								

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		1.本公司秉持與員工利潤共享的理念，吸引、培育與員工利潤共享之理念，薪資報酬結合員工績效考核制度與經營績效，本公司112年度非擔任主管職務之全時員工「薪資中位數」為新台幣94萬元，占全體上市櫃公司前22%。 2.本公司重視員工的身心健康與福利，提供完善的多元化福利措施，例如：每日上班工時7小時、每日午休1.5小時、工作滿一年享有 7天公司假、年度旅遊補助金、喜慶婚喪生育禮金、員工生日禮券、私車公用損害補償、各類社團活動及社團補助、每季部門員工聚餐、年度健康檢查、員工半日遊等。 3.本公司於人力資源結構方面，於113年底員工總數為393人，其中經理人共24人，一般員工369人，男性員工330人，女性員工63人，另本公司致力提供身心，另本公司致力提供身心障礙人士就業機會，共進用2名身心障礙者，符合相關規定。	無重大差異
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		本公司提供員工一個整潔的環境，並提供員工安全與健康上所需之安全防護設備，定期辦理員工健康檢查並定期對員工實施安全與健康教育。 本公司實施措施簡述如下： 1.員工所處場所之安全檢查之保護措施：依建築法及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法對辦公處所廠區進行建築物公共安全檢查，期使辦公場所為合法安全無虞場所。 2.員工身體健康保護措施：依勞工健康保護規則，於每年對所屬員工及承攬商進行法定項目之勞工在職健康檢查管理。 3.辦公處所及製造廠區之消防安全保護措施：依消防法及其施行細則，對所屬辦公處所依期限每年進行辦公處所環境之消防檢查並向消防隊進行申報。 4.本公司今年未有火災案件，同時對於員工於發生火災及災害之應變措施及訓練：依消防法每年兩次進行員工自衛消	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			防演練及急救訓練，俾使員工有良好救災及應變能力。 5.員工辦公處所之電力及用電安全措施：依職業安全衛生法，定期委託專業電器顧問公司進行電器技術人員執照之取得及進行每月電氣設備安全檢查，以確保員工辦公處所用電安全。 6.員工安全衛生教育訓練之培訓及保護措施：依勞工安全衛生教育訓練規則，規定新進同仁接受安全衛生教育訓練，以確保同仁進入公司後可以有足夠安全衛生知識以其防止職業災害發生。 7.製造廠區使用危險性機械設備之合格操操作人員派訓：為使同仁合法並安全使用及操作廠區之吊掛設備，規定須先派至合格勞工安全衛生訓練單位受訓，並參加考試取得證照才可以操作以確保同仁工作安全。 8.辦公環境之作業場所定期實施消毒。 9.本公司113年度未有職災案件，本公司重申公司職業安全重要性，立即協助送醫並啟動主管關懷注意同仁身心狀態。 10.本公司113年度內未發生任何火災事故，因此火災之件數、死傷人數均為零，死傷人數占員工總人數比率亦為0%。雖無實際火災事故發生，惟本公司仍持續強化消防安全管理，以降低火災風險並保障員工安全。	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		本公司以全面提升員工專業技能、工作效率及產品品質為目標，制定年度教育訓練計劃，並依核心、管理、專業職能模組，在兼顧公司發展及同仁滿足的需求下，分別展開標準化、階層別與部門別之訓練課程。113年度教育訓練共計完成795人次，總時數為1,682小時。	無重大差異
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		本公司配置多名客服人員進行售後服務，與客戶間保持良好之溝通管道，維護消費者權益並對產品與服務提供有效之客訴處理程序。	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		公司已訂定「採購及供應商管理辦法」，不定期對供應商進行評鑑，並要求供應商承諾所提供之所有產品、零件、材料及其附屬物之物質需符合環保標準之規定，並同意遵守包括勞工安全衛生在內之所有法律法規，若違反以上條款，本公司得解除或終止相關之採購合約或訂單。 本公司於第一次進貨後一個月內，依廠商營業性質，進行廠商評核；每年三月以廠商評核報告表中所列項目逐項評核，定期評核項目就其價格競爭力、交貨狀況、品質及服務態度等依其評核內容給予評核等級。 本公司制定「供應商企業社會責任承諾書」，由供應商夥伴閱讀、瞭解並簽署確認。承諾書內容包括誠信經營、勞工權益與人權、健康安全、環境保護等四個面向，期與供應鏈合作夥伴共同成長，建立永續夥伴關係，一同致力於企業社會責任之落實。	無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		✓	本公司為自動視覺檢測設備商，主為機械設備組裝及測試，製造過程未產生工業廢氣及工業汙水排放等高汙染環境之情形，故不適用ISO140001認證。	本公司將視實際需求研議辦理
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展實務守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司於105年11月由董事會通過訂立「企業社會責任實務守則」，並於111年3月更名為「永續發展實務守則」，有關永續發展之運作，悉依該實務守則之內涵與相關規定辦理，並確實遵循。 七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 本公司自成立以來，守法守分並重視公司所應負擔之永續發展推動，目前本公司推動永續發展情形如下： (一)營運績效方面 本公司為落實公司治理，建立有效之內部控制制度，設有獨立董事，借重獨立董事之專業經驗，增加經營團隊之實務經驗，訂定董事會議事規則以及投保董事責任險，以強化董事會職能。而為保障股東權益及提昇資訊透明度，本公司設置發言人及代理發言人，及時公開公司各項重大資訊，並由專人負責處理與股東之溝通事宜。此外，本公司專注於自動光學檢測設備產品研發、生產製程改善及拓展銷售國內外客戶，努力創造股東價值。另外，本公司專注產品品質，以提高顧客滿意度為目標，所生產之產品均依相關作業程序及辦法來進行生產，提供客戶				

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
安全、可信賴及高品質之產品。銷售之產品均經過客戶驗證，並於售後提供客戶保固及維護服務。				
(二)環境保護				
本公司產品製造過程中無產生有害事業廢棄物、廢有機溶劑，確保環境績效能符合環保法令承諾持續改善與污染預防，另外本公司於94年10月亦已回覆經濟部RoHS服務團相關問卷、產品現況及外銷情形，經經濟部RoHS服務團判定無涉及歐盟環保指令（RoHS）相關規範。此外，本公司由過去消極被動遵守環保法令的態度，改變為積極主動的降低環境衝擊、節能減廢、增進環境績效等環境自覺理念，確保其環境績效能符合環保法令及承諾持續改善與污染預防，且本公司亦推行資源回收及分類，降低耗電量，為維護地球環境盡一份心力，達成企業永續經營，環境永續發展，使經濟發展與環境保護獲得雙贏之目標。				
(三)社會服務方面				
1.在就業聘雇方面，本公司提供多種職缺，進用身心障礙且具有能力者數人。				
2.於文化發展方面，將部門半日遊的主題訂為藝文之旅，規劃各部門到不同藝文類型的場館參觀，以行動支持國內文化發展，並啟發同仁創意與創新能力。				
3.贊助樹林區體育會主辦之「2024兒童樂活一夏」活動，推廣兒童體育夏令營，將專業技能薪火相傳，延續體育人才培育計畫，推展健康的運動休閒，加強年輕學子體能、專業與團結力。				

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		本公司訂有「公司誠信經營守則」，於內部管理及外部商業活動中確實執行；另本公司之「董事會議事規範」，亦載明董事利益迴避制度，對董事會所討論之議案，如涉有其自身或其代表法人利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有損及公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。	無重大差異
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓		本公司訂有「公司誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，已針對較高之不誠信行為所產生之風險，訂定相關防範措施。	無重大差異
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓		本公司訂有員工「工作規則」，載明員工不得利用職權謀取不法利益，及接受招待、餽贈、收受回扣、侵佔公款或其他不法利益，以杜絕不誠信行為影響商業關係或交易行為。	無重大差異
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	✓		本公司遵循公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		本公司於109年8月成立隸屬董事會之專責單位，由企劃處、人資處、財會處與法務等單位主管共同組成「誠信經營推動小組」，並由行政財務部副總經理擔任召集人，協助董事會及管理階層制定及監督執行誠信經營政策與防範方案，以確保誠信經營守則之落實，且每年至少一次向董事會報告推動誠信經營之計畫及執行情形。	無重大差異
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		員工之意見可透過多重管道與管理階層或是人資單位反映。定期與員工訓練及溝通，於防範不誠信行為之同時，保障員工權益。	無重大差異
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		本公司訂有「公司誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，作為落實誠信經營之依據。並為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員並定期查核前項制度遵循情形。	無重大差異
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		公司不定期舉辦新人訓練，宣導誠信經營觀念，使同仁清楚瞭解誠信經營理念與規範。	無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		公司訂有「員工獎懲辦法」，可透過多重管道與管理階層或是人資單位檢舉，公司方經由受理、調查、申訴、審議等程序執行懲戒。藉由建立良好之公司治理、風險控管機制及完善之內部規章，防範不誠信行為之發生，以創造公司永續發展之經營環境。	無重大差異
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		本公司訂有「違反誠信經營守則檢舉辦法」，載明本公司受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施?	✓		本公司訂有「違反誠信經營守則檢舉辦法」，載明本公司保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施。	無重大差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效?	✓		已於公司網站架設「公司治理」專區，並於該項下設置「誠信經營」專區，揭露誠信經營相關資訊情形。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司為建立良好商業運作及誠信企業文化，訂有「公司誠信經營守則」，明訂董事、經理人、受僱人或具有實質控制能力者，於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益。 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形): 本公司將隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，據以檢討改進公司誠信經營政策，以提昇公司誠信經營之成效。				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露：無。

(八)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1.內部控制聲明書：請至公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>

內控聲明書公告查詢<<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>>。

2.委託會計師專案審查內部控制者，應揭露會計師審查報告：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1.113 年度股東常會議事錄詳見第 95~99 頁。

2.113 年度至年報刊印日止股東會重要決議

股東會日期	重要決議
113/06-12 (股東常會)	1.承認本公司 112 年度決算表冊案 執行情形：已按決議執行 2.承認本公司 112 年度盈餘分派案 執行情形：已按決議執行，訂定 112 年 9 月 8 日為分配基準日，並於 112 年 9 月 28 日全數發放完畢 3.本公司辦理現金增資私募普通股票案 執行情形：已於 113 年 3 月 7 日董事會決議通過於剩餘期間內不繼續辦理

3.113 年度至年報刊印日止董事會重要決議

董事會日期	重要決議
113/03/07	1.本公司 113 年度合併損益表預算案 2.本公司 112 年度內部控制制度聲明書 3.112 年度員工及董事酬勞案 4.112 年度董事酬勞分配案 5.本公司 112 年度財務報表案 6.本公司 112 年度營業報告書案 7.本公司 112 年度盈餘分派表案

董事會日期	重要決議
	8.資本公積發放現金案 9.辦理現金增資私募普通股案 10.現金增資私募普通股終止案 11.召開本公司 113 年度股東常會 12.本次股東會受理股東之提案期間及其受理處所案 13.本公司截至 112 年 12 月 31 日新增應收帳款逾期三個月案 14.本公司預先核准簽證會計師事務所非確信服務政策之一般性原則案 15.修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案
113/05/08	1.民國 113 年度第 1 季合併財務報告案。 2.本公司截至 113 年 3 月 31 日新增應收帳款逾期三個月案。 3.追認新光銀行額度案。 4.追認玉山銀行額度案。 5.申請星展(台灣)商業銀行額度案。
113/06/12	1.配發現金股息及資本公積之配息基準日案。 2.追認銀行額度案。
113/08/12	1.民國 113 年度第 2 季合併財務報告案。 2.本公司 113 年度會計師獨立性及適任性評估暨委任報酬案。 3.本公司截至 113 年 6 月 30 日新增應收帳款逾期三個月案。 4.取得使用權資產案。 5.新增本公司「永續報告書編制及確信作業程序」案。 6.追認銀行額度案。
113/11/12	1.民國 113 年度第 3 季合併財務報告案。 2.申請中國輸出入銀行額度案。 3.申請台北富邦銀行額度案。 4.申請元大商業銀行額度案。 5.訂定民國 114 年度稽核計畫。 6.本公司截至 113 年 9 月 30 日新增應收帳款逾期三個月案。 7.本公司薪資報酬委員會審議經理人 113 年度年終獎金核發案。 8.本公司薪資報酬委員會審議經理人 114 年度薪資調整案。
114/03/11	1.本公司 114 年度合併損益表預算案。 2.公司 113 年度內部控制制度聲明書。 3.113 年度員工及董事酬勞案。 4.113 年度董事酬勞分配案。 5.經理人晉升任用案。 6.新任經理人 114 年薪資範圍案。 7.本公司 113 年度財務報表案。 8.本公司 113 年度營業報告書案。 9.本公司 113 年度盈餘分派表案。 10.資本公積發放現金案。 11.修訂本公司「公司章程」案。 12.修訂本公司「薪工循環」案。 13.113 年度基層員工範圍及員工酬勞分配比例案。 14.修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 15.修訂本公司「董事會議事規範」案。

董事會日期	重要決議
	16.增額補選獨立董事案。 17.新任獨立董事競業禁止解除案。 18.本次股東會受理獨立董事候選人之提名、股東之提案方式、提案期間及其受理處所案。 19.召開本公司 114 年度股東常會。 20.本公司截至 113 年 12 月 31 日新增應收帳款逾期三個月案。 21.本公司預先核准簽證會計師事務所非確信服務政策之一般性原則案。 22.本公司配合簽證會計師事務所內部調整更換會計師。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無此情事。

(十一)董事進修之情形

職稱	姓名	課程名稱	時數	日期
董事長	鄒嘉駿	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	113/07/03
董事	張文杰	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	113/07/03
董事	林芳隆	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	113/07/03
董事	葉惠德	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	113/07/03
獨立董事	呂英誠	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	113/07/03
獨立董事	丘邦翰	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	113/07/03
獨立董事	蔡熊光	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	113/07/03

(十二)會計師獨立性及適任性評估報告

- 1.簽證會計師事務所：安侯建業聯合會計師事務所
- 2.簽證會計師：林恒昇會計師及洪士剛會計師
- 3.評估日期：113 年 8 月
- 4.獨立性評估內容：

評估項目	評估結果	符合獨立性
簽證會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係	否	是
簽證會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為	否	是
簽證會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係	否	是
簽證會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務	否	是
簽證會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目	否	是
簽證會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券	否	是
簽證會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突	否	是
簽證會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係	否	是

5.適任性評估內容：

評估項目	評估結果	符合適任性
是否如期完成本公司各期財務簽證	是	是
是否如期完成轉投資公司各期財務查核	是	是
是否不定期提供本公司財務、稅務諮詢服務	是	是

6.評估結果

依據上述獨立性及適任性之評估結果，簽證會計師與本公司並無其他財務利益及業務關係，林恒昇會計師及洪士剛會計師與本公司具獨立性，對於提供本公司各項財務、稅務諮詢及簽證，尚稱及時、允當。

四、簽證會計師公費資訊

單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
安侯建業聯合會計師事務所	林恒昇	113.01~113.12	2,100	630	2,730	(註)
	洪士剛	113.01~113.12				

註：上述所稱審計公費係指公司給付簽證會計師有關財務報告查核、核閱、複核及財務預測核閱之公費。本年度給付非審計公費共計 630 仟元，其中 600 仟元為稅務簽證費用，30 仟元係為複核本公司非擔任主管職務之全時員工薪資資訊檢查表之服務工作酬金。

(一)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情事。

(二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情事。

五、更換會計師資訊：

(一)關於前任會計師

更換日期	112年03月15日		
更換原因及說明	配合會計師事務所內部調整		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人	會計師	委任人
	情況		
	主動終止委任	✓	
	不再接受(繼續)委任		
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	不適用		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其他
	無	✓	
說明			
其他揭露事項(本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	不適用		

更換日期	114年03月11日		
更換原因及說明	配合會計師事務所內部調整		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人	會計師	委任人
	情況		
	主動終止委任	✓	
	不再接受(繼續)委任		
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	不適用		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其他
	無	✓	
	說明		
其他揭露事項(本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	不適用		

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	安侯建業聯合會計師事務所
會計師姓名	林恒昇、洪士剛
委任之日期	112年03月15日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

事務所名稱	安侯建業聯合會計師事務所
會計師姓名	楊樹芝、洪士剛
委任之日期	114年03月11日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無此情事。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事、經理人及持股比例超過 10%之股東股權變動及質押情形

職稱	姓名	113 年度		114 年度截至 4 月 27 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長暨經理人	鄒嘉駿	—	—	—	—
董事暨經理人	張文杰	—	—	—	—
董事	林芳隆	(11,000)	—	—	—
董事	葉惠德	—	—	—	—
獨立董事	呂英誠	—	—	—	—
獨立董事	丘邦翰	—	—	—	—
獨立董事	蔡熊光	—	—	—	—

職稱	姓名	113 年度		114 年度截至 4 月 27 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
經理人	林伯聰	(10,000)	—	—	—
經理人	邱彥博	—	—	—	—
經理人	王人傑	—	—	—	—
經理人	徐敏堂	(2,000)	—	—	—
經理人	蔡茂岳	(4,000)	—	—	—
經理人	葉丁源(註)				
經理人	廖佐華(註)				
經理人	陳健銘(註)				
經理人	林慧盆	—	—	1,000	—

(註)本公司新任經理人於 114/3/11 新就任故無前期持股資訊。

(二)股權移轉或質押之相對人為關係人者：無此情事。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

114 年 4 月 27 日

姓名		本人持有股份		配偶、未成年 子女持有股份		利用他人名義合 計持有股份		前十大股東相互間 具有關係人或為配 偶、二親等以內之親 屬關係者，其名稱或 姓名及關係	
		股數	持股 比率%	股數	持股 比率%	股數	持股 比率%	名稱 (或姓名)	關係
台新人壽保險股份 有限公司		1,800,000	3.00						
匯豐託管坎布里亞 新興股東收益 ETF		1,620,603	2.70	—	—	—	—	—	—
鄒嘉駿		1,112,881	1.85	417,009	0.69	1,004,000	1.67	瑞泉文嘉股 份有限公司	代表人為 同一人
葉惠德		1,016,151	1.69	—	—	—	—	—	—
曾繼輝		1,005,000	1.67	—	—	—	—	—	—
瑞泉文嘉 股份有限 公司	法人	1,004,000	1.67	—	—	—	—	鄒嘉駿	代表人為 同一人
	代表人 鄒嘉駿	1,112,881	1.85	417,009	0.69	1,004,000	1.67	—	—
三葉股份 有限公司	法人	890,000	1.48	—	—	—	—	—	—
	代表人 葉丁源	50,640	0.08	—	—	—	—	—	—
林芳隆		834,207	1.39	23,821	0.03	700,000	1.16	隆華群資投 資股份有限 公司	代表人為 其配偶
隆華群資 投資股份 有限公司	法人	800,000	1.33	—	—	—	—	林芳隆	代表人為 其配偶
	代表人 劉素華	23,821	0.03	834,207	1.39	—	—	林芳隆	配偶
張文杰		724,616	1.21	—	—	600,000	1.00	佳越投資股 份有限公司	代表人為 其配偶

九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，
並合併計算綜合持股比例

113 年 12 月 31 日 單位：股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、經理人及直接或 間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例 %	股數	持股比例 %	股數	持股比例 %
Utechzone Global Corp.	12,313,816	100.00	—	—	12,313,816	100.00
科吉凱亞(股)公司	10,500,000	100.00	—	—	10,500,000	100.00
宙福投資(股)公司	500,000	100.00	—	—	500,000	100.00

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	59,850,750股	60,149,250股	120,000,000股	上櫃公司股票

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其他
8809	10	2,500	25,000	2,500	25,000	現增 12,695 仟元	無	註 1
8903	10	5,050	50,500	5,050	50,500	現增 25,500 仟元	無	註 2
9005	10	14,000	140,000	7,500	75,000	現增 15,752 仟元 盈轉 7,485 仟元 資轉 1,263 仟元	無	註 3
9103	12	14,000	140,000	10,500	105,000	現增 30,000 仟元	無	註 4
9409	12	40,000	400,000	18,907	189,070	認股權轉換 4,070 仟元	無	註 5
	10					盈轉 76,707 仟元		註 6
	10					資轉 3,293 仟元		
9508	6.9	40,000	400,000	27,861.2	278,612	認股權轉換 1,992 仟元	無	註 7
	10					盈轉 87,550 仟元		註 8
9512	100	40,000	400,000	32,661.2	326,612	現增 48,000 仟元	無	註 9
9608	4.7	80,000	800,000	44,363.5	443,635	認股權轉換 1,565 仟元	無	註 10
	10					盈轉 115,458 仟元		註 11
9612	35	80,000	800,000	50,278.5	502,785	現增 59,150 仟元	無	註 12
9709	10	80,000	800,000	51,232	512,320	盈轉 9,535 仟元	無	註 13
9904	32.1	80,000	800,000	51,392.5	513,925	認股權轉換 1,605 仟元	無	註 14
9909	32.1	80,000	800,000	51,910	519,100	認股權轉換 5,175 仟元	無	註 15
9912	31.1	80,000	800,000	51,997.75	519,977.5	認股權轉換 877.5 仟元	無	註 16
10003	31.1	80,000	800,000	52,063.25	520,632.5	認股權轉換 655 仟元	無	註 17
10005	31.1	80,000	800,000	52,304.75	523,047.5	認股權轉換 2,415 仟元	無	註 18
10005	50	80,000	800,000	60,304.75	603,047.5	現增 80,000 仟元	無	註 19
10007	31.1	80,000	800,000	60,324.75	603,247.5	認股權轉換 200 仟元	無	註 20
10009	28.1	80,000	800,000	60,327.25	603,272.5	認股權轉換 25 仟元	無	註 21
10104	21.6	80,000	800,000	60,582.75	605,827.5	認股權轉換 2,555 仟元	無	註 22
10109	21.6	80,000	800,000	60,590.25	605,902.5	認股權轉換 75 仟元	無	註 23
10205	20.5	80,000	800,000	60,735.50	607,355	認股權轉換 1,452.5 仟元	無	註 24
10209	20.5	80,000	800,000	60,747.50	607,475	認股權轉換 120 仟元	無	註 25
10212	20.5	80,000	800,000	60,757.50	607,575	認股權轉換 100 仟元	無	註 26
10304	20.5	80,000	800,000	60,868.75	608,687.5	認股權轉換 1,112.5 仟元	無	註 27
10312	20.5	80,000	800,000	60,888.75	608,887.5	認股權轉換 200 仟元	無	註 28
10401	20.5	80,000	800,000	61,003.75	610,037.5	認股權轉換 1,150 仟元	無	註 29
10405	20.5	80,000	800,000	61,078.75	610,787.5	認股權轉換 750 仟元	無	註 30
10408	20.5	80,000	800,000	61,108.75	611,087.5	認股權轉換 300 仟元	無	註 31
10503	20.2	80,000	800,000	61,208.75	612,087.5	認股權轉換 1,000 仟元	無	註 32
10511	18.7	80,000	800,000	61,213.75	612,137.5	認股權轉換 50 仟元	無	註 33

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其他
10603	18.7 38.9	80,000	800,000	61,438.75	614,387.5	認股權轉換 550 仟元 認股權轉換 1,700 仟元	無	註 34
10605	38.9	80,000	800,000	61,458.75	614,587.5	認股權轉換 200 仟元	無	註 35
10608	38.9	80,000	800,000	61,468.75	614,687.5	認股權轉換 100 仟元	無	註 36
10808	-	120,000	1,200,00	61,468.75	614,687.5	變更核定資本額	無	註 37
11011	10	120,000	1,200,00	59,850.75	598,507.5	註銷庫藏股減資	無	註 38

註：該次增資之生效(核准)日期與文號：

- 1.88 年 10 月 29 日，經(八八)中字第八八九七四八七八號。
- 2.89 年 04 月 26 日，經(八九)中字第八九四一六一〇三號。
- 3.90 年 08 月 14 日，經(九〇)中字第〇九〇三二六四〇一五〇號。
- 4.91 年 09 月 05 日，經授商字第〇九一〇一一三一六七〇號。
- 5.94 年 09 月 23 日，經授中字第〇九四三二八五五一四〇號。
- 6.94 年 07 月 22 日，金管證一字第〇九四〇一二九八九一號。
- 7.95 年 08 月 21 日，經授中字第〇九五三二七一二一四〇號。
- 8.95 年 06 月 09 日，金管證一字第〇九五〇一二三二〇四號。
- 9.95 年 10 月 03 日，金管證一字第〇九五〇一四六一一八號。
- 10.96 年 08 月 23 日，經授中字第〇九六三二六六二七六〇號。
- 11.96 年 06 月 25 日，金管證一字第〇九六〇〇三一九五七號。
- 12.96 年 11 月 09 日，金管證一字第〇九六〇〇六三〇〇七號。
- 13.97 年 09 月 10 日，經授商字第〇九七〇一二三三〇六〇號。
- 14.99 年 04 月 30 日，經授商字第〇九九〇一〇八八二五〇號。
- 15.99 年 09 月 02 日，經授商字第〇九九〇一一九七〇一〇號。
- 16.99 年 12 月 01 日，經授商字第〇九九〇一二六八一六〇號。
- 17.100 年 03 月 14 日，經授商字第一〇〇〇一〇四九二九〇號。
- 18.100 年 05 月 06 日，經授商字第一〇〇〇一〇九一三八〇號。
- 19.100 年 05 月 31 日，經授商字第一〇〇〇一一〇九一四〇號。
- 20.100 年 07 月 06 日，經授商字第一〇〇〇一一四三〇〇〇號。
- 21.100 年 09 月 15 日，經授商字第一〇〇〇一二一五五九〇號。
- 22.101 年 04 月 13 日，經授商字第一〇一〇一〇六五〇二〇號。
- 23.101 年 09 月 20 日，經授商字第一〇一〇一一九四八五〇號。
- 24.102 年 05 月 10 日，經授商字第一〇二〇一〇八五四五〇號。
- 25.102 年 09 月 06 日，經授商字第一〇二〇一一八五二二〇號。
- 26.102 年 12 月 02 日，經授商字第一〇二〇一二四一二九〇號。
- 27.103 年 04 月 15 日，經授商字第一〇三〇一〇六五六四〇號。
- 28.103 年 12 月 10 日，經授商字第一〇三〇一二四五〇九〇號。
- 29.104 年 01 月 14 日，經授商字第一〇四〇一〇〇二九一〇號。
- 30.104 年 05 月 25 日，經授商字第一〇四〇一〇九三六五〇號。
- 31.104 年 08 月 25 日，經授商字第一〇四〇一一七四七五〇號。
- 32.105 年 03 月 17 日，經授商字第一〇五〇一〇五〇九二〇號。
- 33.105 年 11 月 29 日，經授商字第一〇五〇一二七六〇一〇號。
- 34.106 年 03 月 27 日，經授商字第一〇六〇一〇三九二〇〇號。
- 35.106 年 05 月 18 日，經授商字第一〇六〇一〇六三七〇〇號。
- 36.106 年 08 月 25 日，經授商字第一〇六〇一一一八一六〇號。
- 37.108 年 08 月 16 日，經授商字第一〇八〇一〇九三四九〇號。
- 38.110 年 11 月 02 日，經授商字第一一〇〇一一九九二一〇號。

(二)主要股東名單：股權比例達百分之五以上股東，如不足十名，應揭露至股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例

114 年 4 月 27 日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例%
台新人壽保險股份有限公司		1,800,000	3.00
匯豐託管坎布里亞新興股東收益 ETF		1,620,603	2.70
鄒嘉駿		1,112,881	1.85
葉惠德		1,016,151	1.69
曾繼輝		1,005,000	1.67
瑞泉文嘉股份有限公司		1,004,000	1.67
三葉股份有限公司		890,000	1.48
林芳隆		834,207	1.39
隆華群資投資股份有限公司		800,000	1.33
張文杰		724,616	1.21

(三)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：新台幣元

項目		年度	112 年 (113 年分配)	113 年 (114 年分配)	當年度截至 114年4月30日
每股市價	最 高		96.70	151.00	120.50
	最 低		68.20	70.00	73.40
	平 均		85.04	120.07	105.25
每股淨值	分配前		44.32	44.58	—
	分配後		39.32	尚未分配	—
每股盈餘	加權平均股數(仟股)		59,851	59,851	59,851
	每 股 盈 餘		5.25	5.29	—
每股股利	現 金 股 利		5.00	4.50	—
	無償配股	盈餘配股	—	—	—
		資本公積配股	—	—	—
	累積未付股利		—	—	—
投資報酬分析	本益比		16.20	22.70	—
	本利比		17.01	26.68	—
	現金股利殖利率		5.88%	3.75%	—

(四)公司股利政策及執行狀況

1.股利政策

本公司每年結算，如有盈餘，除依法完納稅捐及彌補歷年虧損外，應先提列法定盈餘公積百分之十，並依證券交易法規定提列或迴轉特別盈餘公積；如有餘額，得優先分派特別股當年度得分派之股息；如尚有餘額，併同期初未分配盈餘，由董事會擬具分配盈餘分派案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。

本公司依公司法規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積，以發放現金之方式為之，並報告於股東會。

本公司依當年度獲利狀況扣除累積虧損後，如尚有餘額應提撥員工酬勞百分之五~十五及董事酬勞不高於百分之三。員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。

員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合條件之之控制或從屬公司員工。

為配合科技產業成長特性及整體環境，本公司股利政策採穩健平衡原則，並參酌獲利狀況、財務結構及公司未來發展等因素決定股利發放水準。股利之發放方式得依公司整體資本預算規劃，股票股利配發以不超過百分之九十為上限。

2. 本次股東會擬議股利分派之情形

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	961,832,463
加：本年度稅後淨利	316,558,230
當年度淨確定福利負債再衡量數	4,784,000
減：提列法定盈餘公積	(32,134,223)
提列特別盈餘公積	(6,844,319)
本年度可供分配盈餘	1,244,196,151
分派項目：	
股東股利-現金	(149,626,875)
期末未分配盈餘	1,094,569,276

(五) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

本次並無無償配股之計劃，故對公司營業績效及每股盈餘並無影響。

(六) 員工及董事酬勞

1. 本公司依當年度獲利狀況扣除累積虧損後，如尚有餘額應提撥員工酬勞百分之五~十五及董事酬勞不高於百分之三。員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會決議行之並報告於股東會。員工酬勞給股票或現金之對象，包括符合條件之從屬公司員工。
2. 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：本公司估列之員工及董事酬勞，係以本公司 113 年度之稅前淨利扣除員工及董事酬勞前之金額乘上章程擬訂定之員工及董事酬勞分派成數為估計基礎。本公司依當年度獲利狀況扣除累計虧損後，如尚有餘額應提撥員工酬勞百分之五~十五及董事酬勞不高於百分之三。
3. 董事會通過分派酬勞情形：
 - (1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：
113 年度估列員工酬勞金額 36,999 仟元，董事酬勞為 11,100 仟元。若實際分派金額與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，並將差異列為 114 年度之損益。
 - (2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：
本公司本期未配發員工股票紅利金額，故不適用。
4. 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：
 - (1) 112 年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形：112 年度員工酬勞實際分派金額為 43,486 仟元，董事及監察人酬勞實際分派金額為 13,046 仟元。
 - (2) 112 年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：112 年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派金額與財務報告認列數並無差異。

(七) 公司買回本公司股份情形：無此情事。

- 二、公司債辦理情形：無此情事。
- 三、特別股辦理情形：無此情事。
- 四、海外存託憑證辦理情形：無此情事。
- 五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形：無此情事。
- 六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無此情事。
- 七、資金運用計劃執行情形

本公司前一次發行有價證券已於 100 年第 3 季完成資金之運用且其效益亦顯現，故不適用。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.公司所營業務之主要內容

(1)研究、開發、生產、製造及銷售自製檢測系統，含下列產品：

A.PCB/IC 載板自動光學檢測設備。

B.TFT-LCD/OLED/觸控面板 自動光學檢測設備。

C.半導體自動光學檢測設備

D.微小硬度自動量測系統。

E.影像處理系統(包括影像處理發展工具)。

F.自動光學導引製造設備

(2)前各項產品之技術及諮詢服務。

(3)前各項產品之進出口業務。

(4)代理相關產品之報價經銷等業務。

2.營業比重

單位：新台幣仟元

產品項目	113年度營業收入	營業比重%
LCD 檢測系統	726,072	39.21
PCB/IC 載板	719,370	38.84
SEMI 檢測系統	315,051	17.01
其他	91,480	4.94
合計	1,851,973	100.00

3.公司目前之商品(服務)項目

產品項目	
IC 載板出貨前成品自動光學檢測設備	IC 載板製程中自動光學檢測設備
堆疊式/彈匣式兩用 SiP 自動光學檢測設備	Flip Chip 自動光學檢測設備
PCB 製程中自動光學檢測設備	PCB AFVI 自動最終光學檢測系統
PCB 線路檢查設備	PCB 高速檢孔設備
類載板自動光學檢測設備	COF Chip 卷對卷自動外觀檢查機
Roll to Roll 軟板線路檢查設備	Roll to Roll 軟板檢孔設備
半導體自動光學檢測設備	半導體晶圓級/面板級封裝檢測設備
半導體自動巨觀+微觀檢測設備	半導體 IR 內層缺陷檢測設備
半導體高速 Review 拍照設備	先進封裝多面檢測設備
LCD 顯示器 Cell 段自動光學檢測設備	LCD 顯示器 Module 段自動光學檢測設備
Array 自動光學檢測設備	Color Filter 彩色濾光片自動光學檢測設備
Color Filter 彩色濾光片自動複檢系統	PI 配向膜自動光學檢測設備
SEAL 框膠自動光學檢測設備	偏光膜自動光學檢測系統
Digital Macro Mura 自動光學檢測系統	Mura 自動檢修設備
Burr Check 毛邊檢測機	Bare Glass AOI 表面檢/端邊檢
AKKON 自動光學檢測設備	OLED 面板自動光學檢測設備
觸控面板檢測設備	保護玻璃檢測設備
車載異型 Panel 自動檢查設備	AR 眼鏡光學檢測設備
小尺寸面板點燈檢測設備	API 自動/半自動檢測設備
LCM 來料檢查機/最終成品檢測設備	外觀光學六面檢測設備

產品項目	
OD/膜厚/色度量測設備	自動光學導引製造設備
AI 自動拍照機	AI 自動缺陷判定暨分類
AIRV 人工智能複檢機	Wafer 切割道 SWIR 檢查設備

4.計畫開發之新商品(服務)

計畫開發項目	
半導體 TGV 檢測設備	FOPLP 黃光製程檢測設備
晶圓級封裝多製程段檢測設備	半導體 In-Situ 檢測模組
先進封裝多面檢測設備	半導體 CPO 檢測設備
半導體高速 Review 拍照設備	半導體 ADI 檢測設備
高精度 Bump 高度量測設備	矽晶圓應力量測系統
螢光殘留及光譜分析系統	晶圓邊緣檢測系統

(二)產業概況

1.產業之現況與發展

產業之現況

人工智慧(AI)浪潮席捲全球，製造業正經歷著前所未有的轉型。隨近年 AI 帶旺先進封裝需求，更高效率、更高品質、更低成本為各廠商共同追求的目標。隨 5G、AI、雲端運算、物聯網及車用電子應用技術日益進步，電子元件的發展趨於微型化、低耗能化、超薄化、高集成、高密度等方向發展，促使整體電子產業技術朝向更高挑戰目標前進。為了滿足未來應用的相關技術，如 5G 通訊的高速運算、低延遲等特性，帶動 PCB 層數增加、線寬及線距縮小、線路設計複雜度增加；同時電子產品也在設計上強調多功能整合，晶片朝 2.5D/3D 先進封裝多層堆疊發展，進而讓晶片的體積更小、效能更強。這些技術變革不僅推動產業升級，更進一步加速智慧製造市場的成長，根據 Research Nester 預估，2025 年智慧製造市場規模將達到 1,693.4 億美元，展現出高階技術在現代製造業中的關鍵地位。在此情況下，電子製造業對於檢測的精細度要求也不斷提高，先進製程技術發展趨勢將帶動自動光學檢測(AOI)朝向極精密的方向發展，並成為整體光學檢測應用成長的主要驅動動能。

AOI 結合光學感測、訊號處理、智慧分析等技術，以機器視覺做為標準技術來檢出各式線路或外觀缺陷等瑕疵，主要應用於電子元件生產過程中的檢測環節，取代大多數的人工檢測，快速穩定且一致的檢測結果大幅提高製程的完整性及正確性，減少返工和報廢，並提高客戶滿意度，同時提升最終產品品質、產能與市場競爭力。此外，隨著工業 4.0 及智慧製造趨勢形成，製造業快速轉型，走向更自動化、數位化的方向，整合機器視覺與製程的重要性愈加突出，AOI 不僅以其精準、智能、高效之特性大幅推升產業發展，更將 AI 深度學習整合應用於檢測領域中，利用成熟的光學檢測技術，輔以 AI 演算法進行分析與分類，取代人力達到全檢的目標，已成為製造領域檢測方案的發展主流。根據工研院產科國際所預估，2030 年 AOI 技術全球市場規模將達 250 億美元，2024-2030 複合年均成長率為 10.3%，隨著智慧製造浪潮的持續推動下，整體檢測市場需求預計將迎來爆發性成長。

AOI 技術全球市場規模的統計與預估



資料來源：工研院產科國際所(2024/12)

2024 年全球經濟成長主要受到通膨放緩、AI 技術應用擴展，及供應鏈改善的推動，尤以已開發國家的貿易復甦最為顯著，這些經濟體主要受益於服務需求增加及供應鏈改善，然而，地緣政治風險仍對經濟帶來一定程度的挑戰，如俄烏戰爭、美中貿易衝突升級，以及產業分化等。以產業面來說，雖 AI 的相關供應鏈驅動全球經濟增長，然而傳統製造業與汽車產業則因消費需求疲弱與電動車競爭加劇導致成長疲軟，整體發展表現明顯不均。在台灣方面，由於受惠於科技產業需求強勁，AI、高效能運算與晶片封裝技術的需求帶動出口成長，加上積極推動產業數位轉型與半導體投資，皆進一步提升整體經濟動能。

展望 2025 年，全球經濟將受惠於 AI 技術與能源科技的持續創新發展，然而美國總統川普政策的不確定性導致地緣政治緊張以及全球貿易壁壘的狀況，仍可能對經濟穩定產生影響，特別是在科技與供應鏈領域，將受到各國競爭與關稅等因素的挑戰。台灣方面主要因 AI、半導體與電動車供應鏈需求穩定，加上 5G 基礎建設與高效能運算市場亦持續擴展，預計將進一步提升產業競爭力，根據中經院 2025 年 1 月預估，台灣 2025 年經濟成長率約為 3.22%，雖成長幅度趨緩，但仍保持穩定發展。

全球及主要國家經濟成長率預估

(Real GDP, annual percent change)	ESTIMATE	PROJECTIONS	
	2024	2025	2026
World Output	3.2	3.3	3.3
Advanced Economies	1.7	1.9	1.8
United States	2.8	2.7	2.1
Euro Area	0.8	1.0	1.4
Germany	-0.2	0.3	1.1
France	1.1	0.8	1.1
Italy	0.6	0.7	0.9
Spain	3.1	2.3	1.8
Japan	-0.2	1.1	0.8
United Kingdom	0.9	1.6	1.5
Canada	1.3	2.0	2.0
Other Advanced Economies	2.0	2.1	2.3
Emerging Market and Developing Economies	4.2	4.2	4.3
Emerging and Developing Asia	5.2	5.1	5.1
China	4.8	4.6	4.5
India	6.5	6.5	6.5
Emerging and Developing Europe	3.2	2.2	2.4
Russia	3.8	1.4	1.2

資料來源：IMF (2025/01)

本公司主要為專業研發產製印刷電路板(PCB)、平面顯示器(FPD)與半導體(SEMI)之光學檢測設備，擁有光學、軟體、機械、電控及高階演算法等多項優勢。

於載板外觀檢測、高世代 LCD 光學檢測、LCM 模組點燈檢測市占皆穩佔龍頭，另延伸技術優勢，持續投入研發，成功開發對應市場新製程需求之多元產品，近年推出之 PCB 全板量測設備、AI 拍照複判機、晶圓級封裝檢測設備、面板級封裝檢測設備...等亦廣受業界好評，公司不斷深化在各領域的製程覆蓋，且銷售範圍遍及大中華地區、日本、韓國、新加坡、菲律賓、泰國、馬來西亞、德國...等地，同時持續關注產業鏈南移趨勢，於東南亞提早佈建相關代理及銷售渠道，穩定掌握相關商機。另外也推出 AI 深度學習軟體，與檢測設備相結合，進一步實現智慧製造，強化公司於自動光學檢測設備市場之競爭力。

公司長期深耕 PCB 領域，除主推並持續優化領先市佔的 IC 載板相關外觀檢測設備，另針對高密度連接板(HDI)、軟性印刷電路板(FPC)亦不斷投入研發精力，同時由後段外觀檢測領域切入前段製程檢測，廣化產品線覆蓋。本公司持續跟進產業發展脈動，已成功開發各式機台、對應多元產品需求，目前已具備外觀檢測、線路檢測、2D/3D 量測、雷射清除、檢孔等一系列設備，於銷售市場獲得顯著成果。中長期目標將持續擴展大陸、日韓、東南亞等地區銷售通路，掌握產業移動趨勢，以代理或合資等策略合作方式，拓展新市場及新客戶、提升市場競爭力。

另以平面顯示器產業而言，全球生產據點主要以中國為主，本公司設備早已導入大陸各世代面板大廠，銷售實績傲人，目前各世代線專用 TFT-LCD AOI 包括 CF、Seal、PI AOI...等，已廣泛銷售至兩岸大廠，多項產品市占率穩佔全球第一。近年公司專注高值化及差異化、投入車載及後段模組檢測，可對應各式料片大小及尺寸，點燈+外觀檢測設備成功打入歐系車載供應鏈，進一步穩固技術壁壘，同時提供 Demura 設備，全方位對應顯示器相關檢測需求；此外面對面板市場需求下降、產能吃緊之挑戰，本公司因應市場變化，以新機銷售及升級優化等多元利基強化市場競爭力，加上競爭廠商相繼退出市場，對公司顯示器設備毛利表現將有正向影響。

在 PCB 及顯示器檢測產業站穩灘頭後，本公司持續強化產品多元佈局，推出半導體光學檢測設備，以平衡產業波動、進而挹注營收及優化公司產品組合。公司於半導體檢測設備已開發一系列產品線，完整對應晶圓、面板、封裝、凸塊...等各式製程，以獨家專利螢光檢測有效偵測有機殘留物，並以 IR 光檢測內層隱崩隱裂缺陷，同時對於最新的 FOPLP 與 TGV 等亦提供完整方案，可檢測 Bare Wafer、Framed Wafer、WLCSP、CoWoS、Bipolar、Driver IC、CIS、Micro/Mini LED、FOPLP...等多項產品，並已完成主要大廠訂單出貨，銷售實績延伸兩岸及東南亞一線大廠，達到多廠多機量產里程碑。

(1)印刷電路板(PCB)產業

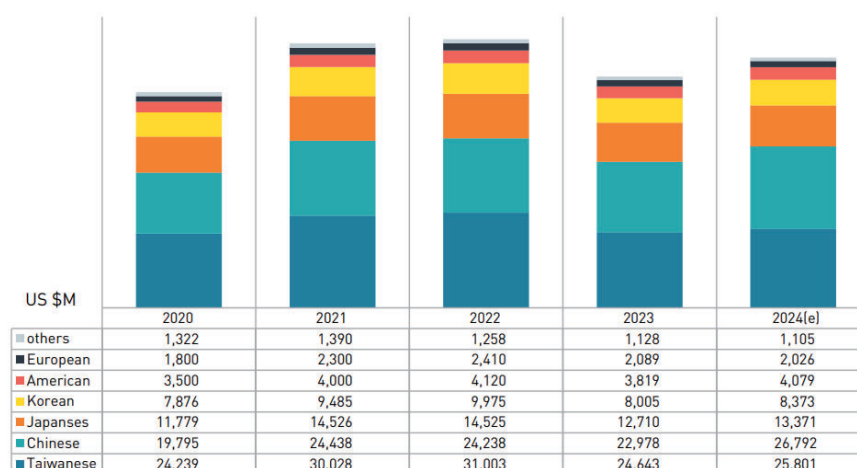
A.全球印刷電路板產業

2024 年全球 PCB 產業受惠於 AI 伺服器、高速運算 (HPC)、5G 通訊及電動車 (EV) 等領域技術的持續發展，帶動高階 HDI 板、IC 載板、高頻高速板等產品需求的穩步提升，加上終端應用市場的庫存壓力逐漸緩解，進一步推動產業進入復甦階段。此外，在技術方面，隨著先進封裝的不斷演進，以及晶片與載板高度整合趨勢的加速推進，皆帶動了 PCB 產業的成長動能持續增強，根據調研機構 Prismark 數據統計，2024 年全球 PCB 產值預計年增 5.5%，市場規模預測將達 730.26 億美元，較前一年呈現顯著成長，顯示產業已擺脫低迷，步入穩健發展軌道。

細看各地 PCB 市場產值，亞洲國家仍為全球市佔最高地區，尤以台灣與中國、日本、韓國之間的競爭最為激烈，各國在技術、產能及供應鏈整合方面各具優勢。中國大陸憑藉龐大的內需市場、規模經濟與成本優勢，近年已迅速成為全球 PCB 產業的重要生產基地；日本則以精密製造技術、關鍵材料

與設備優勢，在高端市場占據穩固地位；韓國受惠於記憶體與手機產業的強大支撐，持續提升其產業競爭力；台灣方面，主要以維持競爭優勢為主，加速技術升級與市場拓展。另一方面，隨著美中貿易戰的持續，不僅加速了歐美地區的本土化製造，更推動亞洲主要 PCB 生產國向東南亞擴張，以降低風險並提升全球市場競爭力。

全球 PCB 產值趨勢(依企業屬地)



資料來源：TPCA；ITRI/ISTI (2024/09)

展望 2025 年 PCB 產業的成長動能來自四大亮點，一、AI 與高效能運算持續推動高階 PCB 需求，特別是伺服器與數據中心應用；二、電動車市場擴展帶動汽車電子 PCB 的強勁成長；三、終端市場，手機、電腦、半導體等關鍵市場正式進入復甦期；四、其他新興應用發展(衛星通訊、VR/AR/MR、穿戴裝置)，四大因素推動 PCB 產業鏈成長，將使 2025 年成長率達 6.2%，其中以 HDI 與 IC 載板的產品需求增長最為顯著。

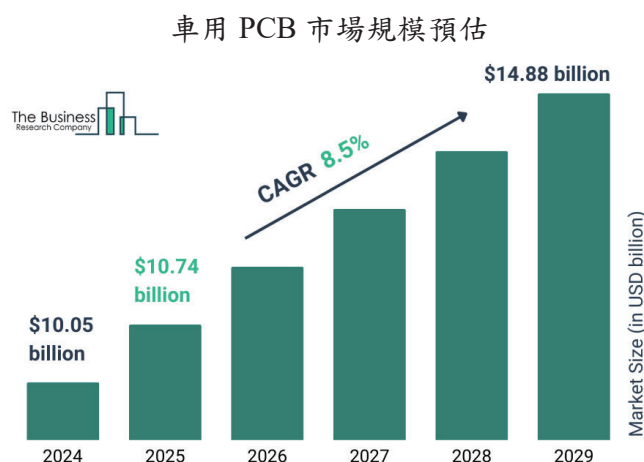
然而，川普 2.0 政策可能進一步推動美國採取更為強硬的保護主義措施，如對更多國家進口 PCB 課徵更高關稅並加速科技脫鉤，這將對全球供應鏈的整合與穩定性構成強大的挑戰，在此情況下，各地如何在地緣政治壓力下平衡競爭與合作關係，以及如何應對美國政策可能引發的連鎖效應，將是影響全球 PCB 產業未來發展的關鍵課題。

進一步分析 PCB 2024 年趨勢及未來發展，可以分為應用、技術及供應鏈三大主題，以下將針對各主題中最為顯著的趨勢領域做說明：

a. 應用領域 – 車用 PCB 市場擴大

2024 年車用 PCB 市場持續擴大，預估市場規模達到 100.5 億美元，以類型來看，目前多層板在車用 PCB 領域佔據主導地位，廣泛應用於車身附屬設備、中控台及各式電子控制單元當中。然而隨著電動車與自駕車技術的快速發展，車用 PCB 的發展趨勢正朝向小型化、高頻、高密度及高功率的趨勢演進，其中又以高密度連接板 (HDI) 因其小型化及高密度特性，在技術層面著重於提升線路密度與精度，採用高階層數或 Anylayer 結構，並結合 mSAP 細線路製程與小孔徑雷射加工製程，與電動車、先進駕駛輔助系統 (ADAS) 及 5G 車聯網的需求高度契合，預計將成為未來最具成長潛力的產品。

展望 2025 年，儘管目前燃油車仍是車用 PCB 的主要應用市場，但電動車對 PCB 的需求量遠高於燃油車，預計到 2028 年，電動車將成為車用 PCB 的主要應用市場，佔比有望達六成。以長遠來看，隨著工業巨頭加大研發投入、電動和混合動力汽車銷量增加，以及聯網汽車需求的上升，車用 PCB 市場將持續擴張，The Business Research Company 預計 2025 年至 2029 年的車用電路板年平均複合成長率將達到 8.5%。



資料來源：The Business Research Company（2025/01）

b. 技術領域 – 強化載板供應鏈

在全球電動車、人工智慧及高速運算等新興應用領域的強勁推動下，半導體產業正迎來蓬勃發展的新階段，其中對於晶片封裝至關重要的 IC 載板，已成為市場關注的焦點及趨勢。儘管全球經濟與地緣政治的不確定性依然存在，但隨著終端產品庫存的調整逐步到位，消費市場已顯現出復甦的跡象，特別是人工智慧領域的強勁需求，持續推動全球載板市場的回暖。台灣電路板協會預計，2024 年全球載板市場規模將達到 153.2 億美元，較前一年有 14.8% 的顯著增長。

細分載板領域來看，BT 載板受益於記憶體市場的強勁復甦，預計 2024 年市場規模將增長 16.5%，達到 72.0 億美元；ABF 載板則在 AI 算力需求的持續增長，以及先進封裝技術如 CoWoS 的發展推動下，正朝著大面積、多層數及細線路的方向發展。此外，AI PC 帶來的換機潮，也為 ABF 載板市場的復甦注入了強勁的動能，預計 2024 年，ABF 載板市場規模將增長 13.5%，達到 81.2 億美元。

在全球市場的競爭格局中，台灣為最大的載板供應者，佔據整體產值約 32.8%，其次是日本和南韓，分別佔據 27.6% 和 27.0% 的市場份額，以廠商來看，前五大載板廠商分別為欣興、SEMCO、Ibiden、AT&S 以及南電，這五家廠商合計佔據了全球過半的市場份額。展望未來，儘管台灣、日本和南韓在全球載板市場中佔據了近 90% 的份額，但中國及美國正積極追逐，尤其中國正推動科技產業自給自足，並通過半導體產業補貼以及積極提升 AI 晶片、伺服器、交換機等基礎設備的自主化程度，在政府資金和龐大內需市場的雙重支持下，中國的載板產業有望在未來的全球市場中擴大其影響力。

c. 供應鏈領域 – 供應鏈轉移，泰國 PCB 設廠布局

東南亞 PCB 產業在全球地緣政治緊張局勢升級的背景下正迅速崛起，成為全球印刷電路板及其他電子製造業的重要戰略佈局地，主要以龐大的人口基數、相對低廉的勞動成本、廣闊的市場潛力以及高於全球平均的經濟增長率，使東南亞成為全球製造業轉移的重要目的地。其中又以泰國為最主要的生廠基地，泰國政府透過積極的政策激勵，吸引來自台灣及中國的廠商設新廠，投資重點涵蓋車用電子、伺服器及消費性電子等多元領域。然而，由於泰國的供應鏈仍不夠完善，進而導致生產成本難以有效降低，使得泰國及東南亞各地目前的角色更偏向於第二生產基地，主要用於分散風險和承接部分生產需求。

以供應商來看，過去泰國 PCB 產業主要由日本企業和當地泰商主導，台資 PCB 廠商為數不多，不過隨著越來越多廠商進駐並拓展多元應用領域，2025 年將會有多家台廠陸續投產，其中包括華通、欣興、臻鼎-KY 和金像電等一線 PCB 大廠。進一步看各廠的量產時程，華通將以衛星產品硬板為優先，預計 2025 年第一季進入量產；欣興初期則將生產遊戲機、車用產品及模組化訂單，再逐步擴展至 AI 和高效能運算(HPC)等領域；臻鼎方面，新廠預計 2025 年第二季試產，主要聚焦高階伺服器、車用電子和光模組應用；金像電則預計 2025 年第三季量產，初期以通用伺服器等中階產品為主，再逐步轉向 AI 伺服器等高階產品。根據台灣電路板協會預測，2026 年泰國 PCB 產值在全球市場占比可望超過 5%，帶動各大廠商營收成長。

2025 年泰國 PCB 新廠試產進度

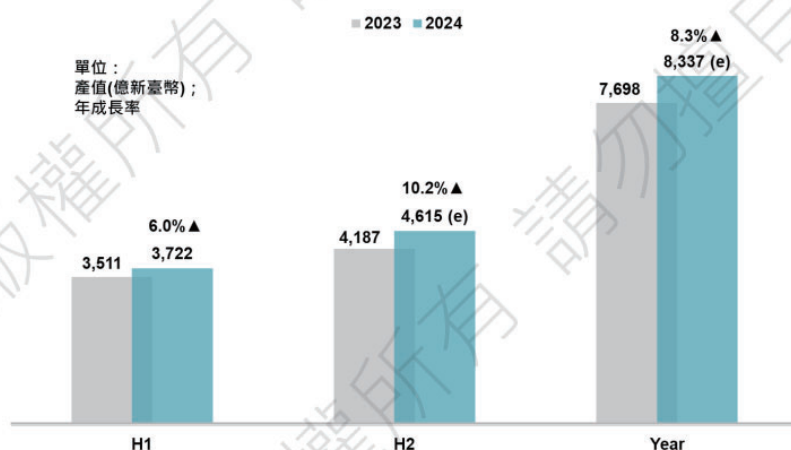
廠 商	泰國新廠進度	初期產能運用
華 通 (2313)	第一季進入全製程量產	衛星產品硬板
欣 興 (3037)	第一季量產	遊戲機、車用產品及模組化訂單
臻鼎-KY (4958)	第二季試產、下半年量產	高階伺服器、車載、光模組
金像電 (2368)	第三季量產	一般伺服器等中階產品

資料來源：工商時報（2025/01）

B.台灣印刷電路板產業

在當前科技快速發展的背景下，由於 AI 應用對高性能與高階 PCB 的需求日益攀升，台灣憑藉其深厚的技術積累與卓越的創新能力，已成為全球 AI 應用領域的重要供應者，特別是台灣在全球 AI 伺服器出貨量中佔據近九成的市場份額，同時也是 AI 伺服器的主要 PCB 供應商，展現了台灣 PCB 產業在全球供應鏈中的關鍵地位。此外，高階車用板、衛星通訊等新興應用需求的持續增長，以及手機、電腦、半導體等市場的逐步復甦，皆為台灣 PCB 產業帶來了顯著的發展契機。根據經濟部統計，2024 年台灣 PCB 產業預估全年產值達到 8,337 億新台幣，年成長率為 8.3%。

台灣 PCB 產業市場規模



資料來源：經濟部產業發展署（2024/09）

細看 PCB 產品結構，多層板與 HDI 板因 AI 伺服器、車用電子及衛星通訊需求強勁，占比持續上升，分別達到 30.5%和 20.1%，相較之下，受手機市場成長趨緩影響，軟板占比逐年下降至 24.4%，IC 載板占比則為 15.5%，雖成長放緩，但隨著 AI 應用普及，高效能運算晶片需求增加，載板市場有望迎來新一波成長。

在應用領域方面，2024 年的市場需求與技術發展主要聚焦在 HPC、B5G 與電動車三大市場，以下將進一步說明：

a. 高效能運算（HPC）

2024 年，隨著 AI 技術蓬勃發展，高效能運算（HPC）需求激增，成為全球科技競爭的焦點，其中 HPC 的發展仰賴高效能 PCB 技術支撐，台灣在此領域亦展現強勁實力，主要提供包含載板（ABF 載板）、HLC（高層數電路板）以及 HDI（高密度互連電路板）等相關高階 PCB 產品。除了 AI 伺服器之外，由於 HPC 技術也廣泛應用於智慧製造、金融分析、醫學影像處理及氣候研究等產業，預計台灣將在 HPC 硬體供應鏈中發揮更關鍵的影響力，助力全球高效能運算市場的擴展。

b. B5G – 消費性及基礎設施

在全球通訊技術不斷進步的背景下，台灣近年積極投入 B5G（超越 5G）技術的研發與應用，力求在全球通訊領域中取得關鍵地位。根據 3GPP（第三代合作夥伴計畫）的時程規劃，B5G 預計最早於 2025 年初開始商業化發展，並在 2028 年達到普及，為了迎接 B5G 時代的到來，台灣正積極佈局相關技術與產業鏈。

在基礎建設上，為了推動 B5G 與低軌衛星通訊的整合，台灣計劃在 2026 年發射第一枚 B5G 低軌通訊衛星，進行從衛星到地面站的通訊測試與驗證，不僅有助於提升在全球電信供應鏈中的地位，更將帶動載板、HLC 及 HDI 等關鍵 PCB 應用的發展。同時，B5G 技術也將驅動智慧型手機、平板電腦、AR/VR/MR 裝置及穿戴式設備等消費型電子的升級，進而增加對載板、HLC 與軟板元件的需求。整體來說，台灣作為全球半導體與電子製造的重要樞紐，預計將在 B5G 硬體供應鏈中逐步扮演更為關鍵的角色，強化市場的競爭力。

c. 電動車 – 高功率及自駕系統

綜觀2024年，台灣在電動車領域的發展迎來更多元的創新與突破，尤其是在自駕技術和高功率應用上，台灣企業在這些領域扮演越趨重要的角色，預計將成為電動車PCB供應鏈的核心地區，並且持續發展自駕系統所需的HDI電路板與載板，以及支援高功率應用的HLC及HDI電路板等關鍵技術。此外，根據台灣經濟部工業局的報告，台灣電動車產業鏈正加速構建，從電池管理系統（BMS）、充電基礎設施到自駕技術，都將加強本地研發與製造能力，台灣電動車充電站的增建計畫也在持續推進，並預計在未來幾年內將建設數千個新的快充站點，為電動車的普及提供更加完善的支持，同時強化PCB產業的市場規模。

2024年台灣高階PCB技術藍圖

高階應用	終端產品	應用PCB			
		載板	HLC	HDI	軟板
HPC	AI伺服器相關硬				
	(CPU/GPU/NPU、HBM高頻記憶體、主機板、Switch...等)				
B5G – 消費性	手機/平板、AR/VR/MR、穿戴式裝置...等				
B5G – 基礎設施	基地台、地面基站、衛星設備...等				
電動車 – 自駕系統	ADAS (雷達、感測器、鏡頭等)、智慧座艙...等				
電動車 – 高功率	電池管理系統、充電系統...等				

資料來源：經濟部產業發展署（2024/09）

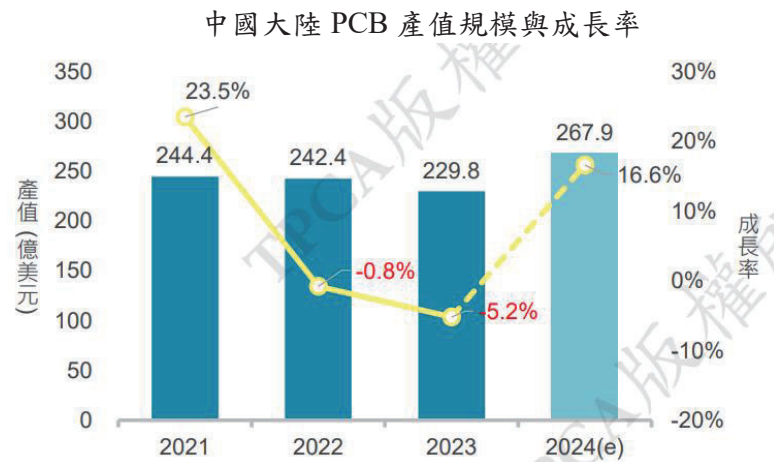
展望2025年，台灣PCB產業將受惠於AI邊緣運算需求激增、衛星通訊應用擴展以及技術持續升級等多重因素，預計產值將穩健成長，加上全球經濟逐步復甦，TPCA預估，2025年台灣PCB產值有望突破8,500億元，成長率達5.7%。然而，雖然2024年美國自台灣進口PCB的金額占美國總進口額的28.4%，顯示台灣在美國市場的競爭優勢，但也增加了對關稅政策變動的敏感性，加上中美貿易戰、中國廠商等競爭壓力，都將使台灣面臨更多元的挑戰。

在台灣PCB廠商方面，各家均積極布局AI相關應用，以掌握未來成長契機。其中欣興、臻鼎等大廠積極擴充產能，並強化高階產品研發能力，以滿足輝達AI晶片等高階應用需求；金像電作為全球伺服器板領導廠商，已成功打入四大雲端服務供應商，並持續提升AI產品營收佔比；健鼎則以穩健的市場策略逐步擴大在雲端伺服器市場的佔有率；而楠梓電透過轉投資與轉型，積極切入AI伺服器板市場，並計劃擴大資本支出，提升相關設備能力。整體而言，台灣PCB廠商正積極應對市場變化，透過技術升級、產能擴張和多元化布局，以鞏固其在全球PCB產業的領先地位。

C. 中國印刷電路板產業

2024年，中國大陸PCB產業在多重因素驅動下展現強勁成長動能，尤以AI應用的加速普及最為顯著，由於對高效能伺服器的需求激增，進而帶動AI伺服器PCB市場的快速擴張，同時新能源汽車滲透率也持續攀升，顯著推升車用電子PCB的需求。此外，中國政府透過多元化的政策工具，包括財政補貼、稅收優惠、專項資金和政府投資基金等，致力於建構完善的產業生態系統，全方位扶持PCB產業發展。根據TPCA預估，2024年中國大陸PCB

產業產值將達到約 267.9 億美元，年成長率高達 16.6%，全球市占率提升至 32.8%，穩居全球首位。



資料來源：TPCA、工研院產科國際所 (2024/11)

進一步看中國 PCB 大廠，在政策紅利的加持下，東山、深南、景旺、勝宏、興森等 PCB 廠商迅速崛起，成為推動市場的重要力量，這些企業不僅在產能擴張和技術升級方面取得了顯著進展，更在全球市場上展現出強勁的競爭力，進一步鞏固了中國大陸在全球 PCB 產業中的領先地位。以下為陸資主要 PCB 廠商 2024 年發展動態及近期計畫：

陸資主要 PCB 廠商 2024 年動態

廠商	主要 PCB 產品	主要 PCB 應用	發展動態
東山精密	1.軟板(70%)	1.通訊(39%) 2.汽車(30%) 3.電腦(16%)	伴隨 AI 應用逐步落地，公司加強在 AI 伺服器、雲端運算、車載等領域的 PCB 產品研發，並積極拓展新客戶與市場。
深南电路	1.多層板(51%) 2. HDI (30%) 3.載板(19%)	1.通訊(31%) 2.電腦(27%) 3.汽車(23%)	上半年受惠於 AI 加速卡、EGS 伺服器、車用電子等旺盛訂單需求，帶動業績成長。載板業務以 BT 載板產品為主，受到 DRAM 市場需求復甦，上半年成長達 94.3%。
景旺電子	1.汽車(53%) 2.通訊(25%)	1.多層板(40%) 2. HDI(30%) 3. 軟板(25%)	泰國廠(巴真府)已完成土地購買、子公司增資等工作。江西廠三期進入試產階段。
建滔集團	1.多層板(45%) 2. HDI (40%)	1.電腦(35%) 2.汽車(25%) 3.通訊(20%)	惠州廠 2024 年下半年規畫擴增每月 50 萬 f2 產能;泰國廠下半年擴增每月 20 萬 f2 產能,2025 年再擴增每月 50 萬 f 越南新廠預計 2026 年投產,產能規劃每月 100 萬 ft。

廠商	主要 PCB 產品	主要 PCB 應用	發展動態
勝宏科技	1.多層板(40%) 2. HDI(35%) 3.軟板(20%)	1.電腦(35%) 2.汽車(30%)	2024 年 5 月宣布投資 2.6 億美元在越南(北寧省)建廠。8 月以 3 千 8 百萬美元收購競國的泰國廠。
崇達技術	1.多層板(48%) 2. HDI(40%) 3.載板(7.4%)	1.通訊(38%) 2.電腦(28%)	擴建珠海二廠已於 2024 年 Q2 投產,主要生產多層板,應用於通訊與伺服器產品。另外為滿足海外訂單需求,已計畫 10 億人民幣的海外投資。
興森科技	1.多層板(52%) 2. HDI(30%) 3.載板(18%)	1.通訊 (39%) 2.電腦 (30%) 3.半導體(18%)	受高階手機市場復甦,帶動 HDI 產品穩定成長。載板業務以 BT 載板產品為主,在記憶體市場復甦下,業績快速成長。但由於廣州新廠以及 ABF 載板廠仍處認證階段,故整體載板業務尚處於虧損狀態。

資料來源：TPCA、工研院產科國際所 (2024/11)

以全球供應鏈來看，雖中國大陸在全球PCB產業中佔據主導地位，然而地緣政治的緊張局勢迫使全球客戶尋求供應鏈多樣化以降低風險，加上5G、伺服器、數據中心及電動車等新興市場的快速發展，對PCB需求呈現爆發式增長，為了提升在供應上的彈性並進一步拓展國際市場，中國PCB廠商近年正加速海外布局，以應對不斷變化的市場環境、客戶需求與分散地緣政治風險。在眾多海外投資地點中，泰國憑藉完善的基礎設施、相對低廉的勞動成本以及全球第九大汽車製造基地，成為中國PCB廠商的海外首選，截至2024年底，已有27家陸資和港資PCB製造商在泰國投資設廠，預計將吸引更多相關企業前往泰國，形成紅色供應鏈的群聚效應，此現象不僅將鞏固中國PCB供應鏈在東南亞市場的地位，更將進一步擴大其在全球PCB產業的影響力。

主要陸資PCB供應鏈泰國布局

泰國 Thailand	
PCB	● 巴真府：景旺電子、崇達科技、廣合科技、方正科技、依頓電子、澳弘電子、滿坤科技 ● 大城府：奧士康、中富電路、中京電子、威爾高、本川智能、深南電路、建滔集團(科惠線路)、勝宏 ● 羅勇府：東山精密、四會富仕、山崎電路板 ● 北柳府：生益電子、世運電路 ● 曼谷：深聯電路
材料	● 巴真府：南亞新材、恩基希科技 ● 羅勇府：福斯特 ● 北柳府：生益科技 ● 暖武里府：華正新材 ● 曼谷：鼎泰高科、甘井高新材料、初源新材、天承科技
設備	● 春武里府：力源海納 ● 暖武里府：環球集團 ● 曼谷：大族數控、芯碁微裝、東威科技、源卓微納科技

資料來源：TPCA、工研院產科國際所 (2024/11)

展望 2025 年，中國 PCB 產業將持續受益於 AI 與高速運算（HPC）等應用需求的增長，加上 DeepSeek 的推動，加速邊緣 AI 應用的普及，也為中國陸資 PCB 廠商在 HDI 板與高多層板領域帶來了更多發展機會。此外，隨著火箭發射成本的持續下降，低軌衛星市場正迎來加速發展期，進而帶動衛星 PCB 需求的顯著增長，也激勵了中國 PCB 企業擴大產能及加大研發投入。整體而言，中國 PCB 市場預計將保持 4.3% 的年複合增長率，到 2026 年，總產值有望達 546.05 億美元，充分展現了其長期穩健的競爭力。

然而，2025 年仍存在諸多不確定性，首先，美國的關稅以及電動車相關政策的變動，都可能對全球供應鏈產生巨大影響，進而波及中國電動車 PCB 市場的增長。其次，中國本土市場的通縮風險，也可能削弱消費市場的復甦，對消費性電子產品相關的 PCB 需求造成衝擊。為了應對日益激烈的市場競爭和不斷上升的成本壓力，中國大陸 PCB 廠商正積極在東南亞地區布局新的生產基地，同時也進行技術創新、優化成本結構與擴大多元化市場布局，以應對挑戰並把握發展機遇。

隨著電子產業的持續演進，PCB 製造商正面臨新的挑戰與機遇，其中在柔性 PCB、HDI 和 PCBA 等領域將會是中國 PCB 2025 年及未來的主要發展趨勢，以下將進一步說明：

a. 柔性 PCB（FPC）的興起

隨著電子產品日益追求輕薄化、可穿戴化，柔性 PCB 憑藉其獨特的物理特性，在 2025 年可望迎來持續性的成長，此可彎曲、扭曲、折疊的電路板，不僅為醫療設備、穿戴式裝置，甚至折疊智慧型手機等產品的設計帶來革命性的突破，成為許多關鍵應用領域的理想選擇。市場研究預測，中國柔性 PCB 市場規模於 2025 年有望達到 1680 億元人民幣，年成長率上看 12%，主要動力來自於消費電子、人工智慧等領域的快速發展，對 FPC 的需求將不斷增加。

b. 高密度互連（HDI）使用的增加

隨著 AI 伺服器等終端產品的集成度與複雜度不斷提升，市場對高傳輸速率與優異散熱性能的需求日益增加，使 HDI 產品的應用前景持續看好。展望 2025 年，HDI 的發展主要將受到 AI 與高性能計算的推動、5G 通訊與物聯網設備需求的成長，以及新能源汽車市場的擴張所帶動。根據國際調研機構 Prismark 預測，HDI 市場規模預計在 2027 年將達到 145.8 億美元，2023 年至 2028 年的年複合增長率將達 6.2%，超越整體 PCB 行業平上升的 5.4%。

中國各主要 PCB 廠商紛紛加大對 HDI 技術的投資與研發，提升產能並優化技術應用，以因應 AI 技術快速發展帶來的市場機會。如中京電子表示其 HDI 訂單目前已趨近飽和；博敏電子與科翔股份已展開 AI 相關產品佈局；廣合科技的廣州工廠則專注於資料中心類產品，並設有專屬 HDI 產線；勝宏科技的 HDI 產能更已連續超過半年滿負荷運轉，且 AI 算力需求仍佔據相當比重；景旺電子則進一步推進年產 60 萬平方米的 HDI 擴建計畫。顯見隨著 AI、市場需求與技術創新的推動，HDI 在 PCB 產業的戰略地位將持續提升，各大中國企業正加速布局，以應對未來市場競爭與技術挑戰。

c. 自動化 PCBA 的進步

為了應對電子產品日益複雜化、小型化以及成本控制的壓力，2025 年自動化 PCBA 製程的重要性將顯著提升，高密度組裝技術不僅滿足了電

子產品輕薄化的需求，更廣泛應用於5G通訊、物聯網、人工智慧及電動汽車等新興市場，這些技術的應用不僅提升了產品的性能，也加速了這些新興科技的普及。此外，全球供應鏈因地緣政治因素產生變化，促使許多生產商分散風險，將生產基地轉移，也進一步推升了PCBA的需求量，各種因素加總下可見PCBA自動化技術的進步將帶動產業進一步暢旺。

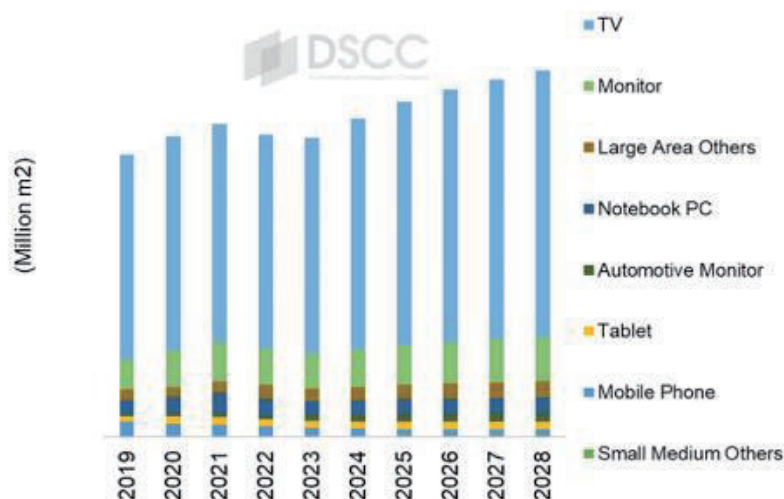
(2)平面顯示器(FPD)產業

A.全球平面顯示器產業

近年面板產業結構性供應過剩問題持續，但疫情期間由於顯示面板需求激增，隨著產業基本面逐漸觸底，2024 年儘管平面顯示器仍面臨原物料價格波動導致製造成本上升等挑戰，產業的淨利率已開始逐季改善，並在第 2 季顯示出回升的趨勢。根據 Global Information 評估，整體需求主要受到幾項因素的推動，包含高品質影像的平板顯示器需求持續增加、LED 顯示器在工業應用領域的廣泛採用、LCD 技術在桌上型顯示器中的快速普及，以及折疊式、軟性和大尺寸顯示面板的發展，都為市場注入了強勁的增長動能，回顧 2024 年顯示器產業的總營收達到 1569.2 億美元，較 2023 年增長 7.43%。

全球顯示器應用領域中，電視面板仍為市場主流，佔據了顯示面板 70% 以上的需求，雖 2024 上半年經歷了一段低迷，不過整體於第二季後逐漸好轉，主要需求受惠於歐洲盃、美洲盃以及奧運等運動賽事帶動需求提升，加上中國推出家電產品以舊換新的補貼政策（15%至 20%），皆振興電視市場需求的復甦，其中特別以中高階和大尺寸的電視助益最為顯著，根據群智諮詢統計，2024 年電視面板的出貨量增加至 2.41 億片，年成長 4.2%。展望 2025 年，由於美國關稅政策及中國延長補貼，將帶動短期拉貨需求，但仍有重演上半年旺，下半年需求反轉的風險。

全球顯示面板產值預測



資料來源：DSCC (2024/09)

電視面板規格方面，大尺寸化成為出貨面積增長的主要動能，群智諮詢指出，2024 年全球電視面板出貨平均尺寸為 51.4 吋，主力產品逐漸往 75 吋和 80 吋等超大尺寸電視面板靠攏，出貨面積年成長達 7.5%，而大尺寸電視價格也於 2024 年底擴大調漲範圍，整體營收規模可期。以顯示面板廠來看，京東方今年聚焦 85 吋以上產品，98 吋及 100 吋產品出貨量皆進一步提升，

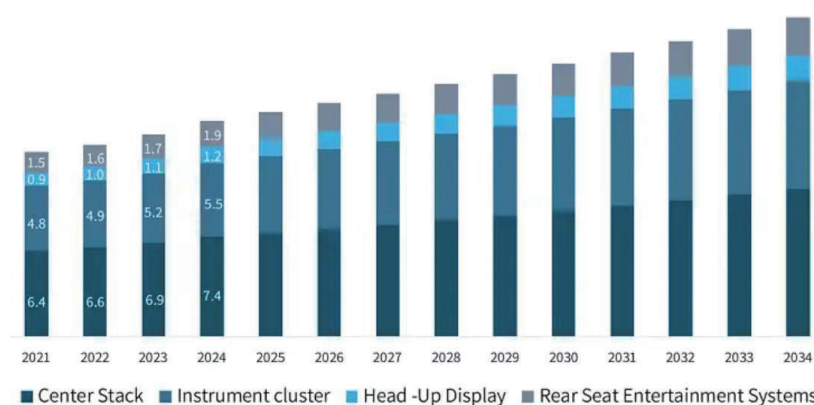
預估 2024 年電視面板淨利潤將翻倍，穩居全球出貨龍頭；TCL 華星則在 LGD 廣州廠產能加入之後擴大大尺寸 LCD 市佔，其中 75 吋、85 吋、98 吋為熱銷主力；惠科則預計 2025 年超大尺寸面板出貨破 300 萬片。以主要生產 OLED 電視的韓廠來看，OLED 電視雖鎖定高階市場，但因成本、耐久度、能源效率及財務虧損等挑戰，廠商態度轉為保守。在台灣面板廠方面，受惠韓廠退出 LCD 市場，2024 年出貨增長 3%，其中友達預估 2025 年電視面板出貨約為 1,700 萬片，群創為 3,860 萬片，不過仍以中小尺寸為主，夏普則因關閉 10 代廠、8 代廠產能，2025 年電視面板出貨將減至 1,350 萬片。綜觀 2024 年，大尺寸電視面板市場仍由中國業者主導，根據 OMDIA 估計市佔達 70~85%，呈寡頭壟斷的局面。

進一步分析 2024 年顯示器主要應用領域與發展趨勢，可以分為車載顯示器、摺疊手機、AI 眼鏡三個面向，三大應用分析如下：

a. 車載顯示器

2024 年車用顯示器市場持續成長，兩大關鍵驅動力分別為資訊娛樂系統的進化和日益嚴格的安全法規。消費者對車內數位體驗的重視日增，無論是對先進的娛樂系統、豐富的資訊顯示，還是便捷的觸控操作都有更高的期望；同時，隨著安全法規的強化，車廠積極為汽車配備更先進的 ADAS（高級駕駛員輔助系統），並提升顯示器在強光和各角度下的可視性，以確保駕駛能夠清晰獲取關鍵資訊，2024 年 2 月 UNECE 更明確了配備駕駛輔助系統車輛的核准規定，並對車道維持等系統設立了最低安全要求，進一步推動一車多面板及顯示面板優化的應用趨勢。根據 Global Market Insights 預測，2024 年車用顯示器市場規模將達 160 億美元，年成長率維持約 8~9%，顯示技術正加速向更智慧化、沉浸式體驗邁進。

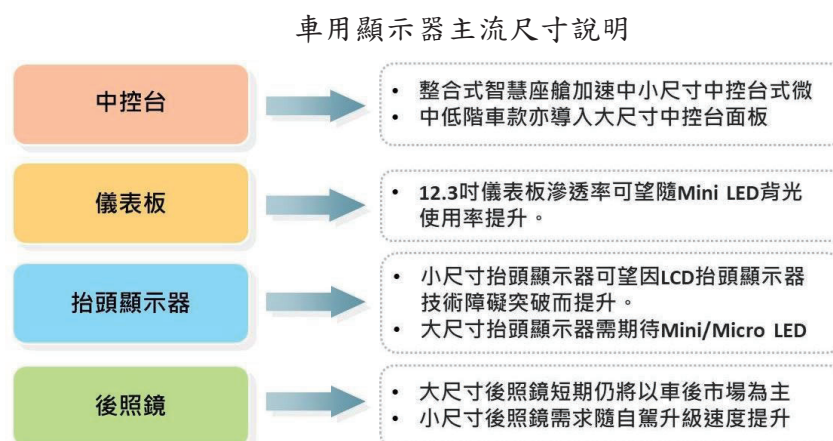
車載顯示器市場規模預估（單位：十億美金）



資料來源：Global Market Insights (2025/02)

以面板尺寸來看，大尺寸化已成為車用顯示器的發展趨勢，根據 DIGITIMES 預測，2024 年 9 吋以上車用顯示器出貨量將達 9,147 萬片，占總出貨量的 40.7%，2024 至 2029 年市場的年均成長率（CAGR）預計為 10.7%，其中以中控台和儀表板應用為主，主要提升訊息可視性，而抬頭顯示器及後照鏡用面板目前仍以中小尺寸為主，主要受 Mini/Micro LED 技術進展及面板是否標配化而定。在技術方面，受大尺寸化趨勢影響，LTPS LCD 面板在成本效益和省電效能上優於傳統 a-Si LCD，具有

較大發展優勢，此外，AMOLED 面板也逐漸向車用面板市場發展，尤其在高端車型中，憑藉其高對比度和薄型設計，未來有望占據一定地位。



資料來源：DIGITIMES (2024/08)

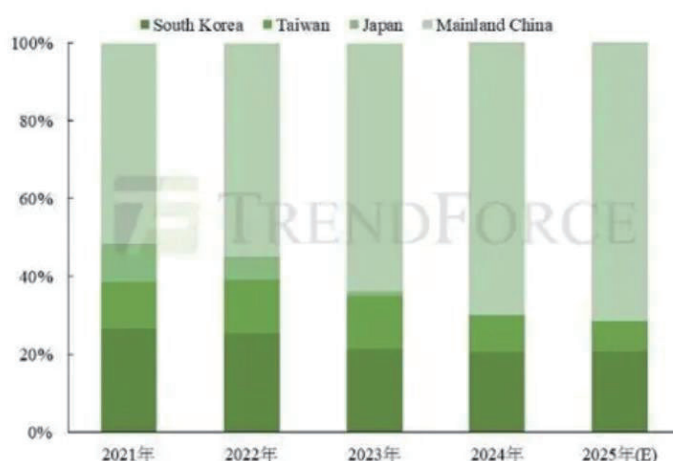
此外，新型顯示技術 Mini/Micro LED 也已進入到大尺寸顯示以及車載顯示、AR/VR、筆電等應用範疇，但要打開更廣的應用與更大體量的消費市場，仍面臨技術不成熟、生產良率不佳帶來的高成本問題。為暫時解決這些問題，更多企業選擇與上下游合作，通過企業之間的優勢互補突破 Mini LED 發展瓶頸，根據 LED inside 統計顯示，2023 年顯示行業內共達成了 13 項企業合作 Mini/Micro LED 技術，其中包括 Micro LED 技術廠商銓創與面板大廠友達簽訂 7 億新臺幣合約，銓創將協助友達在龍潭廠區建設 1 條 6 英寸 Micro LED Chip on Carrier 生產線，並提供統包解決方案，計畫將 Micro LED 顯示技術商業化；芯瑞達與海信視像、首爾半導體簽署協議共建聯合實驗室，推動包括 Mini LED 等在內的先進顯示與光學技術進步，作為新型顯示模組、光學半導體以及智慧終端領域裡的知名企業，三方均已在 Mini LED 領域有所建樹，通過三方的合作，Mini LED 技術性能有望進一步優化。

b. 智慧型手機面板

受惠二手機與新機需求增長以及中國的消費補貼政策，研調機構 TrendForce 調查指出 2024 年手機面板出貨量預計達 20.66 億片，年增 6.7%。然而 2025 年隨著市場回歸供需循環穩定期，受到 LTPS LCD 需求大幅下降和 AMOLED 需求微幅增長的影響，出貨量預估可能微幅下滑至 20.32 億片，年減 1.7%。

手機面板廠方面，京東方穩居全球智慧型手機面板出貨量第一，2024 年預計出貨 5.93 億片；排名第二的三星則受惠蘋果對 AMOLED 面板需求的支持，出貨量達 3.76 億片；惠科則以 G8.6 代線的成本優勢穩步成長，排名第三，預計 2024 年出貨量為 2.19 億片；第四名的華星光電由於與小米合作使其出貨量達 1.91 億片，年增 62.9%；第五名的天馬出貨量則為 1.88 億片。台灣面板廠方面，隨著初階 a-Si LCD 手機的應用逐漸下滑使他廠競爭壓力減小，市佔率大致維持不變；日系廠商則因快速退出手機市場，市佔率持續下滑；相對地，韓系廠商憑藉高階柔性 AMOLED 技術在高端手機市場維持競爭力，綜合來說，中國面板廠在全球智慧型手機供應鏈中扮演關鍵角色，2024 年市佔率達約 68%。

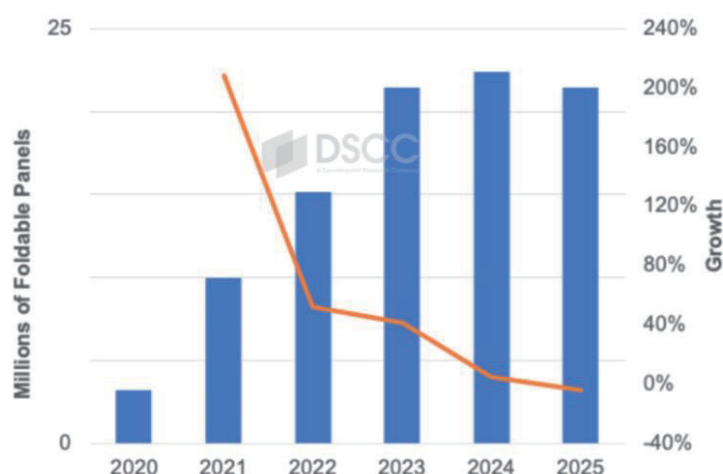
2021-2025年各區域市場手機面板出貨占比



資料來源：TrendForce (2025/02)

然而，摺疊式智慧型手機市場於2024年進入近乎停滯狀態，DSCC預測2024年摺疊式智慧型手機顯示面板市場僅成長約5%，需求約為2,200萬片，主要礙於高維修率、高售價的壁壘尚待解決，因此IDC預計2025年折疊螢幕手機將進入「小年」，更多廠商持觀望態度，預估2026年後才會有明顯成長。摺疊式智慧型手機的兩大廠商代表為三星及華為，三星以折疊手機先驅之姿，在2022年拿下超過八成市占率，而後面臨多家智慧型手機品牌廠加入競爭，市占率跌至面臨五成保衛戰。華為今年則推出升級版5G折疊手機，包括Mate X5、Pocket 2及市面上第一支三折手機，不僅帶來外型上的突破更象徵著技術上的升級，預估華為2024折疊手機市占率將接近三成，摺疊手機能為面板市場帶來哪些更新的應用及趨勢值得期待。

摺疊式智慧型手機面板出貨量



資料來源：資料來源：DSCC (2024/12)

c. AR+AI眼鏡

2024年VR頭戴裝置市場仍受限於裝置輕量化、成本控制與續航力等挑戰影響，發展腳步趨緩，然而，隨著Meta率先跳過探索階段，直接推出搭載AI與LEDoS (矽基Micro LED)技術的新款眼鏡展現市場潛力，

AR+AI智能眼鏡市場迅速崛起，其中Ray-Ban Meta眼鏡銷量更已突破200萬支，推動他廠商也紛紛跟進，如Rokid與INMO於2024年Q4推出整合大型語言模型的AR+AI眼鏡，預計2025年將有更多品牌投入競爭，根據DIGITIMES預估，2030年AR眼鏡出貨量將突破2,000萬套，市場規模有望超越VR/MR裝置，為顯示面板廠帶來全新成長動能。

在技術層面，AR設備對於光機模組的尺寸、強光下的透光效果以及顯示系統的亮度有嚴格要求，LEDoS光源因具備高亮度、體積小、低功耗的優勢，被視為關鍵技術之一，雖目前LEDoS仍需克服微縮化LED的發光效率問題，以及如何在極小尺寸內實現全彩顯示的技術挑戰，但隨著晶片垂直堆疊與色彩轉換技術的逐步成熟，LEDoS的市場滲透率預估將逐漸提升，據TrendForce統計，2024年LEDoS在AR裝置的市占率為18%，2030年將有望達到44%。

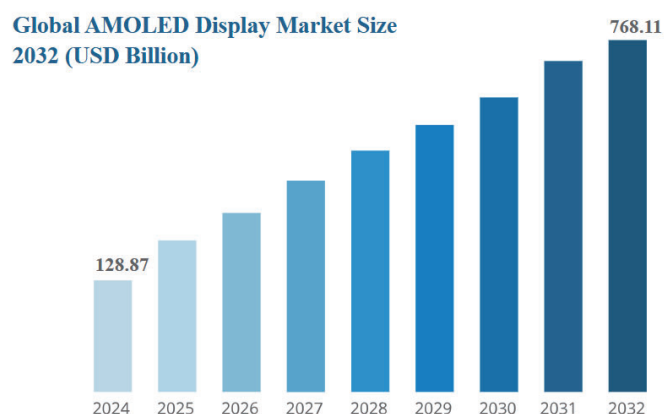
展望2025年，顯示器產業將持續向高畫質、低功耗與智能化發展，技術創新推動市場擴張，特別是在高端筆電、電競顯示與車載市場需求增長，同時隨著AR/VR顯示技術加速成熟以及AI PC與生成式AI推動高端顯示需求，產業將朝向更智能化、多元化發展。除此之外，中國面板廠的技術進步與產能擴張，正在改變市場競爭格局，2025年將帶來更激烈的價格與技術競爭，使面板價格逐步回穩。整體而言，顯示器產業正朝向更精細化、智能化與多元應用發展，並驅動市場規模穩步成長，根據Global Information預測，2025年全球顯示面板市場規模將達1,668億美元，並於2030年進一步成長至1,998.4億美元，顯示出產業發展的動能。

展望2025年顯示技術的產業趨勢，預期將有以下發展要點：

a. AMOLED

AMOLED顯示器以其生動、清晰且對比鮮明的影像品質，成為現今行動裝置領域的首選技術，尤其近年在智慧型手機、平板電腦、穿戴式裝置等領域的應用中展現出極大的潛力，特別是在可摺疊智慧型手機和平板電腦，AMOLED顯示器以其超薄、靈活的特性提供了更高解析度和更細膩的視覺效果，且可適應不同形狀的顯示需求。據Business Research Insights預估，全球AMOLED市場規模將從2024年的1288.7億美元成長至2032年的7681.1億美元，複合年成長率達25%，呈現逐年穩步上升的趨勢。

2024-2032年全球AMOLED市場規模預估

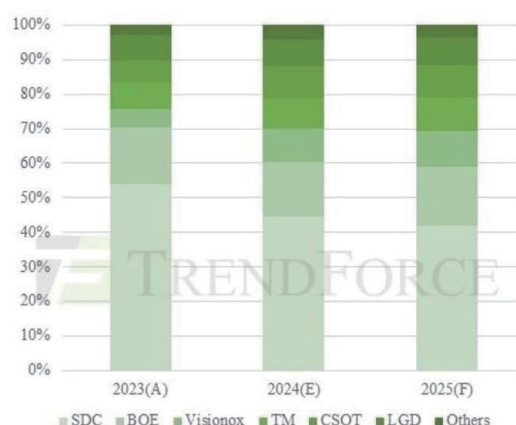


資料來源：Business Research Insights (2025/01)

應用領域方面，智慧型手機已成為AMOLED面板的主流應用市場，主要以高對比度、鮮豔色彩及低能耗的優勢著稱，且隨著技術的成熟與成本逐步下降，越來越多品牌選擇使用AMOLED面板，特別是在高端及中端機型中最為熱門，根據TrendForce統計，2024年AMOLED手機面板出貨量預估突破8.4億片，年成長率達25%，並預計2025年出貨量將超過8.7億片，顯示市場需求持續增長。

細看AMOLED手機的供應商，韓系面板廠目前占比最高，近年主要供貨給蘋果和三星，然而由於近年中國面板廠大舉擴張可撓性AMOLED面板產能並積極與手機品牌密切合作，大幅提升AMOLED面板的智慧手機市場滲透率，其中京東方除了與本土手機品牌密切合作，對蘋果的出貨表現也呈現逐年成長，已躍升為中國AMOLED手機面板出貨龍頭，加上2024華為三折手機帶動市場熱潮，維信諾、天馬與華星光電皆紛紛大量提升AMOLED手機面板出貨。以市場比重來看，根據TrendForce預估，2025年中國面板廠的整體出貨量有望超越韓廠，全球市占率可達50.2%，成為全球AMOLED手機面板出貨龍頭。

2023-2025年全球前六大AMOLED手機面板廠市占率



資料來源：TrendForce (2024/09)

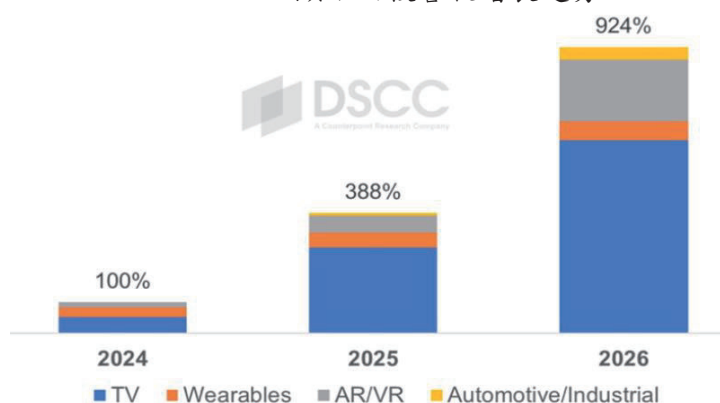
除此之外，AMOLED顯示器在平板電腦市場的應用正穩步增長，特別是在可折疊平板中，其靈活的設計增強了工作效率和娛樂體驗。其中蘋果於2024年推出的iPad Pro系列就首度使用RGB AMOLED面板，而目前三星、宏碁、聯想等品牌也已推出了AMOLED平板電腦，並不斷擴大產品線，顯示出AMOLED顯示技術在平板電腦領域的應用將持續增加。除了平板電腦外，筆記型電腦對AMOLED面板的需求也正在增長，蘋果目前已將RGB AMOLED面板的產線配置從6代線逐漸擴大至8.6及8.7代線規模，以對應後續潛在的需求並同時帶動他牌布局，預計到2025年，AMOLED筆電的出貨量將超過600萬台，市場滲透率達到3%。

b. Micro LED

Micro LED顯示技術以其自體式發光特性、較高的對比度，及可彎曲的特性，成為下一世代顯示器的潛力技術，其應用範圍不斷擴展，包括電視、車載、穿戴式裝置和微型顯示器等領域，整體市場並未因蘋果於2024年初暫時擱置在智慧手錶中的應用而受到重大影響。綜觀未來發展趨勢，儘管Micro LED仍面臨成本控制的挑戰，市場整體對其後續發展仍

持樂觀態度，預期隨著技術進步，成本有望如摩爾定律般快速下降，將成本降至與LCD和OLED競爭的水準。根據Grand View Research研究，預計到2030年全球MicroLED市場規模將達到256.5億美元，並預計2024至2030年的複合年成長率高達77.4%。

Micro LED 顯示面板營收增長趨勢



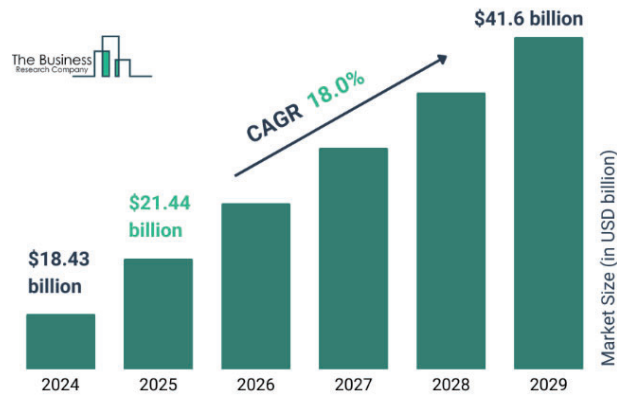
資料來源：DSCCS (2024.11)

Micro LED的應用領域中，電視技術的應用正在拓展至各大市場，並於推出後迅速進入家庭劇院、展覽展示、企業會議及教育空間等領域，如三星目前在美國市場已推出三款電視機型，儘管價格無法與OLED電視競爭，但Micro LED可以提供比OLED更大的尺寸，定位屬於高階家庭劇院的解決方案，也受到市場一定程度的歡迎。隨著三星、LG等品牌的穩定出貨，京東方、辰顯、天馬和海信等企業也將進軍Micro LED電視市場，競爭可能帶來一定的價格壓力，假使技術能不斷提升且價格每年都能有所下降，電視市場將成為Micro LED主要營收成長動力。據錄創預估，Micro LED電視產品的價格甜蜜點約落在2026至2027年，基於此情境，Micro LED顯示器的總營收預計到2026年將比2024年成長九倍。

車載領域對Micro LED技術的應用也正在迅速擴展，2024年包括友達、群創、京東方、TCL華星、惠科、三星、LGD等多家廠商皆展示了Micro LED顯示技術在智慧座艙中的應用，顯示出強大的市場潛力。例如，友達計劃將無縫拼接的大型透明Micro LED顯示器應用於車頂天窗，創造沉浸式體驗，此外還與Sony Honda Mobility合作，展示搭載於電動車上的Micro LED車頭顯示解決方案，將其技術應用於車身外部。根據評估，未來汽車產業的Micro LED市場預計將以每年約75%的複合成長率增長，尤其是在與高級駕駛輔助系統（ADAS）的整合中，Micro LED將成為抬頭顯示器的重要組成部分，進一步推動車載顯示技術的發展。

於穿戴裝置領域中，儘管蘋果暫緩了Micro LED穿戴裝置的計畫，Micro LED技術仍逐漸被各大廠商應用，不論是Meta的Orion智慧眼鏡，雷鳥的全彩Micro LED X3 Pro AR眼鏡，以及工研院發表的國內首支Micro LED AR眼鏡，皆突顯了Micro LED在智慧眼鏡中的潛力，並被視為未來關鍵技術之一，此外，三星於2025年初展示了應用Micro LED的智慧手錶，也進一步顯示出該技術在穿戴裝置領域的潛力，開啟多家廠商相繼入場的競爭局面。整體而言，Micro LED憑藉高沉浸感的關鍵技術，其在智慧眼鏡和穿戴裝置中的應用將持續增長，並有望成為未來的重要顯示技術。

AR及VR智慧眼鏡全球市場規模預估



資料來源：The Business Research Company (2025/01)

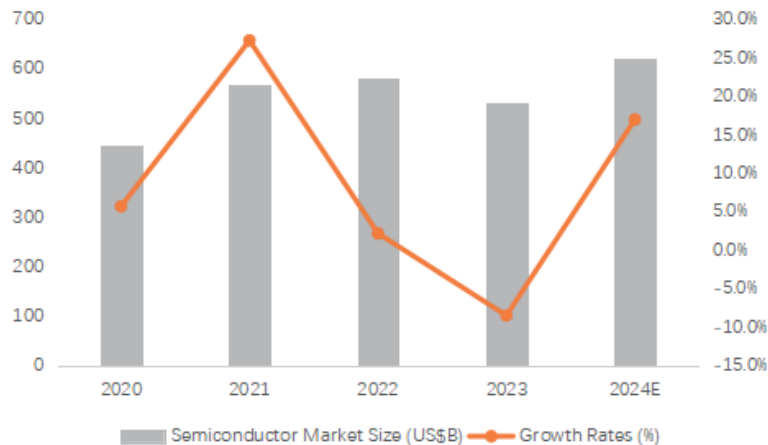
除此之外，Micro LED技術還在其他領域顯示出巨大的潛力，其中三星與化妝品品牌愛茉莉太平洋合作，推出Micro LED美妝鏡，其配備了超過80%的反射率和大於90%的透射率，能夠幫助分析用戶的膚質並提供量身定制的護膚產品推薦；另一方面，群創發表了9.6吋Micro LED智慧鏡面顯示器，不僅能顯示產品資訊、促銷訊息和個人化廣告，還能創造虛擬實境互動體驗。這些應用皆展示了Micro LED技術在提升顯示品質和創造創新體驗方面的潛力，並且為未來開拓了更多可能的應用，顯示出其在消費電子和智慧設備領域的廣泛應用前景。

(3) 半導體 (Semiconductor) 產業

A. 全球半導體產業

2024 年以來全球半導體市場的復甦趨勢日益明朗，整體產業進入上升周期，此成長動能主要來自於產業庫存調整告一段落，庫存去化的完成為半導體產業的穩步成長奠定穩固基礎，加上隨著終端市場新品陸續推出，帶動客戶重啟備貨，下半年 PC、消費電子與智慧型手機的出貨量皆持續增長，進一步推動市場回暖。此外，AI 技術驅動的高效能晶片與先進封裝需求，以及 AI 手機元年帶動的換機潮與硬體升級需求同步湧現，皆提振了半導體產業的景氣與信心。根據美國半導體協會報告指出，2024 年全球半導體晶片銷售較前一年成長 19.1%，達到 6,276 億美元。

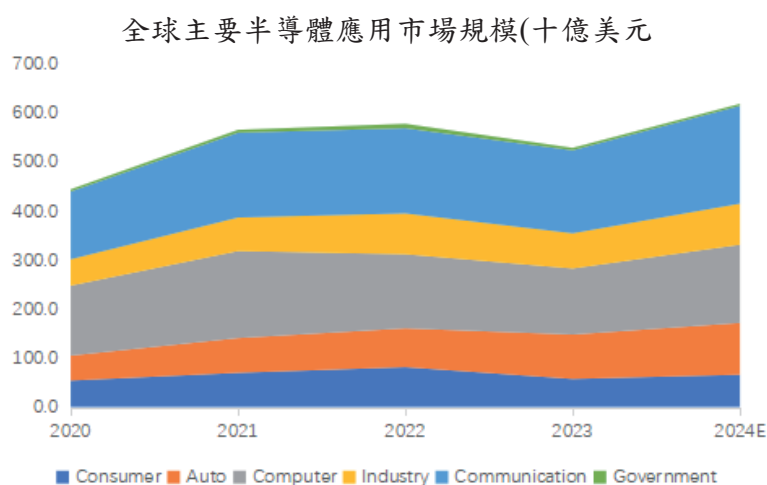
全球半導體市場規模(十億美元)及增速



資料來源：WICA (2024/09)

依區域來看，美國持續推動半導體製造回流，提供補助與稅收優惠，刺激半導體產業投資與產能擴張，使年銷售呈現高達 44.8% 成長；中國則在美國出口管制影響下加速發展自有晶片，成長率為 18.3%；台灣、南韓、東南亞等地區則分別受惠於台積電先進製程的持續領先、記憶體市場需求回溫及半導體製造與封測供應鏈轉移，2024 年的成長率達 12.5%；然而日本與歐洲則因消費電子需求疲軟及經濟放緩等因素呈現衰退趨勢。整體來說，美國、中國、台灣與韓國仍是全球半導體市場增長的四大驅動力，而 AI 需求、供應鏈重組與晶片技術升級正深刻影響各區域的市場表現。

細看半導體應用結構，世界積體電路協會評估，計算及通訊是半導體 2024 年兩大增量市場，市場規模分別為 1600 億美元及 2002 億美元，成長率皆約為 18%，汽車市場則排名第三，規模預計達到 1060 億美元，同比增長 16.7%。以下將針對此三大應用領域於 2024 年的亮點及趨勢說明：



a. 計算半導體 – 5G/6G 的快速發展

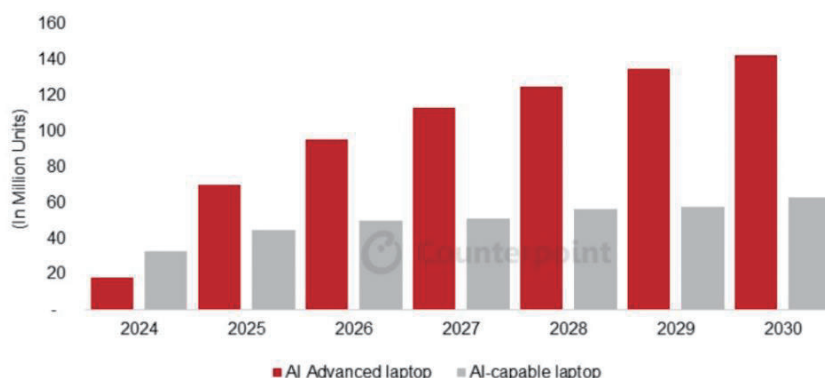
隨著數位與實體世界的融合加快，5G 已成為數位化應用的核心，支援 AI、AR/VR 等技術，並為企業提供高效能、低延遲的雲端服務。在這一過程中，晶片技術的發展對於推動 AI 計算、數據處理等方面起著關鍵作用。隨著數據需求的劇增與技術的發展，5G 的局限性逐漸顯現，特別是在頻譜擴展與設備連接數量上，6G 應運而生，6G 在技術上進一步擴展頻譜至太赫茲領域，提升網路智慧化與安全性，並實現更高速、更廣覆蓋的連結。6G 的應用將涵蓋沉浸式寬頻、極致關鍵通訊、普及物聯、全球行動連線、AI 通訊與感測整合等，同時推動智慧城市、智慧交通、工業自動化與醫療創新，將為未來虛實融合世界奠定基礎。

b. 通訊半導體 - 生成式 AI 智慧型手機與 AI PC 換機潮

隨著智慧型手機越來越個人化，生成式 AI 因為能處理文字、影像、語音等多種內容，將成為未來智慧型手機的核心技術，尤其在三星 Galaxy S24 系列和蘋果進入市場後，帶動了市場規模的增長，根據 Counterpoint Research 預估，2024 年生成式 AI 智慧型手機佔總出貨量的 11%，到 2027 年會增長至 43%，將吸引超過 10 億用戶。以晶片供應商來看，高通在 2024 年生成式 AI 智慧型手機的出貨量達到一半，聯發科技的市佔率則預計為 13%。AI PC 方面，雖然 2024 年復甦不如預期，但預計 2025 年

將呈現顯著成長，主要因疫情期間大量採購的筆電將進入汰換潮，尤其微軟宣布將停止支援 Windows 10，促使企業用戶提前升級設備，根據預測，2025 至 2029 年期間，AI 先進筆電及 AI 相容筆電將分別實現 49%和 12%的年複合增長率。

AI 先進筆電與 AI 相容筆電市場成長趨勢

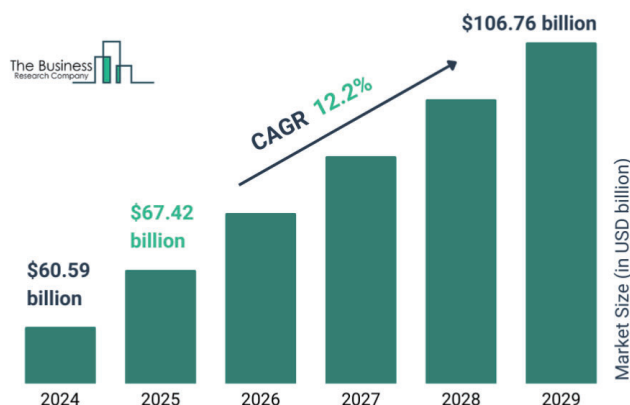


資料來源：Counterpoint Research (2025/01)

c. 車用半導體 – 高階晶片驅動智慧發展

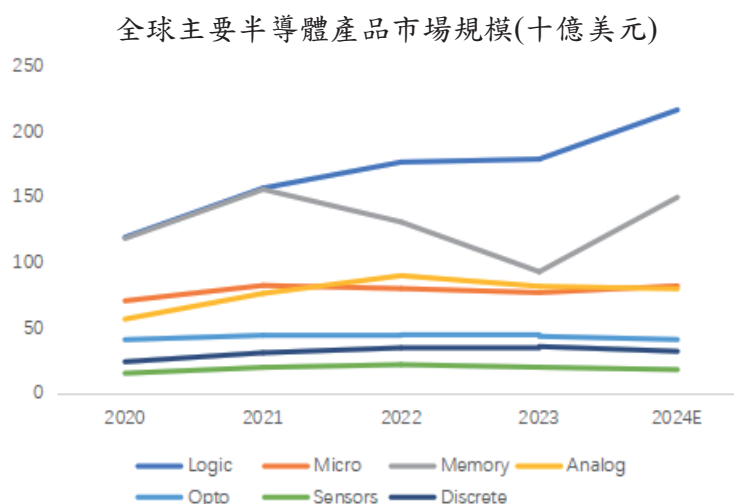
隨著汽車產業邁向數位化與智慧化，IDC預測全球汽車半導體市場將大幅成長，主要受先進駕駛輔助系統（ADAS）、電動車（EV）和智慧車輛的普及帶動，不論是在自動駕駛、智慧駕駛艙、動力系統及安全控制等領域，汽車半導體皆扮演不可或缺的關鍵應用角色，如高性能晶片可支援即時感知與決策、提升駕駛互動體驗並優化能源效率，同時支援ADAS和穩定性來增強安全性和控制能力，這些技術涵蓋了邏輯晶片、記憶體晶片、微處理器與類比晶片等，顯著提高了車輛性能和使用者體驗。除此之外，中國、歐洲與北美市場的政府對新能源車的排放法規與補貼政策，也正加速電動車與混合動力車在半導體市場的發展。根據The Business Research Company統計，2024年汽車半導體市場規模為605.9億美元，並預計將在2029年達到1067.6億美元，汽車晶片正朝向高性能、高整合度與高可靠性發展，以滿足汽車產業日益複雜的技術需求，而持續的技術創新將加速這一趨勢。

全球車用半導體市場規模



資料來源：The Business Research Company (2025/01)

從產品結構來看，2024年積體電路細分領域中，據美國半導體協會統計，邏輯晶片銷售額為 2,126 億美元，位居第一，第二名的記憶體晶片銷售則達到 1,651 億美元，其中 DRAM 產品的成長率更高達 82.6%，漲幅為所有產品類別之最，以下將針對邏輯晶片及記憶體晶片 2024 年的亮點及趨勢說明：



資料來源：WICA (2024/09)

a. 邏輯晶片

在AI晶片市場中，目前以GPU和ASIC為主要的兩種邏輯晶片，各自擁有其技術優勢。GPU因具備高度平行運算能力，且擁有相對成熟的軟體生態，已成為通用計算與深度學習訓練的核心硬體。根據DIGITIMES預估，NVIDIA憑藉其領先的GPU技術，2024年市佔率已超過80%，儘管中國於2025年初推出類似ChatGPT的AI聊天機器人對GPU銷售的影響存在不確定性，不過根據NVIDIA預估，GPU仍呈現供不應求的狀況，主要受Elon Musk推出AI Grok 3將採購10萬顆H100、DeepSeek帶動中國市場搶購新舊世代GPU，以及改良版B300與GB300預計於2025年第三季上市等因素推動。

除此之外，隨著AI應用朝向特定領域優化，專為特定AI任務設計的ASIC晶片逐漸受到重視，相較於通用型GPU，ASIC可提供更高的計算效率與能耗比，不過目前仍有開發成本高且缺乏彈性的缺點，因此企業需在效能與靈活性間做出權衡及選擇。未來GPU與ASIC將朝分工與互補的方向發展，GPU仍主導通用計算與AI訓練，而ASIC則針對邊緣AI、金融運算、語音識別等應用提供更高效的解決方案，此外隨著2奈米、3奈米製程技術導入，加上異質整合技術的優化，邏輯晶片的能效與運算能力將大幅提升也將更多元化。

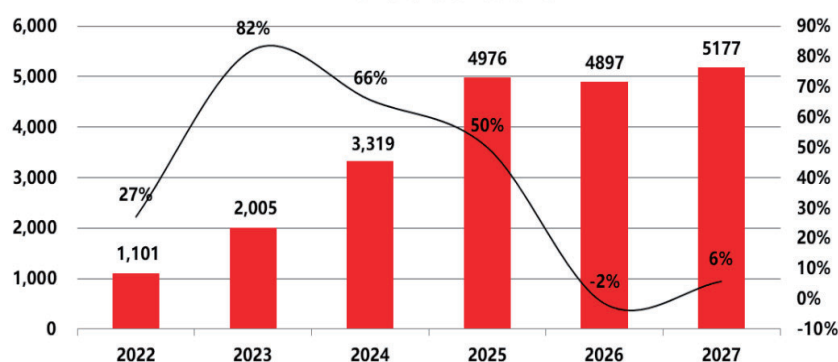
b. 記憶體晶片

目前市場主流的DRAM技術已難以滿足大型AI模型對記憶體的需求，為了突破此瓶頸，HBM（高頻寬記憶體）正逐漸廣泛應用於AI晶片中。相較於傳統DRAM，HBM採用2.5D/3D堆疊技術，具備高頻寬、低功耗與體積小的優勢，能有效提升AI晶片的數據存取效率。雖因製程技術複雜且成本較高，HBM尚未成為市場主流，但隨著GPU等高算力晶片對高頻寬記憶體的需求持續增加，HBM已成為不可或缺的解決方案。

從產品布局來看，單顆GPU通常搭載多顆HBM以提升運算效能。例

如，輝達於2024年3月發布的B100與B200晶片組，就配備了八顆HBM；超微則透過技術升級，將HBM堆疊層數從8層上升至12層；而Google的TPU系列更在每一代產品中增加HBM的使用量，由此可見多顆HBM堆疊技術已成為發展趨勢，產業規模可期。根據Gartner預測，2024年全球HBM市場規模將達33.19億美元，並有望在2027年突破50億美元。

2022-2027 年 HBM 全球市場規模預估(百萬美元)

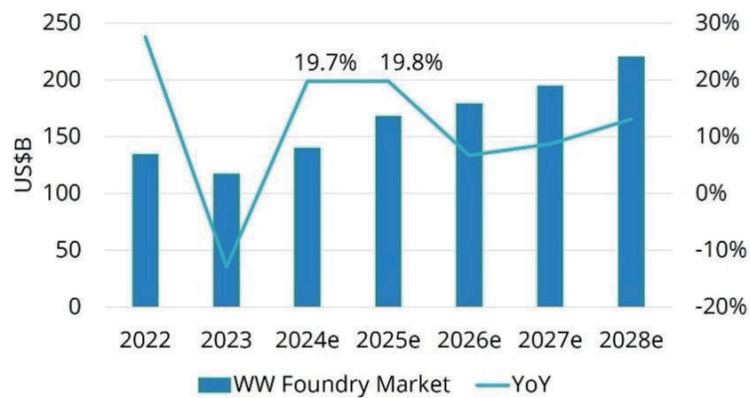


資料來源：Gartner、永豐投顧 (2024/08)

展望2025年，根據世界半導體貿易組織統計，受惠於AI智慧型手機和資料中心對半導體的強勁需求，全球晶片市場規模將達到6971.8億美元，年增11.2%，尤以美洲地區15.4%的成長幅度最為顯著；其次為亞太地區成長10.4%，其中日本估計有9.4%的增長；歐洲地區的增幅則為最小的3.3%。然而儘管市場普遍看好半導體市場在2025年的表現，對半導體通路商而言，美國總統川普的關稅政策可能帶來成本上升、供應鏈轉移與市場變動等三大挑戰，進一步增加市場的不穩定性，針對這些關稅議題，IC通路業界已提前做好布局，提升應變能力，並將持續靈活調整貨源與價格策略，以維持供應鏈穩定。

以IC設計市場來說，亞太地區IC設計產品線最為豐富多元，應用遍及全球，包括智慧型手機AP、電視SoC、OLED、WiFi、ASIC等必備晶片，隨著庫存水準趨於穩定、個人裝置需求回升以及AI運算的廣泛應用，IC設計的整體需求將持續增加，IDC預估2025年整體市場規模將成長15%。在IC製造方面，國際半導體產業協會(SEMI)則預測，2025年即將啟建18座新半導體廠，達到每月3,360萬片晶圓產量以應付市場需求，其中晶圓代工將扮演主要角色，Counterpoint Research預估從2025至2028年間，年複合成長率將達13%至15%，以3奈米、2奈米等先進製程及CoWoS先進封裝為主要動力。聚焦IC封測產業，中國因受地緣政治影響而推動半導體自主化政策，使晶圓代工成熟製程的產能快速增長，下游封測廠也隨之擴展並逐步完整晶圓製造產業鏈，在此趨勢下，中國封測市佔率於2025年估計將持續上升；台灣方面則加快在台灣及東南亞的產能佈局，並積極發展AI晶片先進封裝技術以鞏固AI GPU等高階晶片封裝領域的優勢，IDC預計2025年整體封測產業將增長9%。

全球晶圓代工市場規模預估



資料來源：IDC (2024/12)

2025年半導體製程技術將成為半導體發展的關鍵，在高效能運算(HPC)和AI應用的驅動下，3奈米和2奈米等先進製程，以及CoWoS先進封裝等將是未來幾年內市場成長動能，關於整體技術趨勢將有以下說明：

a. 先進封裝

在人工智慧 (AI)、高效運算 (HPC)、汽車、AI PC等大趨勢推動下，2024年先進封裝市場逐漸復甦，包括覆晶 (Flip-chip)、系統級封裝 (SiP)、扇出 (FO)、晶圓級晶片尺寸封裝 (WLCSP)、嵌入式晶粒封裝 (ED)，以及2.5D/3D等先進封裝技術市場都呈現正成長，研究機構IDC預估全球先進封裝市場規模將於2029年成長達695億美元。就封測廠來說，台積電積極於台灣中南部投資建置CoWoS產能，預計2025年下半年投產，日月光、美光、SK海力士、英特爾及三星也都積極建置先進封裝產能規劃，研究機構Yole Group預估，先進封裝在整體封裝市場中的比例將於2025年超過傳統封裝、達到51.03%，成長強勁。

2025年先進封裝領域中，預計以FOPLP(扇出型面板級封裝)及CoWoS的成長最微顯著。在FOPLP方面，主要因其可利用面積大、成本更低廉的優勢將於2025年快速成長，而增長動力主要來自於GPU、CPU、ASIC等運算需求、電子汽車PMIC晶片以及Mini LED/Micro LED顯示技術的支援等，根據研究機構DSCC的預測，FOPLP市場將從2025年到2030年以29%的年複合成長率快速增長至29億美元，台積電、三星、日月光和群創等企業也正積極投資擴展FOPLP的產能並拓展應用領域。至於CoWoS技術，儘管DeepSeek的推出帶來了市場的不確定性，但市場受惠於輝達、AMD、博通、Marvell和蘋果等高效能運算客戶需求的推動，產能預計仍持續倍增，其中以台積電的CoWoS-L產品線年增長率達到470%尤為突出。

採FOPLP模式的封裝合作項目及進展概覽

Service Provider	Client	Application	Panel Size	Status
PTI	MTK	PMIC, RF	515*510mm	existing
	AMD	PC CPU	515*510mm	mini line equipment purchased
ASE	Qualcomm	PMIC, RF	300*300mm	idled
	Qualcomm	PMIC, RF	600*600mm	mini line equipment purchased
	AMD	PC CPU	600*600mm	mini line equipment purchased
SPIL	NVIDIA	AI GPU	515*510mm	evaluating
TSMC	NVIDIA	AI GPU	515*510mm	evaluating
	AMD	AI GPU	515*510mm	evaluating
Innolux	NXP	PMIC	620x750mm	to MP in 2H24
	STMicro	PMIC	620x750mm	evaluating
Nepes	--	--	600*600mm	--
SEMCO	Samsung	PMIC, AP	510*415mm	existing

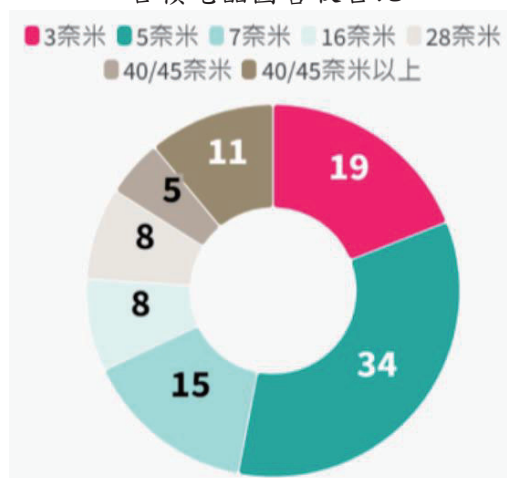
資料來源：TrendForce (2024/07)

b. 先進製程

2025年由於AI驅動的半導體熱潮將持續，半導體將朝向更小的製程節點發展，尤其是先進節點（20奈米以下）的擴展正在加速中，根據研究機構IDC的預測，先進節點產能每年將成長約12%，並預計平均產能利用率將保持在90%以上。更小的製程節點因能提供高性能、低功耗以及更佳的運算能力，使其在市場對先進技術日益增長的需求成為主流，然而因製造技術更為複雜的關係，晶圓代工市場中，持續推動7奈米以下先進製程的大廠，主要僅剩台積電、三星與英特爾。

台積電2024年營收顯示，先進製程（7奈米及更先進製程）佔其晶圓銷售金額約7成，顯示其營收主要來自先進製程，此外，台積電更計劃於2025年下半年量產2奈米製程，並在2026年大量生產，若該製程的開發按計劃順利進行，將通過超級電軌技術（SPR）提升運算效能和能效表現，成為市場先驅。三星方面，先前在5奈米及3奈米製程上皆因良率過低面臨客戶轉單及虧損問題，不過其晶圓代工部門仍計畫在2025年下半年推出採用第三代 GAA 技術的2奈米節點製程技術，預估最快將於 2025 年第四季開始量產，屆時與台積電的N2製程技術正面對決。而英特爾在「4年5節點」計畫推出後就陸續出現執行困難的情況，2025年的狀況尚未明朗。

台積電晶圓營收占比



資料來源：玉山投顧 (2024/10)

B.台灣半導體產業

2024上半年，IC 設計端庫存去化速度加快，帶動產業出現非季節性的回溫，然而製造端則受到傳統淡季的影響，包括高階智慧型手機出貨減少、消費性電子需求波動，以及農曆新年假期導致工廠稼動率降低，整體市場表現因而下滑。進入下半年後，市場逐步回暖，主要受 AI 晶片與高效能運算(HPC)帶動的運算單元升級需求推動，此外AI 伺服器的擴展也進一步推升記憶體需求，帶動 DRAM 價格上揚，提升產能利用率，進而促使 IC 產業在季度與年度層面皆呈現成長趨勢。根據工研院產科國際所預估，2024年台灣半導體產業（含 IC 設計、IC 製造、IC 封測），產值將達5兆3151億元，年增幅達22.4%，遠高於全球半導體業的平均。

展望2025年，在高效能運算（HPC）、人工智慧（AI）、5G/6G 和車用電子等領域的需求帶動下，半導體製造技術不斷升級，市場競爭力也進一步加強，不僅有助於台灣維持全球半導體製造領先地位，也將帶動更多技術創新與合作機會。根據工研院產科國際所的預測，台灣半導體產值預計將再度增長16.2%，達6兆1785億元，其中台積電將繼續成為台灣半導體產業的主要增長動力，並推動相關產業鏈的發展，依據台灣半導體產業鏈個別分析2024年趨勢及2025年展望如下：

a. IC設計業

隨著生成式AI技術與晶片創新，AI智慧手機潮流推動高階手機的普及應用，AI PC和邊緣式AI硬體展現成長潛力，加上網路通訊設備技術升級等有利因素逐步顯現，皆有助於IC設計產業的產值提升。臺灣IC設計業2024年表現也重回成長期，產值達新臺幣1.28兆元，創歷史新高，成長率達16.5%。

展望2025年，AI應用所引發的晶片需求，依然是主要動力。推理式AI、多模態AI 等新應用陸續釋出市場應用，個人智慧終端的AI能力滲透率將逐步增加，繼續帶動消費性產品成長，不僅AI PC產品陸續上市，穿戴式裝置也是AI應用新市場。工研院產科國際所預期，台灣IC設計業者在2025年，將保持10.2%的年增率，推動年產值達到1兆4,071億元的新高紀錄。工研院產科國際所指出，2025年個人智慧終端的AI能力滲透率將逐步增加，繼續帶動消費性產品的成長。

台灣IC設計業年產值成長趨勢

時間	IC設計年產值（億元）	年成長率(%)
2016	6,531	10.2
2017	6,171	-5.5
2018	6,416	3.9
2019	6,928	8.0
2020	8,529	23.1
2021	12,147	42.4
2022	12,320	1.4
2023	10,965	-12.9
2024	12,769	16.5
2025	14,071	10.2

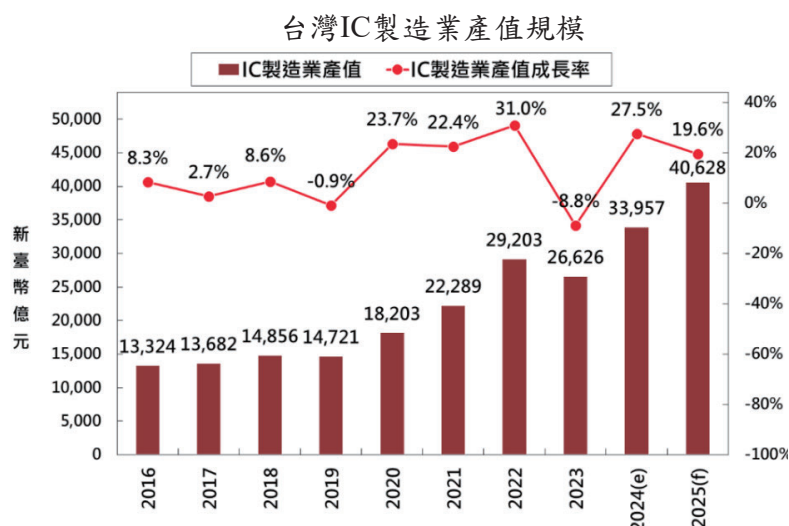
資料來源：工研院產科國際所 (2024/10)

細看台灣IC設計三雄表現，2024年，聯發科技在5G、Wi-Fi 6/6E與AI領域持續發力，而Dimensity系列晶片不僅在智能手機市場中穩步增長，也在智慧家居和車用電子領域拓展市場，2025年預計將進一步擴大應用，強化其在自駕車、AIoT及HPC領域的市場佔有率；聯詠科技則在AI應用及高效能顯示領域的表現強勁，計畫2025年將持續推動OLED TDDI新品，並預計在第二季量產，為其帶來新一波營運成長動能；瑞昱半導體方面，於乙太網路、Wi-Fi、藍牙等領域表現穩健，且受家用與企業級網路需求帶動，營運預計在2025年將持續成長，並透過合作強化高效能網路與無線通信技術，拓展市場商機。

b. IC製造業

2024年隨著技術創新推動整體發展，台灣憑藉3奈米、5奈米技術優勢，持續在全球半導體產業保持領先，並鞏固關鍵供應鏈的地位，主要受惠於AI與高效能運算等應用領域的快速增長，使市場對先進製程的需求持續提升，此外，由於異質整合封裝技術的突破（如FOPLP、2.5D/3D封裝），也為晶片效能提升帶來新的可能性，進一步推動產業升級。根據工研院產科國際所預估，2024年台灣IC製造產值將達新台幣3兆3,957億元，年成長率高達27.5%，顯示台灣半導體業在全球競爭格局中仍保持強勁成長動能。

展望2025年，台灣IC製造產業將在技術革新與終端電子產品創新的雙重驅動下持續攀升，無論是先進製程技術的競爭，亦或是HBM市場的成長，台灣憑藉先進製程技術的領先優勢，為全球半導體產業創造更多成長機會，根據工研院產科國際所預估，2025年台灣IC製造產值預計將突破新台幣4兆，年增率達19.6%。然而面對國際競爭壓力，台灣須在現有優勢下進一步強化供應鏈各環節，並深化與美、日、歐等國的戰略合作，靈活運用產業資源確保台灣半導體在全球市場中維持競爭力。



資料來源：工研院產科國際所 (2024/10)

台積電作為全球半導體代工產業的龍頭，正積極擴充其先進封裝技術CoWoS產能，包括收購群創5.5代廠，以滿足日益增長的AI與高效能運算市場需求，目前台積電以CoWoS-S及CoWoS-L為主，CoWoS-R則相對較少。展望2025年，雖尚無法確認DeepSeek帶來的實質影響，但目前輝

達等大廠皆未傳出砍單消息，顯示對台積電先進封裝技術的高度依賴，整體CoWoS月產能也估計將增至7.5萬~8萬片，其中以CoWoS-L產品線年增470%為主要動能。

c. IC封測業

2024年，隨著半導體製程技術的不斷進步，先進封裝技術成為提升晶片性能和降低功耗的關鍵方法，台灣因擁有強大的技術研發和製造能力，不僅具備先進封裝製程技術，還整合了多家業界領先的封裝和測試廠商，形成完善的供應鏈，鞏固在全球AI、GPU等高階晶片領域的競爭力。台積電在此領域的代表性技術CoWoS成為高效能計算和AI運算領域的重要支柱，同時日月光半導體的FoCoS、矽品精密的FO-MCM以及艾克爾的S-Swift，也為市場提供了多樣化的封測方案，支持高效能晶片的需求。根據工研院的預估，2024年IC封裝和測試業的產值分別為4,233億元和2,002億元，年增幅為7.7%和5%。

展望2025年，先進封裝技術將成為下一代AI、通訊、高效能運算和智慧物聯網等領域的關鍵，並在未來科技競爭中扮演決定性角色，其中台積電將以其先進封裝技術CoWoS為核心，推動晶片發展引領全球半導體廠爭奪新興市場機會，而台灣封測廠也將從中受益，透過強化先進封裝技術，滿足日益增長的市場需求，進一步鞏固台灣在半導體產業的關鍵地位，預期將成為全球半導體產業轉型升級的重要推動力量。

隨著2025年人工智慧晶片帶動先進測試需求，台灣封測廠預期將有明顯成長，代表廠商包括日月光、京元電、力成...等。目前日月光投控在CoWoS先進封裝後段的WoS製程，與台積電密切合作，甚至前段CoW也有產能外溢至日月光控股相關廠商。為滿足市場需求，繼2024先進封裝業績可達五億美元後，日月光投控目標2025年先進封裝業績將持續倍增至十億美元，並占封測業務達10%~15%；京元電則因跟隨前段製程產能擴充持續受惠，目前承接台積電WoS段成品測試（FT），對2025年營收保持樂觀；力成方面，因率先完成面板級扇外型封裝（FOPLP）產線及量產出貨，加上預估未來幾年高階邏輯晶片的異質封裝將採用更多的FOPLP解決方案，因此鎖定FOPLP和TSV CIS（CMOS 影像感測器）等技術進行提升，預計營收將逐年增長，顯見先進封裝產業將持續榮景並更為鞏固台灣領先地位。

設備產業之發展

(1)高科技產業需求有增無減

自動光學檢測是一個能自動提供控制信號的影像分析器，經由影像偵測器，從目的物擷取原始影像，再將取得的影像資料藉由電腦內所設計的演算法則軟體計算處理與特性分析，最後再將取得的運算結果，以數位或類比方式輸出，提供生產者做品質的決策判斷。因此隨著高科技快速發展及奈米科技的創新，產業對精密量測與檢測設備的需求不斷提升，業界將持續研發更高精度、智能化的自動光學檢測技術，以提高檢測效率與準確度，在半導體、顯示器、電子組裝等領域的需求有增無減。

(2)設備國產化

自動光學檢測設備主要應用在平面顯示器、印刷電路板、半導體、先進封裝等領域，而台灣正是這些產業的生產重鎮，過去這些設備主要是掌握在國外少數大廠手中，價格昂貴，且維修不易。但隨著國內設備業者越來越多的投入，加上政府量測中心積極投入AOI技術的研發，成立「自動光學檢測設備聯盟」，

將可加速推動上、中、下游之分工與整合。除此之外，隨著各國貿易壁壘加速成形，設備本土化及技術國有化需求殷切，為了降低採購成本、維修成本等等因素，使政府推動設備倍增計畫，扶植本土機械轉型，使設備自給率及零組件自給率日益提昇，進一步強化產業國際競爭力。

(3)設備功能多樣化

隨著光學檢測技術蓬勃發展，以及半導體製程與電動車等科技的不斷創新，單一功能的設備將逐漸不符合市場需要，自動光學設備未來除了檢驗瑕疵之外，將朝設備多功能演變，如需要同時進行尺寸量測、瑕疵自動分類或是修補瑕疵、Mura檢測、Mura修補等多功能之設備機台，加上晶片與封測產業對精密量測的高標準下，設備必須提供更全面的解決方案，以應對製造業日益多元且複雜的需求。

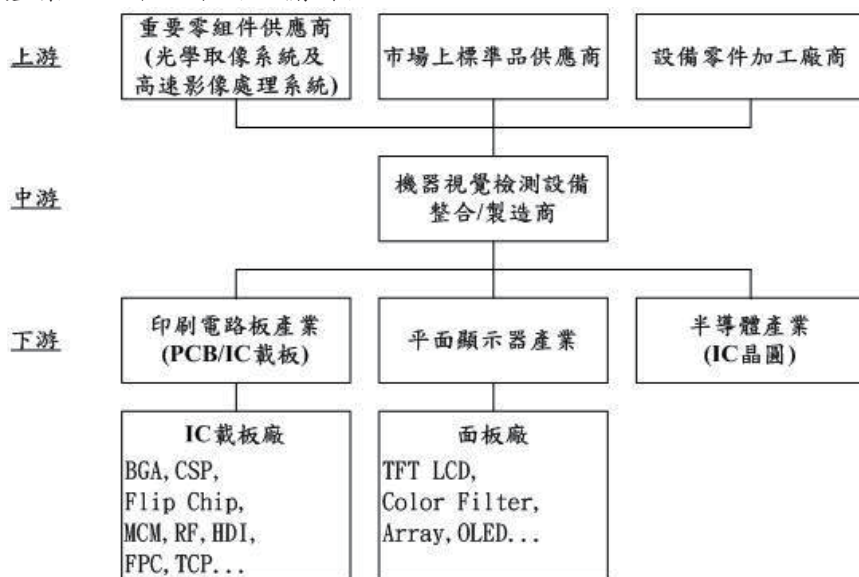
(4)客製化開發

由於現在自動光學檢測設備都是在製程中檢驗，須與其他生產設備相容，而設備採購商各自的發展經驗不同，發展出自有快速提升製程良率的技術，對於檢測設備的應用方式亦逐漸差異。有關檢驗的重點及範圍，由設備採購商提供需求資訊，供設備製造者研發，協助採購者做生產製程技術的改善，利用雙方資源，達成互補的效果。

(5) AI驅動檢測智能化

隨著AI技術進步，自動光學檢測(AOI)正從傳統的高速自動化發展為更智能的檢測系統。相較於需人工定義瑕疵特徵的傳統 AOI，AI 深度學習技術大幅提升缺陷辨識的準確性，並能進行缺陷分析與追蹤，同時優化傳統演算法，解決通用性低及對操作人員依賴度高等問題。此外，生成式AI透過模擬各類瑕疵加速模型訓練與應用，未來將進一步提升檢測的可靠性，推動檢測設備技術邁向更高層次的智能化發展。

2.產業上、中、下游之關聯性



3.產品之各種發展趨勢

(1)從檢查標的物來看

A.檢查面：針對印刷電路板及半導體微小細線化的發展，將從微米(Micrometer)檢測晉升至奈米(Nanometer)檢測；封裝製程演變造成檢測需求趨向 3D 立體或

機械手臂多元應用。而另一方面，針對 TFT-LCD 的檢測，則要兼顧微觀及巨觀(micro 及 macro)的檢查，須檢測缺陷之精度亦不斷提升。

B.輸送面：印刷電路板因應電子產品的日趨輕薄短小，以及軟性電路板的易於翹曲，在傳輸承載上，需擁有穩定精準之傳送功能，及創新高度張力控制傳動機構；TFT-LCD 玻璃基板尺寸朝向大型化發展，則著重大型化玻璃基板移載功能的開發；半導體晶圓則以其高精密度，針對出料/入料機構、移載手臂與載台平整度等皆需求高規格。

(2)從產業別的涉入來看：已從電路板產業(PCB)，跨足光電產業(TFT-LCD/ OLED/ 觸控面板產業)，近來積極進入半導體產業(IC 晶圓及封測)及其他如自動光學導引製造設備等具開創性高科技產業之自動光學檢測設備領域。

4.競爭情形

本公司是國內極少數全力投入此一專業自動光學檢測設備整合/製造領域的公司，隨AOI市場重要性日漸增加，目前產業競爭者來自世界各地，包括日本的Inspec、Shirai、Takano、Kubotek，韓國的ATI、Ajuhitek，臺灣的牧德、聯策，以及國際大廠KLA、Orbotech、Onto、Camtek...等，加上近年中國大陸亦開始大力投入此檢測領域，主要廠商包含南京協辰、宜美智、凌雲、武漢精策...等皆實力不可小覷。

面對如此強勁的競爭對手，本公司除了不斷強化產品的研發及推陳出新外，也善用地利之便(台灣為全球IC載板、半導體封裝、TFT-LCD、觸控面板生產重鎮之一)，提供國內及亞太地區客戶勝出的品質、合理的價格及迅捷的服務，包括領先的檢出能力、新功能的開發、技術支援及維修保固等，充分提升本公司的整體競爭能力。

經過市場長期的測試與考驗後，產品品質穩定性目前已經獲得國內外市場的肯定，打破國際知名大廠獨占且壟斷市場的局面。並於2003年成功銷售至日本及新加坡，2005年開始銷售至韓國及中國大陸，2012年開始銷售至泰國及菲律賓，2020年銷售至德國...在檢測設備的國際舞臺上獲得海內外客戶高度評價。

(三)技術及研發概況

1.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

本公司113年度及截至114年3月31日止之研發費用分別為233,309仟元及59,795仟元。

2.最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

年度	研發成果
113 年度	半導體黃光製程檢測設備
	半導體 IR 內層缺陷檢測設備
	半導體自動巨觀+微觀檢測設備
	半導體面板級封裝檢測設備
	半導體高速 Review 拍照設備
	先進封裝多面檢測設備
	半導體二極體晶圓級檢測設備
	化合物半導體晶圓級檢測設備
	IC 載板 AI 拍照複檢機
	PCB 全版蝕刻量測設備
	PCB 全版阻抗監控設備

(四)長、短期業務發展計畫

1.短期發展計畫

(1)行銷策略方面

- A.加強完善的售後服務制度，鞏固國內現有客源。
- B.蒐集海外市場資訊，積極開拓國際市場。
- C.積極參展提高公司知名度。
- D.搭配不同溝通管道及媒體露出等，強化由田曝光度及口碑。
- E.經由行銷資訊分析、客戶名單管理、後續效益追蹤等，深化由田優勢形象。

(2)生產政策方面

- A.重新檢視生產作業流程，提高採購效率，充分掌握原物料動態。
- B.建立衛星加工體系，除可彈性調度加工生產，亦可減少直接人力，保有知識工作者的生產型態。
- C.推行全面品質管理政策，進行有效成本控管，創造產品利潤，提高競爭力。
- D.緊密維繫與外包商、合作夥伴與相關團體的關係維護，創造多贏局面。

(3)產品研發方向

- A.積極研發新產品，使產品多角化，以開發新市場。
- B.持續投入軟硬體研發人力，從產品機構設計、軟體開發到製造生產，均自行開發，以提高產品附加價值。
- C.加強與上、下游廠商合作，以積極研發高階產品。
- D.持續延伸觸角至 SMT 檢測、車用產品檢測、IC 產品外觀檢測、COF 檢測設備、半導體後段封裝自動光學檢測設備、自動光學導引製造設備等。

(4)營運管理方面

- A.導入全面電腦化作業系統，簡化工作流程，提高管理績效。
- B.積極培訓研發、技術、業務及經營管理人才，厚植公司人力資源，強化公司競爭力。
- C.公司已為上櫃公司，以吸引人才及資金，使公司之營運更為穩健。
- D.強化「機器視覺」之廣泛研發與創意應用整合，培養相關視覺、光學、軟體、機械...等專業人才，並加強與產官學界之技術交流。

(5)財務管理方面

- A.與往來金融機構建立密切關係，掌握金融市場脈動，提高財務運用績效。
- B.根據中長期資金需求計劃，在安全穩健的原則下，進行短期財務規劃。
- C.於資本市場上獲取公司成長所需之長期資金，擴展公司之營運規模。
- D.積極配合政府相關計畫，獲得政府補助開發及租稅減免，並申辦政府低利研發貸款。

2.長期發展計畫

(1)行銷策略方面

- A.以利基型產品導入市場，獲取較高利潤。
- B.以多角化之產品進入印刷電路板(PCB 及 IC Substrates)、TFT-LCD/OLED/觸控面板及半導體(Semiconductor)等各大產業，分散獲利來源及投資風險。
- C.積極與國外廠商建立合作關係，開拓海外市場。

(2)生產政策方面

- A.有效整合原物料的供應，以期自原物料採購到上線生產乃至品質檢驗、交期配合及各項流程均能順利進行。
- B.與外包廠商及原物料供應商策略聯盟，確保產能及原料取得之無虞。

- C.深植外包廠商品質檢驗觀念，確保加工品質無虞，以利後續製程順利進行，配合交期準時出貨。
- D.整合上下游供應鏈及廠商，達成有效又緊密的合作夥伴關係。
- E.秉持生產程序標準化、產品品質標準化之目標，提高各段流程效能。

(3)產品研發方向

- A.拓展機器視覺技術在半導體及太陽能相關產業檢測上的應用。
- B.加強產品研發人力及資源投入，提升產品品質、拉大與競爭廠商之利基差異。
- C.針對工業 4.0 及大數據盛行，提供有效檢測數據統整及追蹤。
- D.持續聚焦高附加價值產品之開發，同時對現有產品進行優化以維持高市場競爭力。

(4)營運管理方面

- A.定期人員培訓，提升工作效率及專業技能累積。
- B.提供安全舒適之工作環境，使員工能安心發揮所長。
- C.提供完善的福利及管理制度，秉持永續經營的理念，建立企業文化，凝聚公司團隊向心力。
- D.掌握外部環境變化，靈活創新搭配需求，憑藉地緣關係，在台灣、中國、韓國、日本、及東南亞地區不斷深化合作關係。
- E.提高客戶依存度，達成擴大市佔率及維持公司成長之目標。
- F.持續開發代理商以深耕各區域事業發展。

(5)財務管理方面

- A.除以獲利創造營運資金外，並搭配金融機構之貸款，挹注未來發展所需資金。
- B.加強公司全面性財務規劃，以降低營運風險，提升市場競爭優勢。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元

銷售地區 \ 年度	113 年度	
	金額	%
內銷	594,560	32.10
外銷	1,257,413	67.90
合計	1,851,973	100.00

(1)印刷電路板產業(PCB/IC 載板)的自動光學檢測設備市場。

銷售對象主要為印刷電路板產業（PCB/IC載板）的載板、軟板、HDI、覆晶基板、COF等各大廠，客戶遍佈台灣、中國大陸、日本、泰國、馬來西亞、菲律賓、新加坡…等地區。

(2)平面顯示器產業的自動光學檢測設備市場

銷售對象主要為TFT-LCD產業之面板廠及觸控面板廠，最終客戶主要分布在台灣及中國大陸地區。

(3)半導體自動光學檢測設備市場

銷售對象主要為半導體委外封測(OSAT)廠商，客戶遍佈台灣、中國大陸及東南亞等地，並積極開拓其他海外市場。

2.市場占有率及市場未來之供需狀況與成長性

(1)市場占有率

本公司為研發、產銷自動光學檢測設備之專業廠商，在PCB/IC載板檢測設備類產品主要有IC載板自動光學檢測設備、覆晶載板自動光學檢測設備、

PCB(HDI)自動光學檢測設備、軟板自動光學檢測設備等，在平面顯示器檢測設備類產品則有TFT-LCD點燈檢測設備及CF(彩色濾光片)、PI(配向膜)、Seal(框膠)、Array自動光學檢測設備、Mura自動檢修設備...等，於半導體檢測則專注晶圓級封裝之相關高階檢測設備。目前國內外未有針對明確分類之市場占有率調查報告，故本公司就往來客戶與其同業之機台採用情形，說明公司產品於國內之市場約略占有率及相關同業之競爭情形如下：

A.PCB/IC 檢測設備類產品

a.IC 載板出貨前成品自動光學檢測設備

IC載板出貨前成品自動光學檢測設備方面，兩岸主要廠商均向本公司採購，例如南亞電、景碩、欣興、日月光、臻鼎、深南...等採用該類檢測機台之情形，本公司產品占有極高市占率。而在國外市場方面，日本及韓國係IC載板主要生產國，惟客戶共同特性均偏向使用其國產化設備，故初期不易打入該市場，之後透過當地代理商搭配本公司累積之檢測能力，而有銷售至日本、韓國及新加坡大廠之成。

b.覆晶基板自動光學檢測設備

國內主要覆晶基板生產廠商如南亞電及景碩等所使用之該檢測設備，均全數為本公司所生產，故可推論本公司在國內占有極高之市占率。在國際市場上，已成功導入日本大廠及韓國SAMSUNG，但以日韓市場對來自海外檢測設備之保守採購態度而言，估計其市場占有率仍低。在同業方面，國內市場尚無競爭者，日本及韓國市場之競爭對手計有Santec、Inspec及ATI。

c.PCB 自動光學檢測設備

PCB產品包含主機板、汽車板、音響板等，本公司主打高階細線路PCB檢測設備，目前兩岸主要板廠已陸續導入本公司檢測設備，競爭對手包含日本Shirai、牧德、聯策、南京協辰、宜美智...等。

d.軟板自動光學檢測設備

軟板因應產品材質特性，在機構及檢測上皆要求更高精準度，國內軟板大廠臻鼎、台郡等皆採用本公司所生產之機台，擁有極高之市場占有率，國內外競爭對手包含日本Shirai、牧德、聯策...等。

B.平面顯示器檢測設備類產品

a.TFT-LCD 點燈自動檢測設備

以面板廠中對檢測段之製程而言，LCD點燈自動檢測設備取代傳統人工目視檢查是一個創新的製程改善方式，國內市場中，已大量導入LCD製程包含Cell段及Module段等製程，而2008年開始本產品亦已導入中國大陸面板大廠。

b.彩色濾光片、配向膜、框膠自動光學檢測設備

本公司已成功導入群創、友達、中國大陸各大高世代面板廠包含京東方、天馬、惠科及華星光電等，現階段最大尺寸為10.5代。主要競爭者含日商Takano、Kubotek、韓商DIT，國內尚有晶彩及宏瀨為LCD自動化光學檢測設備競爭者。

c.觸控面板/保護玻璃檢測設備類產品

本公司觸控面板及保護玻璃自動檢測設備，已成功導入群創、宸鴻、勝華、昊信、雅士等兩岸大廠。目前市場主要競爭廠商包含Orbotech、日商SHIBAURA，國內尚有德律、晶彩、宏瀨、均豪等檢測設備競爭者。

C.半導體檢測設備類產品

a. 晶圓級封裝檢測設備

本公司針對高階晶圓級封裝、Fan-Out扇外型封裝、CoWoS、Bumping等開發一系列自動檢測設備，成功導入台灣一線封裝大廠體系，並挾帶產品優勢快速複製成功經驗，於兩岸及東南亞進行銷貨。市場主要競爭者包含Onto、Camtek、牧德等。

(2) 市場未來之供需狀況與成長性

台灣印刷電路板廠商及平面顯示器廠商在面對南韓廠商之價格競爭，及未來可能面對更具價格競爭力的大陸業者，應對策略不外乎朝生產尖端科技產品及降低單位生產成本以維持產品毛利的方向發展，其中降低生產設備成本及減少直接人工成本即是大宗。

本公司為一本土化之公司，隨未來市場需求逐步成長，以技術服務優勢提供具價格競爭力的客製化創新研發產品，大量取代直接人工，降低廠商生產成本，正可迎合未來相關產業發展的市場需求。

本公司在PCB檢測領域之主要產品，係針對PCB、軟板及各式IC載板及覆晶基板，包含BGA(Plastic BGA、Cavity Down BGA、Tape BGA、Tiny BGA、Flip Chip PBGA)、Flexible Print Circuit、Flip Chip、CSP、MCM、RF Module、FPC、TCP、TCSP、COF...等均可檢測。且市場亦由台灣跨入日本、韓國、馬來西亞、泰國，並已銷售至PCB產能最大的中國大陸市場。

隨著景氣循環，國內外高世代大尺寸面板產業擴產及升級優化商機仍在，本公司TFT-LCD製程的PI、Seal、Burr Check以及Color Filter各世代檢測機台和各尺寸API自動點燈檢查機，已提供現有客戶最佳解決方案，Mura自動檢修設備更輕鬆協助達成高產能、高良率的目標。另外近年快速崛起的OLED面板、Mini LED顯示，本公司亦有一系列對應解決方案可協助有效進行品質把關。在既有市場的占有率及品質的優勢下，除了持續開拓台灣市場外，亦積極將觸角延伸至中國大陸面板廠，目前深耕加強在地化周全的客服系統，設備之品質與服務之專業已獲得客戶高度肯定。

台灣於封測產業具全球領先地位，本公司看準此市場推出半導體檢測設備，以獨家光學技術與高端邏輯演算能力，打破歷年來外資廠商獨大半導體檢測市場之傳統，率先打入一線封裝大廠，檢測能力已獲客戶認證，可望成為下波公司主要成長動能。

3. 競爭利基

本公司是國內極少數全力投入此一領域-「自動光學檢測設備整合／製造」的公司，茲就本公司之競爭利基分析如下：

(1) 技術

本公司在影像處理領域中Vision辨識的技術開發，已累積了三十年經驗。後經結合了機械、控制、光學及軟體模組而成為自動光學檢測設備研發整合／製造商，不僅提高了自製水準，更大幅提升了自行研發的能力。目前結合軟硬體技術所開發出之多項裝置也已取得了國內外的專利。

(2) 人才

無論是技術職或管理職，本公司均積極提供員工專業的教育訓練，增進各職位所需之專業知識，以面對不斷進步變遷的大環境，達到理論與實際結合應用的目標。而這些專業的人才，正是公司不斷開創新產品的原動力，並和公司之發展一起與時俱進。

(3) 產品

本公司累積豐富之自動光學檢測設備研發整合／製造技術，跨足多項科技產

業，可隨時視其產業景氣變動，彈性調整產品行銷策略，可有效避免因單一產業景氣循環波動而影響營運的風險。

(4)價格

本公司經不斷地研發及引進新技術提高自製率，目前量產已達規模經濟，可有效降低生產成本，以合理的利潤反應價格。

(5)服務

本公司從產品之研發、設計、整合到銷售，除了有形的設備產品外，更積極培養專業的客服工程師提供客戶無形的技術服務，以Total Solution達成解決客戶問題的全方位服務，為公司在市場競爭力上再加一分。

4.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素

A.全球資訊及通訊市場蓬勃發展

近年來隨著網際網路興起，多媒體應用領域擴大，以及世界各國推動資訊化基礎建設並開發通信市場，帶動了全球個人電腦及行動電話等資訊、通訊產品及其週邊產業蓬勃發展。而 IC、PCB、IC 基版、TFT-LCD 模組等均是電子產品中必要之相關元件，而生產過程中各流程間之品質管理更是針對其後製程良窳的一個把關口，為了節省龐大的目檢人員費用及維持精確之檢驗標準，全面化的自動光學檢測設備將是未來品質管理的趨勢。

B.跨足多項國內重點發展之科技產業

本公司產品所跨足之產業涵蓋素有「電子產品之母」之稱的電路板產業、半導體產業及平面顯示器產業，未來將持續進行相關產品之研發。

C.擁有多次研發創新技術經驗之優秀研發團隊

為因應不斷創新及開發新產品的需求，本公司致力招募並培育研發人才，積極參與政府鼓勵中小企業開發新技術推動計畫，計有「基板檢測及出貨管理機開發計畫」、「全自動捲帶式軟性電路基板外觀檢測機台開發計畫」及「FCBGA 外觀檢測機台開發計畫」等。目前各計劃均已開發完成，導入量產階段。PCB 產業中之「Flip Chip Substrate 雙面高速檢測設備」及 LCD 產業之「TFT LCD Array 瑕疵檢測設備」與「LCD Seal 製程多功能檢測設備」與「Flip Chip 高速雙面自動外觀檢測設備」亦獲得經濟部工業局主導性計畫的認可，奠定本公司另一利基型事業。

本公司主要經營階層及研發人員均長期投入自動光學檢測設備的領域，對於此產業環境及趨勢有深刻之瞭解，且具有依客戶需求自行研發製造多元化產品的能力，可充分滿足客戶市場之需求。

D.符合國家發展新興重要策略性產業

本公司之崛起，不僅滿足國內廠商在機器視覺檢測功能上及降低成本上的需求，並改變國內生產廠商長期仰賴國外壟斷報價的進口設備及動輒耗時等待數月的技術服務。自動光學檢測設備的本土化也使得想建立國內自給自足設備供應鏈的目標更向前邁進一步。本公司於民國九十年經經濟部審核通過為「自動化工程服務機構」，正式成為國家發展新興重要策略性產業的一員。

E.快速即時的服務效率

由於本公司身處電子及通訊產業元件大量生產的亞洲，而台灣、日本和韓國更是主要目標客戶群的所在地，所以本公司向來能以最快速及時的服務效率提供客戶最佳的解決方案，此地利之便乃競爭對手迄今望塵莫及的一大優勢。

(2)不利因素與因應對策

A.重要原材料需自國外進口

自動光學檢測設備之關鍵零組件均需自國外進口，如光源照明裝置、取像影像處理器(影像擷取卡)及 CCD/CMOS 攝影機(類比/數位)等均是直接向國外廠商採購，無論新購或維修，交期可能較長，且成本較高。

因應對策：

- 和供應商保持良好之關係，達到即時的消息流通及穩定的貨源供應。
- 尋求相近功能及品質之替代品，以分散貨源遭壟斷或不足之風險。
- 搭配生產計劃下單採購，並維持彈性庫存量，以因應臨時需求時之使用。
- 加強與國內廠商的研發合作，提供需求資訊，以期能就地採購。

B.需要投入大量研發資金以保持競爭力

本公司所處之產業和各相關產業均為高科技發展的產業，是技術高度密集的產業，面對的市場環境變遷迅速，所以需不斷的投入大量研發資金以保持競爭力。

因應對策：

- 積極參與國家發展計劃，申請開發新技術補助經費，達到國家與產業雙贏的目標。
- 從資本市場獲取長期資金投入研發，保持公司競爭力。

C.國內廠商投入者日益增加，恐造成價格競爭的壓力

由於近來 PCB/IC 載板及半導體產業景氣看好，國內設備業者紛紛看好而投入研發，導致投入者日益增加，未來可能有削價競爭的可能性。

因應對策：

- 持續投入研發新產品，以技術能力創造智慧財，以避免與同業的競爭。
- 與客戶保持良好關係，以期使能取得客戶現在和未來需求，以便掌握產業脈動與時間，領先同業推出新產品。

D.產業特性造成應收帳款收現時間較長，不利資金運作

設備業一般按交機及驗收完成收款，驗收時間將達一年以上，本公司目前之資本規模尚小，在營收成長的過程中，恐面臨大量的營運資金需求。

因應對策：

- 利用銀行的資金彌補資金的需求。
- 從資本市場獲取低成本的長期資金，以滿足公司的營收成長所需。

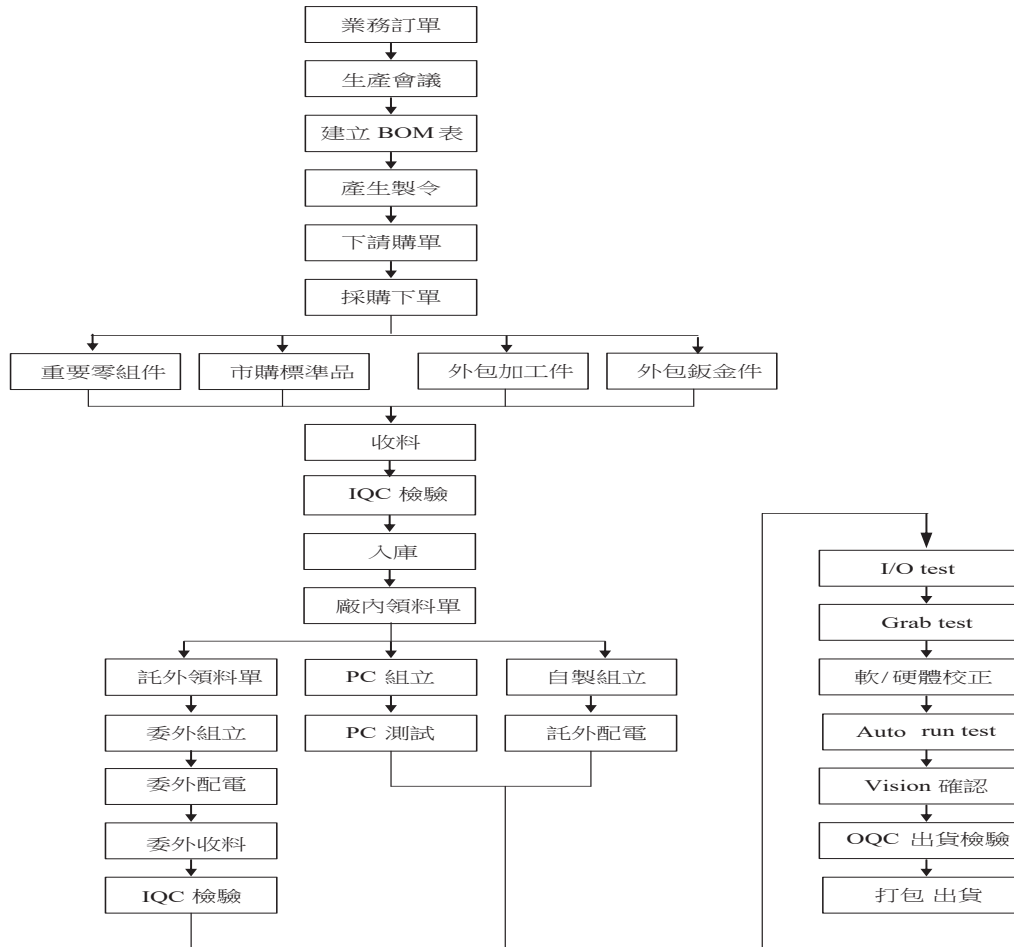
(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

主要產品項目	主要功能
IC 載板出貨前成品(Strip Type)自動光學檢測設備	IC 載板(Strip Type)表面瑕疵檢查
Flip Chip 自動光學檢測設備	IC 載板(Flip Chip)表面瑕疵檢查
堆疊式/彈匣式兩用 SiP 自動光學檢測設備。	IC 載板(SiP)堆疊式/彈匣式外觀瑕疵檢查
IPQC 跨製程自主檢查模組	PCB 跨製程智慧檢查
PCB 製程中自動光學檢測設備	PCB 表面瑕疵檢查
PCB AFVI 自動最終檢測系統	PCB 最終出貨前表面瑕疵檢查
PCB 在線/離線線路檢查設備	PCB 製程中線路檢查
PCB 高速檢孔設備	PCB 雷射盲孔/通孔檢查
半自動 PCB 外觀檢查機	PCB 外觀瑕疵檢測
類載板自動光學檢測設備	SLP 外觀瑕疵檢測
Mini LED 載板檢量測複合機	Mini LED 載板檢測量測

主要產品項目	主要功能
CWV 雷射銅面清潔機	雷射銅面瑕疵清潔
全板線寬線距量測機	2D 全板線寬線距量測
全板線寬線距線高量測機	2D/3D 全板線寬線距線高量測
COF Tape 卷對卷自動外觀檢查機	COF Tape 外觀瑕疵檢測
COF Chip 卷對卷自動外觀檢查機	COF Chip 外觀瑕疵檢測
Roll to Roll 軟板線路檢查設備	捲對捲軟板線路檢查
Roll to Roll 軟板檢孔設備	捲對捲軟板盲孔/通孔檢查
半導體自動光學檢測設備	半導體外觀暨線路檢測/量測設備
晶圓級/面板級封裝檢測設備	半導體 IR 內層缺陷檢測設備
半導體後段封裝視覺檢查系統	IC Lead Frame 斷腳檢測系統
Array 自動光學檢測設備	LCD 顯示器 Array 段檢查
Color Filter 彩色濾光片自動光學檢測設備	LCD 顯示器 Color Filter 檢查
Color Filter 彩色濾光片自動複檢系統	LCD 顯示器 Color Filter 自動複檢系統
PI 配向膜自動光學檢測設備	LCD 顯示器 Cell 段 PI 檢查
Seal 框膠自動光學檢測設備	LCD 顯示器 Cell 段 Seal 檢查
偏光膜自動光學檢測系統	偏光膜自動缺陷檢測
Digital Macro Mura 自動光學檢測系統	Mura 瑕疵檢測
Mura 自動檢修設備	Mura 自動檢測及補償
Burr Check 毛邊檢測機	毛邊檢測
Bare Glass AOI 表面檢/端邊檢。	素玻璃表面/端邊瑕疵檢測
AKKON 自動光學檢測設備。	導電粒子檢測
OLED 面板自動光學檢測設備	OLED 面板瑕疵檢測
觸控面板檢測設備	Touch Panel ITO 玻璃線路區/玻璃區缺陷檢測
保護玻璃檢測設備	素玻璃、網印玻璃缺陷檢測
自動/半自動點燈檢測設備	API 自動/半自動點燈檢測
面板點燈檢測模組	模組段面板檢查模組
LCM 來料檢查機/最終成品檢測設備	來料及最終成品缺陷檢測
外觀光學六面檢測設備	最終成品外觀多面瑕疵檢查
OD/膜厚/色度量測設備	In-Line / Off line 色度膜厚量測
自動光學導引製造設備	傳統產業智慧製造
AI 自動拍照機	AI 影像深度學習及缺陷分類功能
AI 深度學習系統	缺陷分類判讀與問題溯源

2.產製過程



(三)主要原料之供應狀況

主要原料	供應情形
電腦系統設備	良好
線性滑軌及螺桿	良好
燈源攝影機	良好

(四)主要進銷貨客戶名單

- 最近二年度任一年度中曾占進貨百分之十以上之廠商名稱及其進貨金額與比例，及其增減變動原因：

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率%	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率%	與發行人之關係
1	B001	84,088	11.22	無	B001	54,700	9.55	無
	其他	665,671	88.78		其他	517,778	90.45	
		749,759	100.00			572,478	100.00	

變動說明：

本公司最近二年度僅一家進貨廠商金額達百分之十以上，進貨供應廠商較為分散，進貨來源尚稱穩定，不致過度集中。

2.最近二年度任一年度中曾占銷貨百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，及其增減變動原因

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率%	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率%	與發行人之關係
1	A020	295,038	14.68	無	A003	569,052	30.73	無
2	A002	277,101	13.79	無	A002	170,722	9.22	無
3	A003	65,279	3.25	無	A020	10,171	0.55	無
	其他	1,372,392	68.28		其他	1,102,028	59.50	
		2,009,810	100.00			1,851,973	100.00	

變動說明：

本公司銷售自動光學檢測設備，均是以客戶之需求為主，故若當年度該客戶有無擴廠或汰換設備計劃，將影響銷售金額。

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

年度		112 年度	113 年度	截至 114 年 4 月 30 日止
員工 人數	經理人員	25	24	32
	間接員工	363	331	294
	直接員工	48	38	38
	合計	436	393	364
平均年歲		36.99	37.87	38.52
平均服務年資		6.66	7.65	8.02
學歷 分布 比率 %	博士	—		
	碩士	27.30	27.23	27.47
	大學(專)	70.87	71.5	71.43
	高中職	1.83	1.27	1.1

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：本公司最近年度及截至年報刊印日止未有因污染環境而遭受之損失。

五、勞資關係

(一)列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

1.員工福利措施、進修及訓練

(1)本公司員工一律參加勞保、健保，退休金給付等一般福利，另公司提供之福利計有：發給年節各項獎金、提案獎金、員工酬勞分配、伙食費補助、實施員工教育訓練、團體保險(住院、醫療、癌症、職災)、年度健檢。

(2)本公司依法成立職工福利委員會，遴選福利委員辦理職工福利，而每年皆訂定

年度計畫及預算編列、舉辦尾牙活動、辦理年節贈禮、舉辦每季員工聚餐、員工年度旅遊活動、舉辦健康促進活動、生日禮金、生育及婚喪補助等活動，期使員工無後顧之憂地共同為公司發展而努力。

- (3)建立員工認股權制度，使員工成為公司股東，加強員工對公司的向心力，使勞資雙方共享盈虧。
- (4)教育訓練：本公司以機器視覺與機電整合技術為核心技術，秉持著「We serve with vision」的信念，全面提升員工專業技能、工作效率及產品品質為目標，制定年度教育訓練計劃，並依核心、管理、專業職能模組，在兼顧公司發展及同仁滿足的需求下，分別展開標準化、階層別與部門別之訓練課程，依照個人及職涯所需與公司發展及職涯需要，提供多元豐富的學習管道與發展資源。本公司 113 年度舉辦之內/外部教育訓練課程列舉如下：

性質	課程名稱
外部教育訓練	「公司治理-董監事暨公司治理主管初任進修課程」系列認證課程
外部教育訓練	「急救人員」安全衛生教育訓練
外部教育訓練	2024年全球及台灣經濟展望
外部教育訓練	破框思考與問題解決
外部教育訓練	如何運用大數據強化稽核作業
外部教育訓練	企業弊案中特殊背信罪之構成要件與案例解析
外部教育訓練	如何解析企業財務關鍵資訊 強化危機預警能力
外部教育訓練	掌握ChatGPT進行道德駭客攻擊和滲透測試
外部教育訓練	企業初任內部稽核人員職前訓練研習班
內部教育訓練	先進封裝知識介紹
內部教育訓練	ISO27001資安制度宣導與資安新知課程訓練
內部教育訓練	問題辨識與分析解決
內部教育訓練	起重機械操作人員暨吊掛作業人員在職教育訓練
內部教育訓練	職場性騷擾防治攻略

2.退休制度

本公司配合法令規定，自民國 94 年 7 月 1 日起按規定為新進員工及選擇適用新制退休金條例之原有員工，依員工每月工資適用級距 6%之提繳率，提撥至勞保局退休金個人專戶，另依自願提繳率自員工每月薪資中代扣繳至勞保局退休金個人專戶。同時繼續為選擇適用舊制退休金辦法之員工及選擇新制退休金條例之員工的舊制保留年資，按勞動基準法提撥適額之退休準備金至台灣銀行專戶，保障員工之權益。

員工退休規則：

- (1)適用範圍以本公司不定期契約之正式員工為限。臨時契約、定期契約或特聘人員不適用。
- (2)員工合於下列情形之一者，得自請退休。(a)工作 15 年以上，年滿 55 歲者。(b)工作 25 年以上者。(c)工作 10 年以上，年滿 60 歲者。
- (3)員工有下列情形之一者，本公司得強制退休。(a)年滿 65 歲者。(b)心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者。前項第一款所規定之年齡，對於擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作者，本公司得報請中央主管機關核准調整，但不得少於五十五歲。

(4)員工工作年資以服務本公司為限，但受指派至本公司關係企業者，其年資應予併計。

(5)公司應給付員工適用勞動基準法退休金規定之退休金，自員工退休之日起三十日內給付之。

3.勞資間之協議與各項員工權益維護措施

本公司勞資雙方關係和諧，溝通管道暢通，並以相關法令為基礎，每個部門主管與部屬之間，透過管理會議、電子郵件、教育訓練、社團活動之意見交流，維持勞資雙方良好互動關係，無重大勞資糾紛事項。

本公司依勞基法及其他相關法規維護勞工合法權益，透過完善的內部網站，載明各項管理辦法，明訂員工權利義務及福利項目，提供員工申訴管道，並增加多元化教育訓練、強化員工健康，提升檢查品質及保障、提供優質上班環境及增進同仁良性關係。

(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：本公司最近年度及截至年報刊印日止未有因勞資糾紛所遭受之重大損失。

六、資通安全管理

(一)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。

1.資通安全風險管理架構

為提升資訊安全管理，本公司已成立資安專責單位，負責制定資安治理政策，監督資安管理運作情形，並每年至少一次向董事會報告資安治理情況。

2.資通安全政策

(1)目的：為了強化資安管理，確保所屬之資訊資產的機密性、完整性及可用性，以提供本公司之業務持續運作之資訊環境，並符合相關政府法規與內外部利害相關者之要求，使其避免遭受內、外部的蓄意或意外之任何威脅，達到資訊安全。

(2)目標：

A.確保本公司資訊作業能正確、完整、可用的持續營運。

B.確保本公司重要資訊之機密性，落實資料存取控制，資訊須經授權人員核可方能存取，不得逾越。

C.符合法令與法規要求。

3.管理方案

(1)新進同仁須參與資訊安全教育訓練以提昇資訊安全防護之認知觀念，公司定期執行資訊安全宣導作業。

(2)建立安全、可靠的資訊系統環境，使本公司業務得以永續經營。

(3)重要資訊系統或設備應建置適當之備援或監控機制並定期演練，維持其可用性。

(4)裝設有防火牆及其他相關資訊安全設備及必要的安全防護措施，以防止網路非法入侵、破壞或資料竊取。

(5)同仁之個人電腦應安裝防毒軟體且定期確認病毒碼之更新，並禁止使用未經授權軟體。

(6)同仁個人持有之帳號、密碼與權限應善盡保管與使用責任並定期換置。

(7)設計適當之資訊安全事件的回應及通報程序，以能適當對資訊安全事件做立即

反應，避免傷害擴大。

(8)公司已每年定期進行資訊安全風險評估及資訊安全稽核作業，確保管理有效性並符合法令規範，故資安風險非屬公司重大營運風險，暫無投保資安險之需求。

(9)為提升資訊安全管理的強度，公司已於 112 年取得 ISO 27001「資訊安全管理系統國際標準」驗證，將相關標準衍生出的資訊安全作業模式與準則化成日常資訊作業的遵守原則落實執行，使資訊安全防護臻於完善。

4.投入資通安全管理之資源

(1)網路硬體設備更新新世代防火牆、提供入侵防護系統、病毒偵測與攔截、郵件防毒、網頁過濾、上網行為分析、IoT 偵測服務、產業攻擊資料庫等。

(2)軟體系統更新企業端點安全解決方案、提供防毒，應用程式、周邊、上網行為控管、完整磁碟加密等。

(3)投入人力如：每日各系統狀態檢查、每週定期備份及備份媒體異地存放之執行、每年系統災難復原執行演練、每年對資訊循環之內部稽核。

(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：本公司最近年度及截至年報刊印日止未有因重大資通安全事件所遭受之損失。

七、重要契約

列示截至年報刊印日止，仍有效存續及最近年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響股東權益之重要契約之當事人、主要內容、限制條款及契約起訖日期。

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
長期借款	彰化銀行	109.05.05~124.05.05	抵押借款	提供土地、房屋質押
長期借款	國泰世華銀行	109.09.02~124.09.02	抵押借款	提供土地、房屋質押
長期借款	兆豐銀行	111.07.06~126.07.06	抵押借款	提供土地、房屋質押

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	差異	
			金額	%
流動資產	2,948,131	2,460,492	(487,639)	(16.54)
不動產、廠房及設備	1,191,249	1,256,896	65,647	5.51
無形資產	2,259	1,803	(456)	(20.19)
其他資產	454,313	489,203	(34,890)	(7.68)
資產總額	4,595,952	4,208,394	(387,558)	(8.43)
流動負債	1,269,751	970,419	(299,332)	(23.57)
非流動負債	673,378	569,908	(103,470)	(15.37)
負債總額	1,943,129	1,540,327	(402,802)	(20.73)
股本	598,507	598,507	0	0.00
資本公積	495,370	375,669	(119,701)	(24.16)
保留盈餘	1,590,273	1,732,063	141,790	8.92
其他權益	(31,327)	(38,172)	(6,845)	21.85
權益總額	2,652,823	2,668,067	15,244	0.57
重大變動項目說明(前後期變動達20%以上，且變動金額達新台幣一千萬元者)：				
1.流動負債及負債總額:主係本期合約負債及當期所得稅負債較去年減少，以致本期流動負債及負債總額較去年減少。				
2.資本公積: 本期資本公積較去年減少，主係因資本公積配發現金股利所致。				

二、財務績效

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入淨額	2,009,810	1,851,973	(157,837)	(7.85)
營業成本	839,046	850,643	11,597	1.38
營業毛利	1,170,764	1,001,330	(169,434)	(14.47)
營業費用	794,974	810,912	15,938	2.00
營業淨利	375,790	190,418	(185,372)	(49.33)
營業外收入及支出	2,537	131,473	128,936	5,082.22
繼續營業部門稅前淨利	378,327	321,891	(56,436)	(14.92)
所得稅費用	64,098	5,333	(58,765)	(91.68)
繼續營業部門稅後淨利	314,229	316,558	2,329	0.74
其他綜合損益稅後淨額	(416)	(2,061)	(1,645)	395.43
綜合損益總額	313,813	314,497	684	0.22
增減變動比例變動達20%，且增減變動金額達新台幣一千萬元者之分析說明：				
1.營業淨利：本期營業收入較上期減少，致本期營業淨利皆較上期減少。				
2.營業外收入及支出：本期因匯率影響，兌換利益較上期大幅增加，且本期因出售晶彩科股票，產生處分投資利益，以致其他利益及損失較上期增加，綜合上述，本期營業外收入及支出較上期大幅增加。				
3.所得稅費用：本期核定 111 年營所稅及估列 112 年營所稅之投資抵減，產生所得稅利益及本期稅前淨利較上期減少，致本期所得稅費用較上期減少。				

三、現金流量

(一)113 年度現金流量情形分析說明

單位：新台幣仟元

	112 年度	113 年度	變動金額	變動率%
營業活動	497,639	345,613	(152,026)	(30.55)
投資活動	14,541	(60,156)	(74,697)	(513.70)
籌資活動	(567,191)	(382,805)	184,386	32.51

- 1.營業活動淨現金流入減少：主係因本期稅前淨利減少，故本期營業活動之淨現金流入較上期減少。
- 2.投資活動淨現金流出增加：主係因裝修平鎮廠陸續認列未完工程，使得取得不動產、廠房及設備增加，以致本期投資活動淨現金流出較上期增加。
- 3.籌資活動淨現金流出減少：主係因本期股利發放總額較上期減少，以致本期籌資活動現金流出較上期減少。

(二)流動性不足之改善計劃

1.流動性分析

年度 項目	112 年度	113 年度	增(減)比例%
現金流量比率	39.19	35.61	(9.13)
現金流量允當比率	77.89	95.19	22.21
現金再投資比率	(0.32)	1.38	531.25

增減比例變動分析說明：

本期因稅前淨利減少，營業活動淨現金流入較上期減少，致本期現金流量比率較上期減少。因最近五年度營業活動淨現金流量總額較上期增加，致本期現金流量允當比率較上期增加。另，因112年度發放現金股利總額較多，致112年度現金再投資比率為負，本期無此情事故較上期增加。

2.流動性不足之改善計劃

本公司目前營業活動現金流量呈現淨流入狀態，且公司現金及約當現金尚屬足夠，故並無流動性不足之問題。惟本公司仍將持續追蹤期間較長之應收款項，並適時與客戶洽談較佳之收款條件，以降低現金流動性之風險。

3.未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	預估現金流出	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
502,862	130,000	(650,000)	(17,138)	—	銀行借款 200,000 仟元

流動性分析說明：

本公司預估113年淨現金流出520,000仟元，致現金不足數額17,138仟元。本公司擬向銀行舉借資金以改善現金不足之情事。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無此情事。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一)最近年度轉投資政策

本公司對轉投資之管理訂有明確之政策，對關係企業及特定公司訂有「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」，另針對子公司之管理，除於本公司投資循環作

業有規範外，另訂有「子公司監督及管理辦法」以規範子公司之各項作業。子公司除定期需提供財務報表及分析報告，且不得有背書保證及資金貸與他人情事，使本公司得以充分掌握子公司之財務及業務運作。未來隨著子公司之營運規模日益擴增，本公司亦將不定期指派財務及稽核人員前往子公司實際作業情形及營運狀況，並抽核內控作業之執行情形，並向母公司報告以落實管理。

(二)最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因、改善計劃

單位：新台幣仟元

被投資公司	說明	實際投資金額	政策	本期認列投資損益	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
UTECHZONE GLOBAL CORP.		371,452	投資業務	30,033	該公司主係從事轉投資事業，費用部分僅有年費及銀行手續費等費用產生，所認列之投資損益主係因認列轉投資公司之損益。	無
科吉凱亞(股)公司		105,000	電子相關設備銷售	(90)	主係外幣兌換損益所致。	無
學文科技(股)公司		34,569	投資業務	—	該公司主係投資公司，尚無投資收入產生。	無
宙福投資(股)公司		5,000	投資業務	(19)	該公司主係投資公司，尚無投資收入產生。	無

(三)未來一年度投資計劃：無重大投資計劃。

六、風險事項分析評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1.利率變動對公司營收獲利之影響及公司因應利率變動之具體措施

本公司利息收入及利息支出佔營業收入之比率甚微，對公司損益尚無重大不利影響。本公司與往來銀行保有良好之授信往來關係，未來公司將密切注意利率之變動，並積極與往來銀行爭取最低之利率。另本公司未來除仍基於保守穩健原則，審慎運用閒置資金外，並將持續致力改善財務結構，以有效控制資金成本。

2.匯率變動對公司營收獲利之影響及公司因應利率變動之具體措施

本公司匯兌損益大部分來自外幣資產及外幣負債依資產負債表日之匯率重新評估後，所產生之未實現兌換利益或損失。本公司外匯政策以保守穩健為原則，重大外銷、外購均以外幣報價，除採外幣收支互抵之自然避險方式外，並將與金融機構保持密切關係，針對外幣淨資產部位，隨時參酌銀行分析報告，持續觀察匯率變化，以有效因應匯率變動對公司損益之影響。

3.通貨膨脹對公司營收獲利之影響及公司因應通貨膨脹之具體措施

本公司產品非一般民生消費性產品，因此通貨膨脹對本公司並無重大影響，且本公司隨時掌握上游商品的價格變化情形，以減少因成本變動而對公司損益的影響。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

1.高風險、高槓桿投資之執行情形及未來因應措施

本公司專注於本業之經營，不從事高風險、高槓桿之投資。

2.資金貸與他人之執行情形及未來因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無資金貸與他人之情事，未來若因業務需要而遇有需進行資金融通之必要，亦將依本公司訂定之「資金貸與他人作業程序」辦理，並依法令規定及時且正確的公告各項資金貸與他人之資訊。

3.背書保證之執行情形及未來因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無為他人背書保證之情事，未來若遇有需進行為他人背書保證之必要，亦將依本公司訂定之「背書保證作業程序」辦理，並依法令規定及時且正確的公告各項為他人背書保證之資訊。

4.衍生性商品交易之執行情形及未來因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無衍生性商品交易之情事，未來若遇有需進行衍生性商品交易之必要，亦將依本公司訂定之「衍生性商品交易處理程序」辦理，並依法令規定及時且正確的公告各項交易資訊。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

本公司研究發展計畫請參閱本年報肆、營運概況。本年度將持續朝產品多元化之目標邁進，並積極開發各項新技術以擴展客戶群。本年度預計投入研發成本將維持於營業額之5~15%。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司無受國內外重要政策及法律變動而有影響財務業務之情事；本公司管理階層將隨時注意國內外重要政策及法律變動之訊息，並適時提出因應措施。

(五)科技改變(包含資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

本公司鼓勵員工從事與職務相關之創作發明，訂有「智權管理辦法」及「智財獎勵辦法」進行專利之管理及針對創作發明予以獎勵，未來仍將持續主動配合客戶同步開發，順應相關產業技術發展演變，充分掌握視覺檢測設備研發之趨勢與脈動，故科技改變及產業變化對本公司之財務業務尚無重大之影響。

本公司為維護競爭優勢與智慧財產，陸續強化資安基礎建設，將網路速度升速，提升人員作業效率，並不定期更新防火牆，以提供 NGFW 次世代防火牆、深度封包檢測 (DPI)、入侵預防系統(IPS)、SSL/SSH 檢測、網站過濾以及 QoS/頻寬管理、防毒、防間諜軟體，以強化對外網路的防護及管制。同時，亦嚴格落實資料存取控制，導入郵件歸檔管理系統及機敏檔案存取軌跡稽核系統，確保資訊安全管理系統之有效運行，維護重要資訊資產的機密性、完整性及可用性，經評估本公司應非屬重大營運風險。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司係專業自動光學檢測設備供應商，自成立來均專注本業經營，經營狀況及信譽良好，市場上無任何不利本公司企業形象之報導，目前無企業形象改變之疑慮。

(七)進行併購之預期效應、可能風險及因應措施

本公司無併購他公司之計畫，未來若有進行併購計畫時，將秉持審慎評估態度，考量合併是否能為公司帶來具體綜效，確實保障原有股東權益。

(八)擴充廠房之預期效應、可能風險及因應措施

本公司目前並無擴充廠房之計畫。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

1.進貨風險

本公司在重要關鍵零組件的採購上，均維持兩家以上之供應商為原則。雖本公司與各供應商間已建立長期且良好之合作關係，但仍會定時針對各供應商之供貨品質狀況、交期及準確性做評核，確保其供貨品質。

2.銷貨風險

本公司之營收來源為自動光學檢測設備產品之銷售，主要銷售領域包含了印刷

電路板產業及平面顯示器產業之各式自動光學檢測設備領域。就產業面而言，本公司以銷售多元化及跨產業之產品分散獲利來源及投資風險，降低受單一產業景氣循環因素之影響；就客戶面而言，積極研發客製化產品，開拓國內外相關產業客戶，分散營收來源，亦可降低受單一客戶景氣影響之風險。

(十)董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二)訴訟或非訟事件：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：請至公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區查詢<https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10>。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，依證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無此情事。

由田新技股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：114年03月11日

本公司民國113年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國114年03月11日董事會通過，出席董事7人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

由田新技股份有限公司



董事長：鄒嘉駿



簽章

總經理：張文杰



簽章

由田新技股份有限公司

113 股東常會議事錄

時 間：中華民國 113 年 6 月 12 日(星期三)上午 9 時。
地 點：新北市中和區連城路 268 號 10 樓之 1(本公司訓練教室)。
出 席：親自出席及委託出席股東股份總計 38,214,834 股(含以電子方式行使表決權股數 2,775,117 股)，佔本公司已發行股份總數 59,850,750 股之 63.85%。

出 席 董 事：鄒嘉駿、張文杰、林芳隆

出席獨立董事：呂英誠、丘邦翰、蔡熊光

列 席：許智超律師、安侯建業聯合會計師事務所 楊樹芝會計師

主 席：鄒嘉駿 董事長

記 錄：嚴晨心

壹、宣 佈 開 會：出席股數已達法定股數，主席宣佈開會

貳、主 席 致 詞：(略)。

參、報告事項

第一案：本公司112年度營業報告，請參閱附件一。全體出席股東洽悉。

第二案：審計委員會查核本公司112年度決算表冊報告，請參閱附件二。全體出席股東洽悉。

第三案：本公司112年度員工及董事酬勞分配情形報告，全體出席股東洽悉。

第四案：本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告，全體出席股東洽悉。

第五案：本公司資本公積發放現金情形，全體出席股東洽悉。

第六案：本公司現金增資私募普通股情形報告，全體出席股東洽悉。

肆、承認事項

第一案 (董事會提)

案 由：承認本公司112年度決算表冊案。

說 明：(一)本公司112年度個體財務報表暨合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所林恒昇會計師及洪士剛會計師查核完竣，連同營業報告書經本公司審計委員會委員查核完畢在案。

(二)本公司112年度營業報告書請參閱附件一，個體財務報表暨合併財務報表請參閱附件三。

決 議：本議案投票表決時，出席股東總表決權數35,798,362權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：35,354,943權 (含電子投票權數2,331,698權)	98.76%
反對權數：1,343權 (含電子投票權數1,343權)	0.00%
無效權數：0權	0.00%
棄權/未投票權數：442,076權 (含電子投票權數442,076權)	1.23%

本案照原案表決通過。

第二案 (董事會提)

案 由：承認本公司112年度盈餘分派案。

說 明：(一)依公司法及本公司章程之規定，董事會決議通過112年度盈餘分配，並送請審計委員會查核完竣出具查核報告書。

(二)本公司112年度盈餘分派表請參閱附件四。

決 議：本議案投票表決時，出席股東總表決權數35,798,362權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：35,374,372權 (含電子投票權數2,351,127權)	98.81%
反對權數：1,349權 (含電子投票權數1,349權)	0.00%
無效權數：0權	0.00%
棄權/未投票權數：422,641權 (含電子投票權數422,641權)	1.18%

本案照原案表決通過。

伍、討論事項

第一案

(董事會提)

案由：本公司辦理現金增資私募普通股案，提請 決議。

說明：(一)本公司為引進策略性投資人及增強與策略合作伙伴的長期合作關係，以利公司長期經營與業務發展，擬依證券交易法第43條之6等規定，以私募方式辦理現金增資發行新股，發行條件如下：

1. 私募資金對象：依證券交易法第43條之6規定，對特定人進行私募，惟目前並無已洽定之應募人。
2. 私募股份種類：普通股。
3. 私募股數：發行股數不超過12,000,000股。
4. 得私募額度：視發行價格及實際發行股數而定。
5. 每股面額：新台幣壹拾元整。

(二) 私募價格訂定之依據及合理性。

1. 以定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，與定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上二基準計算價格較高者為參考價格。
2. 本次私募普通股實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定依據，並擬請股東會以不低於參考價格之八成授權董事會訂定實際發行價格。
3. 前述價格訂定方式係依據相關法令辦理，應屬合理。

(三) 特定人選擇方式

本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限進行私募，特定人以策略性投資人為限。

(四) 應募人之選擇方式與目的、必要性及預計效益

1. 方式與目的

本次係選擇策略性投資人為應募人，應募人之選擇為可協助本公司擴展業務、投資新事業及完成策略聯盟等之對象，並可幫助本公司提升競爭優勢。

2. 必要性

有鑑於自動光學檢測技術於各產品應用端上仍具高度成長性，為提升本公司之競爭優勢及擴大市場規模，擬引進對本公司未來產品與市場發展有助益之策略投資人。

3. 預計效益

藉由策略性投資人之加入，應可加速本公司在特定產品銷售及掌握相關市場發展契機，並有助於公司營運穩定成長。

(五) 辦理私募之必要理由及預計達成效益

1. 不採用公開募集理由

考量募集資本之時效性、便利性及發行成本等因素，且限制三年內不得轉讓有助於公司經營權穩定及拓展營運，故擬透過私募方式向特定人籌募款項。

2. 得私募之額度

於不超過普通股12,000,000股(含)之額度內，於股東會決議通過之日起一年內分兩次辦理。

3. 辦理私募資金用途及預計達成效益

(1) 私募資金用途

兩次辦理私募之資金用途皆為充實營運資金。

(2) 預計達成效益

兩次辦理私募之預計達成效益皆為充實營運資金將強化公司經營體質及競爭力，預計將改善財務結構、有助公司營運穩定成長，對股東權益並有正面助益。

(六) 本次私募普通股案，擬請股東會授權董事會自股東會決議通過之日起一年內預計分兩次辦理。

(七) 本次私募普通股之權利義務

原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依證券交易法之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再轉讓。

(八) 本次私募普通股自交付日起滿三年後，擬請股東會授權董事會視當時狀況若符合相關規定時，先向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請核發上櫃標

準之同意函後，據以向主管機關完成補辦公開發行審核程序後始得提出上櫃申請。

(九)有關本案之私募發行股數、發行價格、發行條件、募資金額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益或其他相關事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響需變更或修正時，擬請股東會授權董事會得依當時市場狀況修訂之。

決 議：本議案投票表決時，出席股東總表決權數35,798,362權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：34,673,349權 (含電子投票權數1,650,104權)	96.85%
反對權數：701,376權 (含電子投票權數701,376權)	1.95%
無效權數：0權	0.00%
棄權/未投票權數：423,637權 (含電子投票權數423,637權)	1.18%

本案照原案表決通過。

陸、臨時動議：無

柒、散會：民國一一三年六月十二日上午九時二十二分

本次股東會無股東提問

由田新技股份有限公司
審計委員會查核報告書

董事會造具本公司113年度個體財務報告(含合併財務報告)，業經安侯建業聯合會計師事務所林恒昇會計師及洪士剛會計師查核完竣，連同營業報告書及盈餘分派表等，經本審計委員會查核完竣認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定繕具報告，報請 鑒察。

此 致

本公司113年股東常會

由田新技股份有限公司

審計委員會召集人：呂英誠



中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 1 日

由田新技股份有限公司



董事長：鄒嘉駿

